PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2001-308672

(43)Date of publication of application: 02.11.2001

(51)Int.Cl. H03H 9/145

H03H 9/64

(21)Application number: 2001- (71)Applicant: MURATA MFG CO LTD

035620

(22)Date of filing: 13.02.2001 (72)Inventor: SAWADA YOICHI

TAKASAKI HIROSHI

(30)Priority

Priority number: 2000035299 Priority date: 14.02.2000 Priority country: JP

(54) SURFACE ACOUSTIC WAVE FILTER DEVICE



(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a surface acoustic wave filter device

which has a wide band, good balancing, and the conversion function of balanced-unbalanced input and output.

SOLUTION: The surface acoustic wave filter device includes the following devices. The first through the third surface acoustic wave filter elements 1-3 are put on the piezoelectric substrate. The transmission amplitude characteristic of both the second and the third surface acoustic wave filter elements 2, 3 is almost the same but the transmitting phase characteristic of those is quite different within the band. At least one IDT2b, 2c of the second surface acoustic wave filter elements and at least one IDT3b, 3c of the third surface acoustic wave filter elements 3 are connected to one IDT1b, 1c at least one of the first surface acoustic wave filter elements 1.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

06.08.2002

[Date of sending the examiner's

decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number] 3520413

[Date of registration] 13.02.2004

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

* NOTICES *

JPO and NCIPI are not responsible for any

damages caused by the use of this translation.

- 1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.**** shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

CLAIMS

[Claim(s)]

[Claim 1] It has the 3rd surface acoustic wave filter element. the 1- constituted on the piezo-electric substrate and said piezo-electric substrate -- Each surface acoustic wave filter element has two or more IDT(s) formed along the propagation direction of a surface acoustic wave. The said 2nd and 3rd surface acoustic wave filter element The transmission amplitude characteristic in a band is carrying out abbreviation coincidence, and it is constituted so that transmission phase characteristics may differ 180 degrees of abbreviation. At least one IDT of said 2nd surface acoustic wave filter element, Surface acoustic wave filter equipment with which at least one IDT of the 3rd surface acoustic wave filter element is characterized by connecting with at least one IDT of the 1st surface acoustic wave filter element, respectively.

[Claim 2] the 1- formed in the piezo-electric substrate and said piezo-electric substrate -- it has the 3rd surface acoustic wave filter element, and the 1st surface acoustic wave filter element with the 1st IDT formed along the propagation direction of a surface acoustic wave It has the 2nd and 3rd IDT arranged at the surface wave propagation direction both sides of the 1st IDT. The said 2nd and 3rd surface acoustic wave filter element has two or more IDT(s)

arranged along the propagation direction of a surface acoustic wave. The transmission amplitude characteristic in the band of the said 2nd and 3rd surface acoustic wave filter element carries out abbreviation coincidence. Are constituted so that transmission phase characteristics may differ 180 degrees of abbreviation. and the 2nd IDT of the 1st surface acoustic wave filter element is connected to the 2nd surface acoustic wave filter element. Surface acoustic wave filter equipment characterized by connecting the 3rd IDT of the 1st surface acoustic wave filter element to IDT of the 3rd surface acoustic wave filter element. [Claim 3] said the 1- the 3rd surface acoustic wave filter element with one IDT. respectively IDT which has two IDT(s) arranged at these surface wave propagation direction both sides of IDT, and is connected to the 1st surface acoustic wave filter element in the 2nd surface acoustic wave filter element, IDT connected to the 1st surface acoustic wave filter element in the 3rd surface acoustic wave filter element compared with the 1st spacing between these IDT(s) and adjoining IDT(s). Surface acoustic wave filter equipment according to claim 2 characterized by 0.48lambda-0.525lambda Differing when the 2nd spacing between these IDT(s) and adjoining IDT(s) sets wavelength of a surface acoustic wave to lambda

```
[Claim 4] Said 1st spacing is [Equation 1]. 

式 (1) 

(n/2+1, 2) \times \lambda \sim (n/2+1, 3) \times \lambda  (n=0\sim 4 の整数)
```

Come out, it is and said 2nd spacing is [Equation 2]. 式 (2) $(n/2+1, 72) \times \lambda \sim (n/2+1, 83) \times \lambda$ $(n=0\sim40%\%)$

Surface acoustic wave filter equipment according to claim 3 which comes out and is characterized by a certain thing.

Come out, it is and said 2nd spacing is [Equation 4].

Surface acoustic wave filter equipment according to claim 4 which comes out and is characterized by a certain thing.

[Claim 6] Surface acoustic wave filter equipment according to claim 5 which said 1st spacing of is the range of 1.72lambda-1.83lambda, and has said 2nd spacing in the range of 2.22lambda-2.33lambda.

[Claim 7] Said piezo-electric substrate is LiTaO3. LiTaO3 which the single crystal is rotating from the Y-axis in 36-44 degrees to Z shaft orientations focusing on the X-axis Surface acoustic wave filter equipment according to claim 3 to 6 with which it is a substrate and electrode coverage in at least one spacing is made into 50% or more among said 1st spacing and 2nd spacing.

[Claim 8] Surface acoustic wave filter equipment according to claim 7 said whose electrode coverage is 63% or more.

[Claim 9] The 1st and 2nd reflector is prepared in the surface wave propagation direction both sides of the field in which two or more IDT(s) are prepared in said 2nd surface acoustic wave filter element, respectively. The 3rd and 4th reflector is prepared in the surface wave propagation direction both sides of the field in which two or more IDT(s) are prepared in said 3rd surface acoustic wave filter element, respectively. Surface acoustic wave filter equipment according to claim 3 to 8 with which spacing of the 1st reflector and the 2nd reflector spreads spacing of the 3rd reflector and the 4th reflector, abbreviation, etc. and which is carried out.

[Claim 10] It has the 3rd surface acoustic wave filter element. the 1- constituted on the piezo-electric substrate and said piezo-electric substrate -- said 1st surface acoustic wave filter element with the 1st IDT It has the 2nd and 3rd IDT arranged at the surface wave propagation direction both sides of the 1st IDT. The 2nd surface acoustic wave filter element is connected to the 2nd IDT of the 1st surface acoustic wave filter element. The 3rd surface acoustic wave filter element is connected to the 3rd IDT of the 1st surface acoustic wave filter element. The

2nd IDT of the 1st surface acoustic wave filter element, Surface acoustic wave filter equipment with which about 180 degrees of phase contrast over the 3rd input or output of IDT differ in a passband.

[Claim 11] When the 1st spacing between the 1st and 2nd IDT of said 1st surface acoustic wave filter element and the 2nd spacing between the 1st IDT of said 1st surface acoustic wave filter element and the 3rd IDT set wavelength of a surface acoustic wave filter to lambda Surface acoustic wave filter equipment according to claim 10 which 0.48lambda-differs only from 0.525lambda, and is characterized by being carried out by it if the phase contrast in a passband with the input edge of the 1st surface acoustic wave filter element is about 180-degree **.

[Claim 12] Said 1st spacing is [Equation 5]. 式(1)

$$(n/2+1, 22) \times \lambda \sim (n/2+1, 33) \times \lambda$$
 $(n=0~4の整数)$

Come out, it is and said 2nd spacing is [Equation 6].

$$(n/2+1, 72) \times \lambda \sim (n/2+1, 83) \times \lambda$$
 $(n=0 \sim 4 \text{ or } 24)$

Surface acoustic wave filter equipment according to claim 11 which comes out and exists.

[Claim 13] Said 1st spacing is [Equation 7].

$$(n/2+1, 22) \times \lambda \sim (n/2+1, 33) \times \lambda$$
 $(n=0 \sim 20 \text{ BW})$

Come out, it is and said 2nd spacing is [Equation 8].

$$(n/2+1, 72) \times \lambda \sim (n/2+1, 83) \times \lambda$$
 $(n=0 \sim 2 の整数)$

Surface acoustic wave filter equipment according to claim 12 which comes out and exists.

[Claim 14] Surface acoustic wave filter equipment according to claim 13 characterized by for said 1st spacing being in the range of 1.72lambda-1.88lambda, and said 2nd spacing being in the range of 2.22lambda-2.33lambda.

[Claim 15] Said piezo-electric substrate is LiTaO3. LiTaO3 which the single crystal is rotating from the Y-axis in 36-44 degrees to Z shaft orientations focusing on the X-axis Surface acoustic wave filter equipment according to claim 11 to 14 with which it is a substrate and electrode coverage in at least one spacing is made into 50% or more among the 1st spacing in said 1st surface acoustic wave filter element, and the 2nd spacing.

[Claim 16] Surface acoustic wave filter equipment according to claim 15 said whose electrode coverage is 63% or more.

[Claim 17] Surface acoustic wave filter equipment according to claim 10 to 16 with which said 1st surface acoustic wave filter element is further equipped with the 1st and 2nd reflector arranged at the surface wave propagation direction both sides of the field in which two or more IDT(s) are prepared, and the distance from the 1st IDT to the 1st reflector and the distance from the 1st IDT to the 2nd reflector spread abbreviation etc. and which is carried out.

[Claim 18] every from which the electrode finger crossover width of face of IDT which constitutes said 1st surface acoustic wave filter element constitutes the 2nd surface acoustic wave filter element and the 3rd surface acoustic wave filter element — the surface acoustic wave filter equipment according to claim 1 to 17 in the 1.5 to 3.5 times as much range as the electrode finger crossover width of face of IDT.

[Claim 19] It has a piezo-electric substrate and the 1st and 2nd surface acoustic wave filter element constituted on said piezo-electric substrate. Said 1st surface acoustic wave filter element has two or more IDT(s) arranged along the surface wave propagation direction. Said 2nd surface acoustic wave filter element has two or more IDT(s) arranged along the surface acoustic wave propagation direction. The transmission amplitude characteristic in the passband of the 2nd surface acoustic wave filter element Are carrying out abbreviation coincidence with the transmission amplitude characteristic of the 1st surface acoustic wave filter element, and as for the 1st surface acoustic wave filter element, the transmission phase characteristic is constituted so that it may differ 180 degrees

of abbreviation. Surface acoustic wave filter equipment with which said terminal by which the terminal which one terminal of the 1st and 2nd surface acoustic wave filter element is electrically connected to juxtaposition, and the other-end child is electrically connected to the serial, and is connected to juxtaposition is connected to the unbalance terminal and the serial constitutes the balanced terminal.

[Claim 20] IDT by which the said 1st and 2nd surface acoustic wave filter element has three IDT(s), respectively, and has been arranged in the center in the 1st surface acoustic wave filter element, When the 2nd spacing between IDT arranged in the center in the 2nd surface acoustic wave filter element and IDT arranged at both sides sets wavelength of a surface acoustic wave to lambda compared with the 1st spacing between IDT(s) arranged at both sides Surface acoustic wave filter equipment according to claim 19 characterized by 0.48lambda-0.525lambda Differing.

```
[Claim 21] Said 1st spacing is [Equation 9].
```

式(1)

```
(n/2+1, 22) \times \lambda \sim (n/2+1, 33) \times \lambda (n=0 \sim 4 \text{ Ø整数})
```

```
Come out, it is and said 2nd spacing is [Equation 10]. ੜ (2)  (n/2+1, 72) \times \lambda \sim (n/2+1, 83) \times \lambda \qquad (n=0 \sim 4.0 整 载)
```

Surface acoustic wave filter equipment according to claim 20 which comes out and exists.

```
[Claim 22] Said 1st spacing is [Equation 11].

\vec{x} (8)

(n/2+1, 22) \times \lambda \sim (n/2+1, 33) \times \lambda (n=0\sim 208\%)
```

```
Come out, it is and said 2nd spacing is [Equation 12]. \pm (4) (n/2+1, 72) \times \lambda \sim (n/2+1, 83) \times \lambda (n=0 \sim 2.9 \text{ with})
```

Surface acoustic wave filter equipment according to claim 21 which comes out and exists.

[Claim 23] Surface acoustic wave filter equipment according to claim 22 characterized by for said 1st spacing being in the range of 1.72lambda-1.88lambda, and said 2nd spacing being in the range of 2.22lambda-2.33lambda. [Claim 24] Said piezo-electric substrate is LiTaO3. 36-44-degree rotation Y cut LiTaO3 which the single crystal is rotating from the Y-axis in 36-44 degrees to Z shaft orientations focusing on the X-axis Surface acoustic wave filter equipment according to claim 20 to 23 with which it is a substrate and electrode coverage in at least one spacing is made into 50% or more among said 1st spacing and 2nd spacing.

[Claim 25] Surface acoustic wave filter equipment according to claim 24 said whose electrode coverage is 63% or more.

[Claim 26] It has further the 1st and 2nd reflector arranged at the surface wave propagation direction both sides of two or more IDT(s) of said 1st surface acoustic wave filter element. The 3rd and 4th reflector is prepared in the surface wave propagation direction both sides of the field in which two or more IDT(s) are prepared in said 2nd surface acoustic wave filter element, respectively. Surface acoustic wave filter equipment according to claim 19 to 25 with which spacing of the 1st reflector and the 2nd reflector spreads spacing of the 3rd reflector and the 4th reflector, abbreviation, etc. and which is carried out.

[Claim 27] Surface acoustic wave filter equipment according to claim 19 to 26 characterized by the terminal connected to the unbalance side of said 1st surface acoustic wave filter element and the terminal connected to the unbalance side of the 2nd surface acoustic wave filter element being connected by the electrode pattern on a piezo-electric substrate.

[Claim 28] It is constituted on the piezo-electric substrate and said piezo-electric substrate, and has the surface acoustic wave filter element which has the 1st IDT and the 2nd and 3rd IDT arranged at the both sides of the 1st IDT. The 1st IDT, When the 2nd spacing between the 1st IDT and the 3rd IDT sets wavelength of a surface acoustic wave to lambda compared with the 1st spacing between the 2nd IDT, 0.48lambda-differs only from 0.525lambda, and the 1st spacing is [Equation]

```
13]. \vec{x} (1) (\mathbf{n}/2+1, 22) \times \lambda \sim (\mathbf{n}/2+1, 33) \times \lambda (\mathbf{n}=0\sim4.0 R \mathbf{x}) Come out, it is and said 2nd spacing is [Equation 14]. \vec{x} (2) (\mathbf{n}/2+1, 72) \times \lambda \sim (\mathbf{n}/2+1, 83) \times \lambda (\mathbf{n}=0\sim4.0 R \mathbf{x})
```

Surface acoustic wave filter equipment by which come out, it is, the 1st IDT is connected to an unbalance terminal, and the 2nd and 3rd IDT is connected to the balanced terminal

```
[Claim 29] Said 1st spacing is [Equation 15]. 式 (3)  (n/2+1,\ 22) \times \lambda \sim (n/2+1,\ 33) \times \lambda \qquad (n=0\sim 2 \text{ Ø整数})
```

Come out, it is and said 2nd spacing is [Equation 16]. 式 (4) $(n/2+1, 72) \times \lambda \sim (n/2+1, 83) \times \lambda$ $(n=0\sim 20 整數)$

Surface acoustic wave filter equipment according to claim 28 which comes out and exists.

[Claim 30] Surface acoustic wave filter equipment according to claim 28 said whose 1st spacing is 1.72lambda-1.83lambda and said whose 2nd spacing is 2.22lambda-2.33lambda.

[Claim 31] Surface acoustic wave filter equipment according to claim 28 to 30 characterized by making electrode coverage in at least one spacing into 50% or more among said 1st and 2nd spacing.

[Claim 32] Surface acoustic wave filter equipment according to claim 31 with which said electrode coverage is made into 63% or more.

[Claim 33] Surface acoustic wave filter equipment according to claim 28 to 32 with which the 1st and 2nd reflector is arranged and the distance from the 1st IDT to the 1st reflector and the distance from the 1st IDT to the 2nd reflector spread abbreviation etc. on the outside of said 2nd and 3rd IDT, respectively and which is carried out.

[Claim 34] Surface acoustic wave filter equipment according to claim 19 to 33 further equipped with the series resonance child connected to the unbalance terminal side.

IClaim 35] Surface acoustic wave filter equipment according to claim 19 to 34 further equipped with the surface acoustic wave resonator connected to each terminal by the side of a balanced terminal at the serial, respectively. [Claim 36] Surface acoustic wave filter equipment according to claim 1 to 35 further equipped with the ladder mold surface acoustic wave filter by which cascade connection was carried out to the balanced terminal side. [Claim 37] The case material which is further equipped with the electrode pattern which is formed on said piezo-electric substrate and is electrically connected with the exterior and by which the chip with which said surface acoustic wave filter element and said electrode pattern are constituted is carried on said piezoelectric substrate, It has further a current carrying part for connecting electrically the electrode pattern, said electrode pattern, and package on a chip. Surface acoustic wave filter equipment according to claim 1 to 36 with which at least one of the electrode pattern formed on said piezo-electric substrate, a package, and the current carrying parts has the structure of the approximate line symmetry. (Claim 38) Surface acoustic wave filter equipment according to claim 37 with which at least two of said electrode pattern, a package, and current carrying parts have the structure of the approximate line symmetry to the same symmetry axis

[Claim 39] It has further the case material by which the chip with which said surface acoustic wave filter element is constituted is carried by flip chip bonding on said piezo-electric substrate. To said case material One external input terminal or an external output terminal, Surface acoustic wave filter equipment according to claim 1 to 36 with which two external output terminals or an external input terminal is prepared, and said two external output terminals or an external input terminal is arranged to one external input terminal or an external output terminal at the approximate line symmetry.

[Claim 40] It has further the case material by which the chip with which said surface acoustic wave filter element is constituted is carried by flip chip bonding on said piezo-electric substrate. To said case material One external input terminal or an external output terminal, Surface acoustic wave filter equipment according to claim 1 to 36 with which two external output terminals or an external input terminal is prepared, and said two external output terminals or an external input terminal is electrically arranged to one external input terminal or an external output terminal at the abbreviation symmetry.

[Claim 41] Surface acoustic wave filter equipment according to claim 39 or 40 with which at least one or more grounding terminals are arranged between said external input terminals and said external output terminals.

[Claim 42] Surface acoustic wave filter equipment according to claim 39 to 41 further equipped with at least one grounding terminal arranged between said two external output terminals or between external input terminals.

[Claim 43] The common machine characterized by using a surface acoustic wave filter according to claim 1 to 42.

[Claim 44] The communication device characterized by using surface acoustic wave filter equipment according to claim 1 to 42 or a common machine according to claim 43.

[Translation done.]

* NOTICES *

JPO and NCIPI are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.**** shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

DETAILED DESCRIPTION

[Detailed Description of the Invention]

[0001]

[Field of the Invention] This invention relates to the surface acoustic wave filter equipment which the characteristic impedances of an input side and an output side differ in the detail more, and has an unbalance-balance conversion function about surface acoustic wave filter equipment.

[0002]

[Description of the Prior Art] In recent years, a miniaturization and lightweightizing of a portable telephone are progressing, and development of the components which compounded not only reduction and a miniaturization of each component part but two or more functions is progressing.

[0003] In view of the above situations, what gave balanced - unbalance conversion function and the so-called balun function is studied by the surface acoustic wave filter used for RF stage of a portable telephone, and it is increasingly used for it focusing on GSM etc.

[0004] It is unbalance, and it is common to have the characteristic impedance of 50 ohms, and, as for the part from the antenna of a portable telephone to a bandpass filter, they have an impedance (150-200ohm) with a balanced terminal in the amplifier used for the latter part of a filter. [many] Then, the thing which made the function changed into this surface acoustic wave filter from 50-ohm unbalance at 150-200-ohm balance have is proposed, using a surface acoustic wave filter as a band-pass filter.

[0005] For example, the unbalanced input-balanced output is realized by JP,10-117123,A by using four surface acoustic wave filter elements. The configuration of surface acoustic wave filter equipment given in this advanced technology is shown in drawing 28 . Here, the 2nd surface acoustic wave filter section 206 to which the 1st surface acoustic wave filter section 203, surface acoustic wave filter element 204, and this surface acoustic wave filter element 204 constituted by carrying out two-step cascade connection of the two surface acoustic wave filter elements 201,202 come to carry out cascade connection of the surface acoustic wave filter element 205 from which a transmission phase characteristic differs 180 degrees of abbreviation is constituted. Parallel connection of one side of each input/output terminal of each surface acoustic wave filter section 203,206 is carried out, and series connection of another side is carried out, and let the unbalance terminal and the series connection terminal be balanced terminals for the parallel connection terminal.

[0006] Moreover, as shown in drawing 29, the surface acoustic wave filter equipment 211 which has three IDT(s) is indicated by JP,6-204781,A. It is arranged so that the phase of two output sides IDT212,213 of both sides may be reversed, and each output terminal of IDT212,213 constitutes the balanced terminal from this surface acoustic wave filter equipment 211. Moreover, let the end of the central input side IDT214 be an unbalance terminal. Also in this configuration, an input-side impedance can be set to 50 ohms, and an output side impedance can be set to 150-200ohm.

[0007]

[Problem(s) to be Solved by the Invention] Also in the surface acoustic wave filter which has balanced - unbalance I/O mentioned above, broadband-ization is demanded with expansion of the band of a cellular-phone system. However, it sets in the surface acoustic wave filter which has balanced - unbalance I/O, and improvement in that the amplitude is equal and 180 degrees of phases are reversed and the so-called unbalance is required in the transmission characteristic in the passband between each terminal of an unbalance terminal and a balanced terminal.

[0008] However, with the surface acoustic wave filter equipment currently indicated by JP,10-117123,A, it has the property in which the impedance which a surface acoustic wave filter element has becomes capacitive, along with broadband-izing. Therefore, in addition to this capacitive property, the parasitic

capacitance of the interstage by which two-step cascade connection is carried out tended to be added, the impedance mismatch between the surface acoustic wave filter sections tended to arise, and broadband-izing was difficult.

[0009] furthermore -- since four surface acoustic wave filter elements are used -- wiring -- complicated -- this -- parasitic capacitance increased also with complicated wiring and there was a problem that unbalance deteriorated.

Furthermore, component size was enlarged, the miniaturization of the device itself was difficult, and since the number of the surface acoustic wave filter equipment which can be acquired from one wafer decreased, there was a problem that cost cost dearly.

[0010] On the other hand, with surface acoustic wave filter equipment given in JP,6-204781,A, since the structure of 212,213 of two IDT(s) for constituting a balanced terminal was changed, or it was carried out if the physical relationship over IDT214 of the center of IDT116,117 was **, unbalance tended to deteriorate. Moreover, since IDT212,213 by the side of a balanced terminal was electrically connected to the serial, a lost part by the resistance which an electrode finger has increased, and there was also a problem that the insertion loss in a passband became large.

[0011] The purpose of this invention cancels the fault of the conventional technique mentioned above, and is a broadband, and its unbalance is good and is to offer the surface acoustic wave filter equipment which has balanced - unbalance I/O.

[0012]

[Means for Solving the Problem] The surface acoustic wave filter equipment concerning invention of the 1st of this application It has the 3rd surface acoustic wave filter element. the 1- constituted on the piezo-electric substrate and said piezo-electric substrate -- Each surface acoustic wave filter element has two or more IDT(s) formed along the propagation direction of a surface acoustic wave. The said 2nd and 3rd surface acoustic wave filter element The transmission amplitude characteristic in a band is carrying out abbreviation coincidence, and it

is constituted so that transmission phase characteristics may differ 180 degrees of abbreviation. At least one IDT of said 2nd surface acoustic wave filter element, At least one IDT of the 3rd surface acoustic wave filter element is characterized by connecting with at least one IDT of the 1st surface acoustic wave filter element.

[0013] The surface acoustic wave filter equipment concerning invention of the 2nd of this application the 1- formed in the piezo-electric substrate and said piezo-electric substrate — it has the 3rd surface acoustic wave filter element, and the 1st surface acoustic wave filter element with the 1st IDT formed along the propagation direction of a surface acoustic wave It has the 2nd and 3rd IDT arranged at the surface wave propagation direction both sides of the 1st IDT. The said 2nd and 3rd surface acoustic wave filter element has two or more IDT(s) arranged along the propagation direction of a surface acoustic wave. The transmission amplitude characteristic in the band of the said 2nd and 3rd surface acoustic wave filter element carries out abbreviation coincidence. Are constituted so that transmission phase characteristics may differ 180 degrees of abbreviation, and the 2nd IDT of the 1st surface acoustic wave filter element is connected to the 2nd surface acoustic wave filter element. It is characterized by connecting the 3rd IDT of the 1st surface acoustic wave filter element to IDT of the 3rd surface acoustic wave filter element.

[0014] On the specific aspect of affairs of the surface acoustic wave filter equipment concerning the 2nd invention said the 1- the 3rd surface acoustic wave filter element with one input side IDT, respectively IDT which has two output sides IDT arranged at the surface wave propagation direction both sides of an input side IDT, and is connected to the 1st surface acoustic wave filter element in the 2nd surface acoustic wave filter element, Compared with the 1st spacing between IDT(s) connected to the output terminal, the 2nd spacing between IDT connected to the 1st surface acoustic wave filter element in the 3rd surface acoustic wave filter element in the 3rd surface acoustic wave filter element and IDT connected to the output terminal When wavelength of a surface acoustic wave is set to lambda, it is constituted

0.48lambda-0.525lambda So that it may differ.

[0015] At the aspect of affairs of specification [that / of the surface acoustic wave filter equipment concerning the 2nd invention], said 1st spacing is [0016].

[Equation 17] 式(1)

(n/2+1.22)×i~(n/2+1.33)×i (n=0~4の整数)

[0017] Come out, it is and said 2nd spacing is [0018].

[Equation 18]

(n/2+1, 72)×λ~(n/2+1, 83)×λ (n=0~4の整数)

[0019] It comes out. Said 1st spacing is [0020] more preferably.

[Equation 19]

(n/2+1, 22)×λ~ (n/2+1, 33)×λ (n=0~2の整数)

[0021] Come out, it is and said 2nd spacing is [0022].

[Equation 20] 式(4)

(n/2+1, 72)× l~ (n/2+1, 83)× l (n=0~2の整数)

[0023] It comes out. Still more preferably, said 1st spacing is the range of 1.72lambda-1.83lambda, and said 2nd spacing is in the range of 2.22lambda-2.33lambda.

[0024] At other specific aspects of affairs of the surface acoustic wave filter equipment concerning the 2nd invention, said piezo-electric substrate is LiTaO3. LiTaO3 which the single crystal is rotating from the Y-axis in 36-44 degrees to Z shaft orientations focusing on the X-axis It is a substrate and electrode coverage in at least one spacing is made into 50% or more among the 1st spacing in said 1st surface acoustic wave filter element, and the 2nd spacing.

[0025] The above-mentioned electrode coverage is more preferably made into 63% or more. On other specific aspects of affairs of the surface acoustic wave filter equipment concerning the 2nd invention, further It has further the 1st and

2nd reflector arranged at the surface wave propagation direction both sides of two or more IDT(s) of said 2nd surface acoustic wave filter element. The 3rd and 4th reflector is prepared in the surface wave propagation direction both sides of the field in which two or more IDT(s) are prepared in said 3rd surface acoustic wave filter element, respectively, and spacing of the 1st reflector and the 2nd reflector spreads spacing of the 3rd reflector and the 4th reflector, abbreviation, etc., and is carried out.

[0026] The surface acoustic wave filter equipment concerning invention of the 3rd of this application It has the 3rd surface acoustic wave filter element. the 1-constituted on the piezo-electric substrate and said piezo-electric substrate --said 1st surface acoustic wave filter element with the 1st IDT It has the 2nd and 3rd IDT arranged at the surface wave propagation direction both sides of the 1st IDT. The 2nd surface acoustic wave filter element is connected to the 2nd IDT of the 1st surface acoustic wave filter element. The 3rd surface acoustic wave filter element is connected to the 3rd IDT of the 1st surface acoustic wave filter element, and phase contrast over the input or output of the 2nd IDT of the 1st surface acoustic wave filter element and the 3rd IDT is characterized by about 180 degrees differing in a passband.

[0027] On the specific aspect of affairs of the surface acoustic wave filter equipment concerning the 3rd invention When the 1st spacing between the 1st and 2nd IDT of said 1st surface acoustic wave filter element and the 2nd spacing between the 1st IDT of said 1st surface acoustic wave filter element and the 3rd IDT set wavelength of a surface acoustic wave filter to lambda 0.48lambda-differs only from 0.525lambda, and it is carried out by it if the phase contrast in a passband with the input edge of the 1st surface acoustic wave filter element is about 180-degree **.

```
[0028] Preferably, said 1st spacing is [0029].
```

```
[Equation 21]
```

式(1)

⁽n/2+1, 22)× l~ (n/2+1, 33)× l (n=0~4の整数)

```
[0030] Come out, it is and said 2nd spacing is [0031]. 

[Equation 22] \pi(2) (n/2+1, 72) \times 1 \sim (n/2+1, 83) \times 1 \qquad (n=0\sim 4.0 \pm 2) [0032] Come out, it is and said 1st spacing is [0033] still more preferably. 

[Equation 23] \pi(3) (n/2+1, 22) \times 1 \sim (n/2+1, 33) \times 1 \qquad (n=0\sim 2.0 \pm 2) [0034] Come out, it is and said 2nd spacing is [0035]. 

[Equation 24] \pi(4) \times 1 \sim (n/2+1, 23) \times 1 \sim (n/2+1, 23) \times 1 \sim (n=0\sim 2.0 \pm 2)
```

100361 Come out and it is, and more preferably, said 1st spacing is in the range of 1.72lambda-1.88lambda, and said 2nd spacing is in the range of 2.22lambda-2.33lambda. At the aspect of affairs of other specification further of the surface acoustic wave filter equipment of the 3rd invention, said piezo-electric substrate is LiTaO3. LiTaO3 which the single crystal is rotating from the Y-axis in 36-44 degrees to Z shaft orientations focusing on the X-axis It is a substrate and electrode coverage in at least one spacing is made into 50% or more among the 1st spacing in said 1st surface acoustic wave filter element, and the 2nd spacing. [0037] Preferably, electrode coverage is made into 63% or more. On other specific aspects of affairs of the surface acoustic wave filter equipment concerning the 3rd invention, said 1st surface acoustic wave filter element is further equipped with the 1st and 2nd reflector arranged at the surface wave propagation direction both sides of the field in which two or more IDT(s) are prepared, and the distance from the core of the 1st IDT to the 1st reflector and the distance from the core of the 1st IDT to the 2nd reflector spread abbreviation etc., and it is carried out.

[0038] On the specific aspect of affairs of the surface acoustic wave filter equipment concerning the 1st - the 3rd invention, the electrode finger crossover

width of face of IDT which constitutes said 1st surface acoustic wave filter element is in the 1.5 to 3.5 times as much range as each electrode finger crossover width of face of IDT which constitutes the 2nd surface acoustic wave filter element and the 3rd surface acoustic wave filter element 100391 The surface acoustic wave filter equipment concerning invention of the 4th of this application It has a piezo-electric substrate and the 1st and 2nd surface acoustic wave filter element constituted on said piezo-electric substrate. Said 1st surface acoustic wave filter element has two or more IDT(s) arranged along the surface wave propagation direction. Said 2nd surface acoustic wave filter element has two or more IDT(s) arranged along the surface acoustic wave propagation direction. The transmission amplitude characteristic in the passband of the 2nd surface acoustic wave filter element Are carrying out abbreviation coincidence with the transmission amplitude characteristic of the 1st surface acoustic wave filter element, and as for the 1st surface acoustic wave filter element, the transmission phase characteristic is constituted so that it may differ 180 degrees of abbreviation. It is characterized by said terminal by which the terminal which one terminal of the 1st and 2nd surface acoustic wave filter element is electrically connected to juxtaposition, and the other-end child is electrically connected to the serial, and is connected to juxtaposition is connected to the unbalance terminal and the serial constituting the balanced terminal. 100401 On the specific aspect of affairs of the surface acoustic wave filter equipment concerning the 4th invention IDT by which the said 1st and 2nd surface acoustic wave filter element has three IDT(s), respectively, and has been arranged in the center in the 1st surface acoustic wave filter element. When the 2nd spacing between IDT connected to the unbalance terminal in the 2nd surface

between IDT(s) arranged at both sides It is constituted 0.48-0.525lambda So that it may differ.

[0041] With the surface acoustic wave filter equipment concerning the 4th

acoustic wave filter element and IDT connected to a balanced terminal sets wavelength of a surface acoustic wave to lambda compared with the 1st spacing

```
invention, said 1st spacing is [0042] preferably. 

[Equation 25] \stackrel{\checkmark}{_{\sim}} (1) \stackrel{\checkmark}{_{\sim}} (^{\circ} ^{\circ} 2 + 1. ^{\circ} 2 3 3 ) \times ^{\circ} (^{\circ} = 0 ^{\circ} 4 ^{\circ} 4 ^{\circ} 4 ^{\circ} ^{\circ} (^{\circ} 2 + 1. ^{\circ} 2 2 ) \times ^{\circ} (^{\circ} ^{\circ} 2 + 1. ^{\circ} 3 3 ) \times ^{\circ} (^{\circ} = 0 ^{\circ} 4 ^{\circ} ^{\circ} 4 ^{\circ} ^{\circ} (^{\circ} 2 + 1. ^{\circ} 7 2 ) \times ^{\circ} (^{\circ} ^{\circ} 2 + 1. ^{\circ} 8 3 ) \times ^{\circ} (^{\circ} 1 = 0 ^{\circ} 4 ^{\circ} ^{\circ} ^{\circ} ^{\circ} ^{\circ} ^{\circ} (^{\circ} 2 + 1. ^{\circ} 2 2 ) \times ^{\circ} (^{\circ} ^{\circ} 2 + 1. ^{\circ} 3 3 ) \times ^{\circ} (^{\circ} 1 = 0 ^{\circ} 2 ^{\circ} 9 ^{\circ} ^
```

[0047] Come out, it is and said 2nd spacing is [0048].

 $(n/2+1, 72) \times \lambda \sim (n/2+1, 83) \times \lambda$ (n=0~2の整数)

[Equation 28] 式(4)

[0049] Come out and it is, and still more preferably, said 1st spacing is in the range of 1.72lambda-1.88lambda, and said 2nd spacing is in the range of 2.22lambda-2.33lambda. On other specific aspects of affairs of the surface acoustic wave filter equipment concerning the 4th invention Said piezo-electric substrate is LiTaO3. 36-44-degree rotation Y cut LiTaO3 which the single crystal is rotating from the Y-axis in 36-44 degrees to Z shaft orientations focusing on the X-axis It is a substrate. Electrode coverage in at least one spacing is made into 50% or more among the 1st spacing in said 1st surface acoustic wave filter element, and the 2nd spacing. This electrode coverage is more preferably made into 63% or more

[0050] On other specific aspects of affairs of the surface acoustic wave filter equipment concerning the 4th invention It has further the 1st and 2nd reflector arranged at the surface wave propagation direction both sides of two or more IDT(s) of said 2nd surface acoustic wave filter element. The 3rd and 4th reflector

is prepared in the surface wave propagation direction both sides of the field in which two or more IDT(s) are prepared in said 3rd surface acoustic wave filter element, respectively, and spacing of the 1st reflector and the 2nd reflector spreads spacing of the 3rd reflector and the 4th reflector, abbreviation, etc., and is carried out.

[0051] On other specific aspects of affairs of the surface acoustic wave filter equipment concerning the 4th invention, the terminal connected to the unbalance side of said 1st surface acoustic wave filter element and the terminal connected to the unbalance side of the 2nd surface acoustic wave filter element are further connected by the electrode pattern on the piezo-electric substrate.

[0052] The surface acoustic wave filter equipment concerning invention of the 5th of this application It is constituted on the piezo-electric substrate and said piezo-electric substrate, and has the surface acoustic wave filter element which has the 1st IDT and the 2nd and 3rd IDT arranged at the both sides of the 1st IDT. The 1st IDT, When the 2nd spacing between the 1st IDT and the 3rd IDT sets wavelength of a surface acoustic wave to lambda compared with the 1st spacing between the 2nd IDT, it 0.48lambda-0.525lambda Differs, and the 1st spacing is 100531.

```
[Equation 29]

式 (1)

(n/2+1, 22) \times \lambda \sim (n/2+1, 33) \times \lambda  (n=0\sim 4 \Phi B \Phi)

[0054] Come out, it is and said 2nd spacing is [0055].

[Equation 30]

式 (2)

(n/2+1, 72) \times \lambda \sim (n/2+1, 83) \times \lambda  (n=0\sim 4 \Phi B \Phi)
```

[0056] Come out, it is, IDT of the 1st surface acoustic wave filter element constitutes an unbalance terminal, and it is characterized by using the 2nd and 3rd IDT of the 2nd surface acoustic wave filter element as a balanced terminal. [0057] By the 5th invention, the 1st spacing is [0058] preferably. [Equation 31]

```
式 (3)  (n/2+1, 22) \times \lambda \sim (n/2+1, 33) \times \lambda \qquad (n=0\sim 2 の整数)
```

[0059] Come out, it is and said 2nd spacing is [0060].

[0061] It is carried out. More preferably, the 1st spacing is 1.72lambda-1.83lambda, and said 2nd spacing is 2.22lambda-2.33lambda.

[0062] On other specific aspects of affairs of the 5th invention, electrode coverage in at least one spacing of the 1st and 2nd spacing is made into 50% or more. Preferably, the above-mentioned electrode coverage is made into 63% or more.

[0063] On other specific aspects of affairs of the surface acoustic wave filter equipment concerning the 5th invention, the 1st and 2nd reflector is arranged, and the distance from the 1st IDT to the 1st reflector and the distance from the 1st IDT to the 2nd reflector spread abbreviation etc., and it is made the outside of said 2nd and 3rd IDT, respectively.

[0064] On the specific aspect of affairs of the surface acoustic wave filter equipment concerning the 4th - the 5th invention, it has further the series resonance child connected to the unbalance terminal side. On other specific aspects of affairs of the surface acoustic wave filter equipment concerning the 4th - invention of the 5th, each terminal by the side of a balanced terminal is further equipped with the surface acoustic wave resonator connected to the serial, respectively.

[0065] On the specific aspect of affairs of the surface acoustic wave filter equipment concerning the 1st - the 5th invention, it has further the ladder mold surface acoustic wave filter by which cascade connection was carried out to the balanced terminal side. The surface acoustic wave filter equipment concerning the 1st - the 5th invention The case material for containing the chip with which it can constitute as surface acoustic wave filter equipment which has proper

package structure, for example, the surface acoustic wave filter element is constituted on said piezo-electric substrate, It has further a current carrying part for connecting the electrode pattern and package on a chip in electrode, and it is constituted as had the structure of the approximate line symmetry in at least one of the electrode pattern formed on said piezo-electric substrate, a package, and the current carrying parts.

[0066] In this case, preferably, as had the structure of the approximate line symmetry to the same symmetry axis in at least two of said electrode pattern, a package, and current carrying parts, it is constituted. On other specific aspects of affairs of the surface acoustic wave filter equipment concerning the 1st - the 5th invention It has further the case material by which the chip with which said surface acoustic wave filter element is constituted is carried by the flip-chip-bonding method on said piezo-electric substrate. One external input terminal used for this case material as an unbalance signal terminal, or an external output terminal, Two external output terminals or external input terminal used as a balanced signal terminal is prepared, and these two external output terminals or an external input terminal at the approximate line symmetry.

[0067] On other specific aspects of affairs of the surface acoustic wave filter equipment concerning the 1st - the 5th invention, further It has further the case material by which the chip with which said surface acoustic wave filter element is constituted is carried by flip chip bonding on said piezo-electric substrate. To this case material One external input terminal used as an unbalance signal terminal, or an external output terminal, Two external output terminals or external input terminal used as a balanced signal terminal is prepared, and these two external output terminals or an external input terminal is electrically constituted by the abbreviation symmetry to one external input terminal or an external output terminal. In addition, electrically, even if the symmetry is asymmetry somewhat physically, it shall mean the structure where electric length is mostly made into the symmetry with wiring etc.

[0068] On other specific aspects of affairs of the surface acoustic wave filter equipment concerning the 1st - the 5th invention, at least one grounding terminal is further arranged between the above-mentioned external input terminal and an external output terminal.

[0069] On another specific aspect of affairs of the surface acoustic wave filter equipment concerning the 1st - the 5th invention, at least one grounding terminal is arranged between two external output terminals used as the above-mentioned balanced signal terminal, or between external input terminals.

[0070] Moreover, using surface acoustic wave filter ****** concerning this invention, a common machine like an antenna common machine can be constituted, and various communication devices can be constituted using the common machine further applied to this invention.

[0071]

[Embodiment of the Invention] Hereafter, this invention is clarified by explaining the concrete example of the surface acoustic wave filter equipment concerning this invention, referring to a drawing.

[0072] With reference to drawing 1, the surface acoustic wave filter equipment concerning the 1st example of this invention is explained. The surface acoustic wave filter equipment of the 1st example is equivalent to the example of the surface acoustic wave filter equipment concerning invention of the 1st and the 2nd of this application.

[0073] Drawing 1 is the top view showing the electrode structure of the surface acoustic wave filter equipment of the 1st example. With the surface acoustic wave filter equipment of this example, three surface acoustic wave filter elements 1-3 are formed on the piezo-electric substrate. In addition, as a piezo-electric substrate, it is LiTaO3. Although proper piezo-electric substrates, such as Xtal, can be used, at this example, it is 36-degreeY-XLiTaO3. The substrate is used. [0074] The 1st surface acoustic wave filter element 1 has three IDT(s) 1a-1c arranged along the surface wave propagation direction. The grating mold reflectors 1d and 1e are arranged at the surface-wave propagation direction both

sides of the field in which IDT(s) 1a-1c are formed.

[0075] Similarly, also as for the 2nd and 3rd surface acoustic wave filter element 2 and 3, three IDT(s) 2a-2c, and 3a-3c have the structure arranged along the surface wave propagation direction. Moreover, also in the 2nd and 3rd surface acoustic wave filter element 2 and 3, IDT(s) 2a-2c, each IDT(s) 1a-1c by which the grating mold reflectors 2d, 2e, 3d, and 3e are arranged on the surface-wave propagation direction outside of the field in which 3a-3c are prepared, 2a-2c, and 3a-3c have the sinking comb electrode of a pair, respectively.

[0076] It is IDT1a of the center of the 1st surface acoustic wave filter element 1. while it goes away and a gear-tooth electrode is connected to an input terminal 4. Moreover, it is the 2nd arranged on the outside of 1st central IDT1a, the 2nd by which the gear-tooth electrode has been arranged by being 3rd IDT1b, while going away on the outside of the 2nd surface acoustic wave filter element, 3rd IDT2b, and 2c, while goes away, and connects with the gear-tooth electrode electrically. Similarly, it is outside IDT1c of the 1st surface acoustic wave filter element, while it goes away, and it is the outsides 3b and IDT 3c of the 3rd surface acoustic wave filter element 3, while goes away to a gear-tooth electrode, and the gear-tooth electrode is electrically connected to it. It is IDT(s) 2a and 3a of the center of the 2nd and 3rd surface acoustic wave filter element, while it goes away and the gear-tooth electrode is electrically connected to output terminals 5 and 6, respectively. It goes away except IDT(s) 1a-1c, 2a-2c, and the sinking comb electrode that it 3a-3c Went away and was mentioned above among gear-tooth electrodes, and the gear-tooth electrode is connected to touchdown potential.

[0077] An input terminal 4 is an unbalance terminal and output terminals 5 and 6 are balanced terminals. In addition, the transmission phase characteristics of the 3rd surface acoustic wave filter element 103 differ the transmission phase characteristic of the 2nd surface acoustic wave filter element 102, and 180 degrees of abbreviation.

[0078] next, the 1- the concrete example of structure of the 3rd surface acoustic

wave filter element 1-3 is explained. At this example, electrode finger crossover width of face W in IDT(s) 1a-1c is set to 52lambda by the 1st surface acoustic wave filter element 1. In addition, lambda shows the wavelength of a surface acoustic wave. Each logarithm of an electrode finger [in / in the logarithm of the electrode finger of 1st IDT1a arranged in the center / 16 and Outside 1b and IDT 1c. i.e., the 2nd and 3rd IDT. I is 11. Wavelength lambdal of the surface wave in IDT(s) 1a-1c is 4.2 micrometers. Moreover, the number of the electrode finger in Reflectors 1d and 1e is 120, and wavelength lambdaR is 4.3 micrometers. Moreover, the spacing GI between adjacent IDT1a - 1c is 1.77lambdaR. In addition, spacing between adjacent IDT(s) shall mean the pitch between the electrode fingers by the side of [IDT(s) 1a and 1b are / each other / most close to I hot, if between IDT1a and 1b is taken for an example. [0079] In the 2nd surface acoustic wave filter element 2, electrode finger crossover width of face W in IDT(s) 2a-2c is set to 31lambda. Each logarithm of an electrode finger [in / in the logarithm of the electrode finger of 1st IDT2a arranged in the center / 16, Outside IDT, i.e., the 2nd, 3rd IDT2b, and 2c] is 11. Wavelength lambdal of the surface wave in IDT(s) 2a-2c is 4.2 micrometers. Moreover, the number of the electrode finger in Reflectors 2d and 2e is 120, and wavelength lambda is 4.3 micrometers. Moreover, the spacing GI between adjacent IDT2a - 2c is 1.77lambdaR.

[0080] If it removes that spacing GI between adjacent IDT(s) is set to 2.27lambdaR, it consists of the 3rd surface acoustic wave filter element 103 like the 2nd surface acoustic wave filter element 2.

[0081] If the spacing GI between IDT(s) which the 2nd surface acoustic wave filter element 2 and the 3rd surface acoustic wave filter element 3 adjoin so that about 180 degrees of transmission phase characteristics may differ is **, it is carried out. In addition, the configuration which changes 180 degrees of transmission phase characteristics of the 2nd and 3rd surface acoustic wave filter element 2 and 3 is not limited to the structure of changing spacing during Above IDT.

[0082] In addition, in this example and the following examples, since there are very many electrode fingers of a surface acoustic wave filter element and electrode fingers of a reflector, the drawing is shown in schematic drawing. [0083] The input terminal 4 of the surface acoustic wave filter equipment of this example is used as an unbalanced input terminal, and the actuation in the case of using output terminals 5 and 6 as a balanced output terminal is explained. When an electrical signal is inputted into an input terminal 4, the electrical signal filtered by the 1st surface acoustic wave filter element 1 is given to the 2nd and 3rd surface acoustic wave filter element 2 and 3. If IDT(s) 1b and 1c of the surface acoustic wave filter element 1 are made into the same structure and distance from IDT1a to IDT(s) 1b and 1c is made equal at this time, the electrical signal given to the 2nd and 3rd surface acoustic wave filter element 2 and 3 will become the same.

[0084] The electrical signal inputted into the surface acoustic wave filter element 2 and the surface acoustic wave filter element 3 is filtered again, and is drawn by the balanced output terminals 5 and 6. Here, by the surface acoustic wave filter element 2 and the surface acoustic wave filter element 3, if the spacing GI between adjacent IDT(s) is ** as mentioned above, it is carried out. Therefore, the filtered amplitude characteristic will be the same and about 180 degrees of transmission phase characteristics will differ. Therefore, the electrical signal drawn by output terminals 5 and 6 has the the same amplitude characteristic, and turns into a perfect balanced signal with which about 180 degrees of transmission phase characteristics differ.

[0085] Furthermore, in the surface acoustic wave filter element 1, parameters, such as crossover width of face, are set up so that it may have consistency in 50 ohms which is the characteristic impedance of the unbalanced circuit connected to an input terminal 4, for example, an antenna circuit. In the surface acoustic wave filter elements 2 and 3, parameters, such as the crossover width of face, are set up so that it may have consistency in 1/2 [with a characteristic impedance / of a balanced circuit like the amplifying circuit connected to output

terminals 5 and 6 / of 150 ohms]. This is because a characteristic impedance becomes equal to one half of the characteristic impedances of a balanced circuit the bottom wholly at a case as the unbalance terminal which became independent about each terminal 5 and 6 of a balanced circuit.

[0086] With the surface acoustic wave filter equipment which has the balanced unbalance conversion function currently indicated by JP,10-117123,A mentioned above, two surface acoustic wave filter elements were required for the input side (unbalance side).

[0087] On the other hand, at this example, an input side (unbalance side) can consist of one surface acoustic wave filter element as mentioned above.

Therefore, according to this example, it becomes possible to reduce sharply the parasitic capacitance which a leading-about electrode or a pad for bondings of the shape of a chip which connects the terminal and surface acoustic wave filter equipment of the parasitic capacitance formed between the bus bars of adjacent IDT, wiring which connects the surface acoustic wave filter element of an input side and the surface acoustic wave filter element of an output side, and a package etc. has in comparison with the above-mentioned advanced technology. Such parasitic capacitance had become a big inhibition factor, when it was going to realize broadband-ization of surface acoustic wave filter equipment. [0088] The filter shape of a broadband can be realized with the surface acoustic wave filter equipment of this example, without being able to reduce such parasitic capacitance as mentioned above, and degrading the surface smoothness and

[0089] A continuous line shows the filter shape of this example to drawing 2. Moreover, a broken line shows the filter shape of the surface acoustic wave filter equipment produced based on the publication of JP,10-117123,A constituted so that it might have the same band as the surface acoustic wave filter equipment of an example for the comparison.

VSWR in a passband.

[0090] By using the surface acoustic wave filter equipment of this example shows that the filter shape of a broadband is obtained so that clearly from drawing 2.

Drawing 3 and drawing 4 show similarly each VSWR property by the side of the unbalance terminal of the surface acoustic wave filter equipment of this example, and the surface acoustic wave filter equipment prepared based on the publication of the above-mentioned advanced technology, and a balanced terminal. A continuous line shows the property of the surface acoustic wave filter equipment of an example, and a broken line shows the property of the conventional example. According to this example, it turns out that aggravation of VSWR can be controlled so that clearly from drawing 3 and drawing 4.

[0091] Moreover, with the surface acoustic wave filter equipment of this example, since what is necessary is just to use three surface acoustic wave filter elements, a chip size can be made small. Furthermore, the miniaturization of the whole surface acoustic wave filter equipment and the surface acoustic wave filter equipment acquisition number per [which is prepared in producing surface acoustic wave filter equipment] wafer can be increased, and a cost cut can be aimed at by it.

[0092] Spacing GI and GI between IDT(s) which the 2nd surface acoustic wave filter element adjoins is set to 1.77lambda, and drawing 5 and drawing 6 are drawings showing the difference of spacing between IDT(s) of the surface acoustic wave filter elements 2 and 3 at the time of changing the spacing GI and GI between IDT(s) which the 3rd surface acoustic wave filter element 3 adjoins, and the relation of unbalance. Here, spacing between IDT(s) shall mean the distance from the core of the electrode finger nearest to the next IDT among the electrode fingers connected to the signal line, without grounding one IDT among adjacent IDT(s) to the core of the electrode finger nearest to the next IDT among the electrode fingers in IDT of another side connected to the signal line, without being grounded. In addition, the difference of spacing of the axis of abscissa of drawing 5 and drawing 6 is the value standardized by lambda.

[0093] Moreover, balanced [A] of the amplitude when the balancing of the

amplitude and the balancing of a phase considered the surface acoustic wave filter equipment of this example to be the device of three ports, and an

unbalanced input terminal is made into a port 1 and they make the balanced output terminals 5 and 6 a port 2 and a port 3, respectively is A=|S21|-|S31|, and balancing |B-180| of a phase is B=|**S21-**S31|.

[0094] Ideally, although the unbalance of 0dB and a phase of the unbalance of the amplitude is 0 degree, as actually usable range, unbalance of 1.5dB or less and a phase is made into 20 degrees or less for the unbalance of the amplitude. [0095] According to drawing 5, what the difference of spacing between IDT(s) of the surface acoustic wave filter elements 2 and 3 should set it as the range of 0.48lambda-0.525lambda that the unbalance of the amplitude satisfies such a value for in order for the difference of spacing between IDT(s) of the surface acoustic wave filter elements 2 and 3 to be the range below 0.525lambda, and for the unbalance of a phase to satisfy the above-mentioned value according to drawing 6 R> 6 is understood. both [therefore,] the unbalance of the amplitude, and the unbalance of a phase -- although -- in order to fill the above-mentioned range, it turns out that the difference of spacing between IDT(s) in the surface acoustic wave filter element 2 and spacing between adjacent IDT(s) in the surface acoustic wave filter element 3 should just serve as the range of 0.48lambda-0.525lambda.

[0096] In the case of the vertical joint resonator mold surface acoustic wave filter element which has three IDT(s), it is already well-known by setting spacing between adjacent IDT(s) as the range of x(0.72+n/2) lambda-(0.83+n/2) xlambda however n= 0, and 1, 2 and 6 that the filter shape of a broadband can be realized. Therefore, various range can be considered as a combination which sets the difference of spacing between IDT(s) which the surface acoustic wave filter element 2 and the surface acoustic wave filter element 3 adjoin the account of a top as the above-mentioned value.

[0097] However, if the value of n in the above-mentioned formula is enlarged, the following problems will arise. That is, drawing 7 R> 7 shows the relation between spacing between IDT(s) adjoined when x(n / 2+0.77) lambda, however n set spacing between adjacent IDT(s) to 0, 1, 2, and 6, and the bandwidth of surface

acoustic wave filter equipment in the surface acoustic wave filter element 2 of the surface acoustic wave filter equipment of this example. In order to secure the bandwidth of 35MHz indispensable as surface acoustic wave filter equipment for portable telephones so that clearly from drawing 7, it turns out that n must carry out to six or less.

[0098] On the other hand, there is also a problem produced by making n small. Drawing 9 shows the relation between the spacing GI between adjacent IDT(s) in the 2nd surface acoustic wave filter element 2 when x(0.77+m/2) lambda, however m making spacing GI between adjacent IDT(s) in the 2nd surface acoustic wave filter element 2 in the surface acoustic wave filter equipment of this example 0 and the natural number, and setting to x(1.27+m/2) lambda spacing GI between IDT(s) which the surface acoustic wave filter element 3 adjoins, and amplitude unbalance.

[0099] Moreover, the relation between the spacing GI between IDT(s) when drawing 10 setting to x(0.77+m/2) lambda spacing GI between IDT(s) which the 2nd surface acoustic wave filter element 2 in the surface acoustic wave filter equipment of this example adjoins, and setting spacing GI between adjacent IDT(s) in the 3rd surface acoustic wave filter element 3 to x(1.27+m/2) lambda, and phase unbalance is shown.

[0100] In order for amplitude unbalance to satisfy 1.5dB or less and for phase unbalance to satisfy 20 degrees or less from drawing 9 and drawing 10, it turns out that there is [spacing between IDT(s)] more than 1.77lambda, i.e., the need of setting the value of m or more to one. If spacing between adjacent IDT(s) becomes small, the phenomenon in which unbalance gets worse can be considered as follows.

[0101] In the case of a vertical joint resonator mold surface acoustic wave filter, adjoining IDT(s) not only carry out an acoustic turnover, but they may join together electromagnetic. When, as for the transmission characteristic by the acoustic turnover, only 0.5lambda changes spacing between adjacent IDT(s), to a phase being reversed by the surface acoustic wave filter elements 2 and 3, it is

not dependent on spacing between adjacent IDT(s), therefore the transmission characteristic by electromagnetic association serves as corresponding homologous amplitude. The transmission component of this corresponding homologous amplitude is a factor which worsens unbalance, therefore unbalance gets worse with the structure where make spacing between IDT(s) small and electromagnetic association becomes large.

[0102] From the above result, the spacing GI between IDT(s) which the surface acoustic wave filter element 2 adjoins The spacing GI between IDT(s) with which it is referred to as xlambda, n= 1, and 2, 3, 4 and 5 and which the surface acoustic wave filter element 3 adjoins (0.77+n/2) x(1.27+n/2) lambda, however n By considering as the natural number of the range of 1-5, the filter shape from which balancing and bandwidth serve as level which is satisfactory both practically can be obtained.

[0103] Moreover, in taking into consideration the frequency drift by the temperature change, the bandwidth of 39MHz is needed. In this case, x(0.77+n/2) lambda, however n make spacing GI between IDT(s) which the surface acoustic wave filter element 2 adjoins the natural number of 1-3, and x(1.27+n/2) lambda, however n should just make spacing GI between IDT(s) which the surface acoustic wave filter element 3 adjoins the natural number of 1-3.

[0104] Furthermore, in order to obtain wide band width of face most, without unbalance getting worse, spacing GI between IDT(s) which the surface acoustic wave filter element 2 adjoins is set to x(0.77+n/2) lambda, however n= 2, and the spacing GI between IDT(s) which the surface acoustic wave filter element 3 adjoins is understood [x(1.27+n/2) lambda however n= 2 then] are good. [0105] LiTaO3 From the X-axis, two kinds of surface acoustic waves are excited by the core from a Y-axis on the piezo-electric substrate which it makes it come to rotate in 36 degrees - 44 degrees at Z shaft orientations, and a single crystal is spread at it. One surface acoustic wave is the Leakey wave, i.e., a false surface acoustic wave, and another is a bulk wave called SSBW. Among these, if being

used in order to form a resonator and a filter has the main Leakey wave and SSBW mainly spreads, a propagation loss will become large and degradation of Q of a resonator and increase of the insertion loss as a filter will arise. The two above-mentioned kinds of surface acoustic waves are intermingled, and are excited and spread. But when [more near an electric short circuit namely,] electrode coverage is large, the Leakey wave mainly spreads [a surface condition], and when more close to electric disconnection (i.e., when electrode coverage is small), SSBW mainly spreads [a surface condition]. [0106] Therefore, at least one electrode finger is inserted in the 1st spacing between IDT of the center in the 2nd surface acoustic wave filter element, and the 2nd and 3rd outside IDT, and the 2nd spacing between the 1st central IDT and the 2nd and 3rd outside IDT in the 3rd surface acoustic wave filter element. If electrode coverage is raised, the Leakey wave can be made to be mainly able to spread, excitation and propagation of SSBW can be controlled, and an insertion loss can be reduced.

[0107] Drawing 8 indicates relation with band interpolation close loss to be the electrode coverage in the 1st spacing of the above. 0.5 or more [in order to realize 3.0dB or less which is practical band interpolation close loss], i.e., it turns out that electrode coverage is required 50% or more. Moreover, in order for reducing loss further to set an insertion loss to 2.5dB or less in the application searched for, it turns out that electrode coverage should just be made into more than [0.63 or more], i.e., 63%. It can say that the same is said of the 2nd spacing.

[0108] The signal inputted into the 2nd surface acoustic wave filter element 2 excites a surface acoustic wave by IDT2b and 2c. This surface acoustic wave is spread in the predetermined propagation direction, and a standing wave produces the surface acoustic wave reflected and reflected by Reflectors 2d and 2e between 2d of reflectors, and 2e from a buffer with the surface acoustic wave excited. Very much, Q becomes high resonance, and when the excited standing wave is received by IDT2a, it is changed into an electric signal in IDT2a by this

standing wave, and the function as a filter is achieved. Same actuation is performed also in the 3rd surface acoustic wave filter element 3. However, although an output signal is determined as the standing wave excited according to the physical relationship of output side IDT3a, compared with the case where phase relation is the 2nd surface acoustic wave filter element, it is reversed by shifting the location of IDT3b only 0.5 times of the wavelength lambda of a surface acoustic wave.

[0109] If the spacing C between 2d of two reflectors of the surface acoustic wave filter element 2 and 2e differs from the spacing D between 3d of two reflectors in the surface acoustic wave filter element 3, and 3e here, the intensity distributions of the standing wave in each component will also differ. Therefore, the resonance characteristic also changes and the property as a filter also changes. therefore, the spacing C between 2d of two reflectors of the surface acoustic wave filter element 2, and 2e and the spacing D between 3d of two reflectors of the surface acoustic wave filter element 3, and 3e — abbreviation — degradation of unbalance can be controlled by making it an equal value, without the difference in the filter shape of the surface acoustic wave filter elements 2 and 3 arising.

[0110] Moreover, in this example, although the grating mold reflector is used as reflectors 1d, 1e, 2d, 2e, 3d, and 3e, it is not limited to this and reflection [in / a piezo-electric substrate end face] may be used.

[0111] In this example, the characteristic impedance of an input terminal (unbalance terminal) 4 is 50ohms, and the characteristic impedance of output terminals 5 and 6 (balanced terminal) is set to 150 ohms. In order to adjust such an I/O impedance, by this example, crossover width of face is set as 51lambda as mentioned above so that the surface acoustic wave filter element 1 may be adjusted in 50 ohms which is the characteristic impedance of the unbalanced circuit connected to an input side. Moreover, electrode finger crossover width of face is set as 31lambda, respectively so that the surface acoustic wave filter elements 2 and 3 may be adjusted in 1/2 [150-ohm] which is the characteristic impedance of the balanced circuit connected to an output side. This is because a

characteristic impedance becomes equal to one half of the characteristic impedances of a balanced circuit, when each terminal 5 and 6 of a balanced circuit is regarded as an independent unbalance terminal.

[0112] Thus, the ratio of an I/O impedance can be freely set up by planning impedance matching with the unbalanced circuit connected to an input side by the surface acoustic wave filter element 1, and planning impedance matching with the balanced circuit connected to an output side by the surface acoustic wave filter elements 2 and 3.

[0113] Drawing 11 shows the ratio of the crossover width of face of the surface acoustic wave filter element 1 connected to the unbalance terminal 4, and the electrode finger crossover width of face of the surface acoustic wave filter elements 2 and 3 connected to the balanced terminal, and relation with bandwidth. Drawing 11 shows that wide band width of face is most obtained when a crossover width-of-face ratio is 2.0. Moreover, if the above-mentioned crossover width-of-face ratio exceeds 3.5, reduction in bandwidth will exceed 5% and the rate of an excellent article will fall.

[0114] Drawing 12 shows the relation of the value of the ratio of the electrode finger crossover width of face of the surface acoustic wave filter element 1 connected to the unbalance terminal 4, and the electrode finger crossover width of face in the surface acoustic wave filter elements 2 and 3 connected to the balanced terminals 5 and 6, and VSWR in a passband. When the abovementioned crossover width-of-face ratio is 2.5, VSWR serves as best value, and to the case of 1.5 or less, VSWR gets worse remarkably, and it becomes a problem practically. Therefore, as for the above-mentioned electrode finger crossover width-of-face ratio, it is desirable to set it as the range of 1.5-3.5. [0115] (The 2nd example) Drawing 13 is the top view showing the electrode structure of the surface acoustic wave filter equipment concerning the 2nd example of this invention. In this example, three surface acoustic wave filter elements 11-13 are formed on the piezo-electric substrate which is not illustrated. In addition, as a piezo-electric substrate, it is LiTaO3. Although proper piezo-

electric substrates, such as Xtal, can be used, at this example, it is 36-degreeY-X. LiTaO3 It is used. the 1- about the 3rd fundamental structure and connection structure of the surface acoustic wave filter elements 1-13, since it is the same as that of the 1st example, explanation is omitted [part / same] by using explanation of the 1st example by ****** which attaches a considerable reference number

[0116] the place where the surface acoustic wave filter equipment of the 2nd example differs from the surface acoustic wave filter equipment of the 1st example -- the 1- it is in the electrode structure in the 3rd surface acoustic wave filter element 11-13.

[0117] In addition, transmission phase characteristics differ 180 degrees of abbreviation, and the outside IDT of the 1st surface acoustic wave filter element 11, i.e., the electrical signal outputted from 2nd and 3rd IDT 11b and 11c, has the amplitude equal to the 2nd and 3rd surface acoustic wave filter element 12 and 13, and each surface acoustic wave filter elements 11 and 12 consist of this examples so that the electrical signal with which phases differ 180 degrees of abbreviation may be given, so that clearly from explanation of the belowmentioned actuation.

[0118] In this example, electrode finger crossover width of face W in IDT(s) 11a-11c is set to 52lambda in the 1st surface acoustic wave filter element 11. In addition, lambda shows the wavelength of a surface acoustic wave. [0119] In the 1st surface acoustic wave filter element 11, each logarithm of an electrode finger [in / in the logarithm of the electrode finger of 1st IDT11a arranged in the center / 16 and Outside 11b and IDT 11c, i.e., the 2nd and 3rd IDT,] is 11. Moreover, wavelength lambdal in IDT(s) 11a-11c is 4.2 micrometers. Moreover, the number of the electrode finger in Reflectors 11d and 11e is 120, and wavelength lambdaR is 4.3 micrometers. Moreover, the 1st spacing A1 between 1st IDT11a and 2nd IDT11b It is 1.77lambdaR and is the 2nd spacing B1 between 1st IDT11a and 3rd IDT11c. It is referred to as 2.27lambdaR. [0120] In the 2nd surface acoustic wave filter element 12, electrode finger

crossover width of face is 31lambda, and each logarithm of an electrode finger [in / in the logarithm of the electrode finger of 1st IDT12a arranged in the center / 16 and Outside 12b and IDT 12c, i.e., the 2nd and 3rd IDT,] is 11. Moreover, wavelength lambdal in IDT(s) 12a-12c is 4.2 micrometers. Moreover, the number of the electrode finger in Reflectors 12d and 12e is 120, and wavelength lambdaR is 4.3 micrometers. Moreover, spacing A2 between 1st IDT12a and 2nd IDT12b It is 1.77lambdaR and is spacing B-2 between 1st IDT12a and 3rd IDT12c. It is referred to as 1.77lambdaR.

[0121] Moreover, the 3rd surface acoustic wave filter element 13 is constituted like the 2nd surface acoustic wave filter element 12. The input terminal 4 of the surface acoustic wave filter equipment of the 2nd example is used as an unbalanced input terminal, and the actuation in the case of using output terminals 5 and 6 as a balanced output terminal is explained.

[0122] When an electrical signal is inputted into an input terminal 4, a surface acoustic wave is excited by 1st IDT11a of the 1st surface acoustic wave filter element. This surface acoustic wave is spread in the direction where an electrode finger is prolonged, and the direction which intersects perpendicularly, and is reflected by Reflectors 11d and 11e, it interferes in the reflected surface acoustic wave with the surface acoustic wave excited, and a standing wave produces it between 11d of two reflectors, and 11e. When this standing wave arises, it becomes high resonance of Q very much, and the excited standing wave is received by IDT(s) 11b and 11c of an output side. Therefore, it is changed into an electric signal and the 1st surface acoustic wave filter element 11 operates as a filter.

[0123] In this case, although an output signal is determined by the physical relationship of the standing wave formed and IDT(s) 11b and 11c of an output side, phase relation can be reversed by shifting either of IDT(s) 11b and 11c only about 0.5 times of the wavelength lambda of a surface acoustic wave. For a phase characteristic, the electrical signal outputted from IDT11b in the 2nd example and the electrical signal outputted from IDT11c are the 1st and 2nd

spacing A1 and B1 so that it may differ 180 degrees of abbreviation. It is set as mentioned above. Therefore, the amplitude is equal and the electrical signal with which 180 degrees of phases differ is given to the 2nd and 3rd surface acoustic wave filter element 12 and 13. Furthermore, the outputted signal is filtered by the 2nd and 3rd surface acoustic wave filter element 12 and 13, and the filtered signal is outputted to output terminals 5 and 6 as a balanced signal.

[0124] From the result of drawing 5 and drawing 6 which were mentioned above, it also sets in the 2nd example, and is the 1st spacing A1 between IDT11a and IDT11b. The 2nd spacing B1 between IDT11a and IDT11c It is guessed that what is necessary is just to set a difference as the range of 0.48lambda-0.528lambda.

[0125] moreover, spacing between above-mentioned IDT-IDT -- x(n/2+1.22) lambda-(n/2+1.33) xlambda -- [-- however, n -- integer] of 0-4, and x(n/2+1.72) lambda-(n/2+1.83) xlambda -- [-- however, when n considers as combination with integer] of 0-4, degradation of unbalance is prevented and a broadband property is acquired.

[0126] Furthermore, IDT12a of a center [in / like the case of the 1st example / the 2nd surface acoustic wave filter element 12], 1st IDT13a of the center in the 1st spacing between 2nd and 3rd outside IDT 12b and 12c, and the 3rd surface acoustic wave filter element, If at least one electrode finger is inserted in the 2nd spacing between 2nd and 3rd outside IDT 13b and 13c and the electrode coverage in the field of the above-mentioned spacing is raised, the Leakey wave can be made to be mainly able to spread and an insertion loss can be reduced. In this example therefore, electrode coverage in the 1st and 2nd spacing of the above is made into 63%, and reduction of an insertion loss is achieved by it. [0127] Moreover, in this example, the 1st and 2nd spacing differs and aggravation of amplitude unbalance is prevented by it. Moreover, the distance P from 1st IDT11a in the 1st surface acoustic wave filter element 11 to 11d of reflectors and distance Q2 from IDT11a to 1st reflector 11e It is made equal and the asymmetry of the excitation intensity distribution of the standing wave formed

in the 1st surface acoustic wave filter element of it is canceled. Therefore, reinforcement of the surface acoustic wave which IDT(s) 11b and 11c can receive is made equal, and aggravation of unbalance is controlled by it. In addition, distance P and Q says the distance between the core of an outermost electrode finger, and the core of the electrode finger by the side of the innermost [of Reflectors 11d and 11e] among the electrode fingers connected to the signal line of IDT11a, respectively.

[0128] (The 3rd example) Drawing 14 is the schematic-drawing-top view showing the electrode structure of the surface acoustic wave filter equipment of the 3rd example. the 3rd example -- also setting -- the 1- the 3rd surface acoustic wave filter element 31-33 is formed on the piezo-electric substrate. Each surface acoustic wave filter elements 31-33 are constituted like the 2nd example. Therefore, about the same part as the 2nd example, it omits by using explanation of the 2nd example.

[0129] But in the 3rd example, the connection structure of the surface acoustic wave filter element 31 and the surface acoustic wave filter elements 32 and 33 differs from the 2nd example. namely, -- the 3rd example -- the 1- float connection of the outside IDT of the 3rd surface acoustic wave filter element 31-33, i.e., 31b, 31c, 32b, 32c, 33b, and 33c, is grounded and made. [0130] More specifically, one sinking comb electrode of 2nd IDT31b of the 1st surface acoustic wave filter element 31 is connected to the one side edge of 2nd and 3rd IDT 32b and 32c of the 2nd surface acoustic wave filter element 32. On the other hand, the another side edge of IDT31b is connected to the another side edge of IDT(s) 32b and 32c of the 2nd surface acoustic wave filter element 32. Similarly, the 1st edge of 3rd IDT31c of the 1st surface acoustic wave filter element 31 is connected to the 1st edge of 2nd and 3rd IDT 33b and 33c of the 3rd surface acoustic wave filter element 33, and the 2nd edge of IDT31c is connected to the 2nd edge of IDT(s) 33b and 33c. [0131] In addition, 31d, 31e, 32d, 32e, 33d, and 33e show a reflector. About

[0131] In addition, 31d, 31e, 32d, 32e, 33d, and 33e show a reflector. About other points, it is the same as that of the 2nd example. Therefore, also in the 3rd

surface acoustic wave filter equipment, it can be made to operate like the surface acoustic wave filter equipment of the 2nd example, and the same effectiveness is acquired. In addition, since it has the above-mentioned connection structure, the number of the bonding pads for touch-down can be lessened remarkable, the miniaturization of surface acoustic wave filter equipment can be advanced, and the parasitic capacitance which originates in connection wiring with a bonding pad and a bonding pad further can be reduced.

[0132] (The 4th example) Drawing 15 is the schematic-drawing-top view showing the electrode structure of the surface acoustic wave filter equipment concerning the 4th example of this invention.

[0133] On the piezo-electric substrate which is not illustrated with the surface acoustic wave filter equipment of this example The 1st and 2nd surface acoustic wave filter element 41 and 42 is constituted. As a piezo-electric substrate, the piezo-electric substrate which consists of electrostrictive ceramics, a piezo-electric single crystal, etc. can be used, and it is 36-degreeY-X at this example. LiTaO3 The substrate is used.

[0134] The 1st and 2nd surface acoustic wave filter element 41 and 42 is a resonator mold surface acoustic wave filter element which all has three IDT(s) 41a-41c, and 42a-42c.

[0135] Common connection of the 1st edge of 1st IDT41a of the center of the surface acoustic wave filter element 41 and the 1st edge of 1st IDT42a of the center of the 2nd surface acoustic wave filter element 42 is made, and they are connected to the input terminal 4.

[0136] Moreover, the 2nd edge of 1st IDT 41a and 42a is grounded. On the other hand, Outside 41b and IDT 41c, i.e., IDT(s), is connected to an output terminal 5, and Outside IDT, i.e., one edge of 2nd and 3rd IDT 42b and 42c, is connected to the output terminal 6. In addition, the another side edge of 2nd and 3rd IDT 41b, 41c, 42b, and 42c is grounded.

[0137] Moreover, Reflectors 41d, 41e, 42d, and 42e are arranged at the both sides of the field in which IDT(s) 41a-41c, and 42a-42c are prepared,

respectively. In this example, to the transmission phase characteristic of the 2nd surface acoustic wave filter element 42, if the transmission phase characteristic of the 1st surface acoustic wave filter element 41 is 180 degree ** of abbreviation, it is carried out.

[0138] Electrode finger crossover width of face W is set to 31lambda, and, more specifically, the logarithm of the electrode finger of IDT41a is [the logarithm of 16 and the electrode finger of IDT(s) 41b and 41c of the 1st surface acoustic wave filter element 41] 11. Moreover, lambdal of IDT(s) 41a-41c is 4.2 micrometers, the number of the electrode finger of Reflectors 41d and 41e is 120, and wavelength lambdaR in Reflectors 41d and 41e is set to 4.3 micrometers. And 1st spacing Gi 1 between IDT41a, and IDT41b and 41c It is referred to as 1.75lambdaR.

[0139] At the 2nd surface acoustic wave filter element 42, it is the 2nd spacing GI 2 between IDT42a, and IDT42b and 42c. If it removes being referred to as 2.25lambdaR, it is constituted like the 1st surface acoustic wave filter element 41. As mentioned above, it is carried out if the 1st spacing and 2nd spacing are **, and with them, the 1st surface acoustic wave filter element 41 and the 2nd surface acoustic wave filter element 42 have the almost equal transmission amplitude characteristic, and the transmission phase characteristic changes 180 degrees of abbreviation.

[0140] The input terminal 4 of the surface acoustic wave filter equipment of this example is an unbalance terminal, this input terminal 4 is considered as an input, and the actuation at the time of using the balanced output terminals 5 and 6 as an output terminal is explained.

[0141] If an electrical signal is inputted into an input terminal 4, the signal of in phase and this amplitude will be impressed to the 1st and 2nd surface acoustic wave filter element 41 and 42. This signal is impressed to IDT(s) 41a and 42a, and a surface wave is excited. This surface wave spreads in the direction where an electrode finger is prolonged, and the direction which intersects perpendicularly, and is reflected by Reflectors 41d, 41e, 42d, and 42e. Therefore,

the reflected surface acoustic wave is buffered with the surface acoustic wave excited, and a standing wave is formed between two reflectors 41d, 41e, or 42d and 42e. Therefore, it becomes high resonance of Q very much, and waves are received by IDT(s) 41b, 41c, 42b, and 42c connected to output terminals 5 and 6, and the excited standing wave is changed into an electric signal. An output signal is determined by the standing wave excited at this time, and the physical relationship of output sides 41b, 41c, 42b, and IDT 42c.

[0142] In this example, spacing between the 1st spacing between IDT41a in the surface acoustic wave filter element 41, and IDT41b and 41c, IDT42a in the 2nd surface acoustic wave filter element 42, and IDT42b and 42c is carried out, if only 0.50 times of the wavelength of a surface acoustic wave are **. Therefore, the phase has reversed the signal outputted from the 1st surface acoustic wave filter element 41, and the signal outputted from the 2nd surface acoustic wave filter element 42.

[0143] Therefore, the surface acoustic wave filter elements 41 and 42 have the property that 180 degrees of transmission phase characteristics differ, the amplitude is equal and the electrical signal with which 180 degrees of phases differ is drawn by the output terminals 5 and 6 which are balanced output terminals

[0144] In addition, in this example, since it is the filter of the one-step configuration which used two surface acoustic wave filter elements 41 and 42, band interpolation close loss can be made very small. The filter shape of the surface acoustic wave equipment of the 4th example is shown in drawing 1616. It turns out that the loss in a passband can be reduced so that clearly from drawing 16.

[0145] Also in the 4th example, it can be said from the result of drawing 5 and drawing 6 that what is necessary is just to set the difference of the 1st spacing and the 2nd spacing as the range of 0.48lambda-0.525lambda.

[0146] moreover, the 1st spacing and 2nd spacing -- x(n / 2+1.22) lambda-(n / 2+1.33) xlambda -- [-- however, n with integer] of 0-4 (n / 2+1.72) xlambda-(n /

- 2+1.83) xlambda [however, n is considering as combination with integer] of 0-4, and degradation of unbalance is prevented and it can do [acquiring a broadband property or].
- [0147] Moreover, also in the 4th example, by inserting one or more electrode fingers in the 1st and 2nd spacing, and raising electrode coverage to it like the 1st example, the Leakey wave can be made to be mainly able to spread and excitation and propagation of SSBW can be controlled. Therefore, the surface acoustic wave filter equipment of low loss can be offered by making more preferably electrode coverage in the 1st and 2nd spacing into 63% or more 50% or more.
- [0148] In this example, in the 2nd surface acoustic wave filter element 42, since the physical relationship of output sides 42b and IDT 42c is shifted only 0.5 times of the wavelength of a surface acoustic wave compared with the location of the output sides 41b and IDT 41c in the 1st surface acoustic wave filter element, phase relation is reversed as mentioned above.
- [0149] Here, if spacing between 41d of two reflectors of the 1st surface acoustic wave filter element 41 and 41e differs from spacing between 42d of two reflectors of the 2nd surface acoustic wave filter element 42, and 42e, the intensity distribution of the standing wave in each component will change. Therefore, the resonance characteristic also changes and it is expected that the property as a filter also changes. Therefore, it is the spacing P1 between 41d of reflectors, and 41e preferably. 42d of reflectors, and spacing Q1 between 42e Abbreviation etc. can be spread and degradation of unbalance can be controlled by it.
 [0150] in addition, although it is alike, it also sets in the 4th example and the grating mold reflector is illustrated about Reflectors 41d-42e, the reflector of other proper structures like the reflector using the reflection in a chip end face can be used, for example.
- [0151] Moreover, the parasitic capacitance which the surface acoustic wave filter element 41 has, and the parasitic capacitance which the surface acoustic wave filter element 42 has will be shared by making common connection of IDT41a of

the center of the surface acoustic wave filter element 41, and the IDT42a of the center of the surface acoustic wave filter element 42 with the electrode pattern on a piezo-electric substrate, and connecting with the unbalanced input terminal 4. Therefore, unbalance is improved by it.

[0152] (The 5th example) The electrode structure of the surface acoustic wave filter equipment of the 5th example is shown in Fig. 17 with a schematic-drawing-top view.

[0153] Also in this example, two resonator mold surface acoustic wave filter elements are used like the 4th example. That is, the 1st and 2nd surface acoustic wave filter element 51 and 52 is constituted on the piezo-electric substrate. Moreover, in the 1st and 2nd surface acoustic wave filter element 51 and 52, the float electrode fingers 53a-53d between central IDT(s) 51a and 52a and 2nd and 3rd outside IDT 51b, 51c, 52b, and 52c are inserted, respectively. IDT(s) 51a-51c and Reflectors 51d and 51e are constituted almost like IDT(s) 41a-41c of the surface acoustic wave filter element 41 of the 4th example, and Reflectors 45d and 45e. Moreover, the 2nd IDT(s) 52a-52c and Reflectors 52d and 52e of the surface acoustic wave filter element 52 are constituted almost like IDT(s) 42a-42c of the 2nd surface acoustic wave filter element 42 of the 4th example, and Reflectors 42d and 42e.

[0154] Like this example, the float electrode fingers 53a-53d may be formed independently of IDT, and electrode coverage of spacing between IDT(s) can be made into 50% or more by it.

[0155] (The 6th example) Drawing 18 is a schematic-drawing-top view for explaining the surface acoustic wave filter equipment concerning the 6th example. On the piezo-electric substrate which is not illustrated, one surface acoustic wave filter element 61 is constituted. As a piezo-electric substrate, it is 36-degreeY-X at this example. LiTaO3 Although the substrate is used, it is LiTaO3 of other cut

***. A substrate and the piezo-electric substrate which consists of other piezoelectric material can be used suitably.

[0156] In the surface acoustic wave filter element 61, three IDT(s) 61a-61c are

formed along the surface wave propagation direction. Reflectors 61d and 61e are formed in the both sides of the field in which IDT(s) 61a-61c are formed. [0157] The end of 1st central IDT61a is connected to the input terminal 4 which is an unbalanced input terminal in this example. The other end of IDT61a is grounded. The end of 2nd and 3rd outside IDT 61b and 61c is connected to the output terminals 5 and 6 which are balanced output terminals, and each other end is grounded. Although Reflectors 61d and 61e consist of grating mold reflectors, they may consist of other reflectors.

[0158] Electrode finger crossover width of face W of IDT(s) 61a-61c is set to 31lambda, and each logarithm of 16 and the electrode finger of IDT(s) 61b and 61c is set to 11 for the logarithm of the electrode finger of IDT61a. Moreover, wavelength lambdal of the surface wave in IDT(s) 61a-61c is 4.2 micrometers. [0159] The number of the electrode finger in Reflectors 61d and 61e is 120 each, and wavelength lambdaR is 4.3 micrometers. The 1st spacing JI1 between IDT61a and IDT61b It is 1.75lambdaR and is the 2nd spacing JI2 between IDT61a and IDT61c. They are 2.25lambdaR.

[0160] With the surface acoustic wave filter equipment of this example, if an electrical signal is inputted into IDT61a from an input terminal 4, a standing wave will be formed between 61d of reflectors, and 61e like the case where they are the 1st - the 5th example. Very high resonance is obtained, waves are received by IDT(s) 61b and 61c by this standing wave, and the excited standing wave is taken out from output terminals 5 and 6.

[0161] Also in this example, an output signal is determined as the standing wave excited according to the physical relationship of output sides 61b and IDT 61c. In this example, since the 1st spacing between IDT61a and 61b differs from the 2nd spacing between IDT61a, IDT61a, and IDT61c only 0.50 times of the wavelength of a surface acoustic wave, the phase of the output signal of IDT(s) 61b and 61c is reversed.

[0162] Therefore, since the electrical signal outputted from IDT61b and the electrical signal outputted from IDT61c have the property that 180 degrees of

transmission phase characteristics differ, the electrical signal with which the amplitude is equal with an electrical signal and 180 degrees of phases differ from output terminals 5 and 6 is drawn.

[0163] Also in this example, the result of drawing 5 and drawing 6 shows that what is necessary is just to set the difference of the 1st and 2nd spacing as the range of 0.48lambda-0.525lambda. moreover, spacing Jl1 and Jl2 between IDT(s) x(n+1.22) lambda-(n+1.33) x lambda -- [-- however, n -- integer] of 0-4, and x(n+0.72) lambda-(n+0.83) x lambda -- [-- however, when n considers as combination with integer] of 0-4, degradation of unbalance can be controlled and a broadband property is acquired.

[0164] Furthermore, in this example, it is supposed that the electrode finger by the side of the innermost [of IDT(s) 61b and 61c] is broad, and they are the spacing Jl1 and Jl2 between IDT(s) by it. Electrode coverage which can be set is set to 0.63. Therefore, spacing Jl1 and Jl2 between IDT(s) The propagation loss which can be set is made small. Therefore, aggravation of the amplitude unbalance by the 1st and 2nd spacing differing is prevented.

[0165] Moreover, by making equal distance P and Q from central IDT61a to Reflectors 61d and 61e, the asymmetry of the excitation intensity distribution of a standing wave is canceled, and aggravation of unbalance can be prevented. [0166] (The 7th example) Drawing 19 is the schematic-drawing-top view of the surface acoustic wave filter equipment concerning the 7th example of this invention. In the 7th example, the float electrode fingers 72 and 73 are arranged at 1st central IDT71a, the 2nd of an outside and 3rd IDT71b, and interval between 71c, respectively. It is constituted like the surface acoustic wave filter equipment of the 6th example as well as the surface acoustic wave filter equipment of the 6th example, and is each IDT(s) 71a-71c and 71d of reflectors. Since 71e is constituted, the same effectiveness as the surface acoustic wave filter equipment of the 6th example can be acquired. [0167] Moreover, since the float electrode fingers 72 and 73 are formed, the electrode coverage in the 1st and 2nd spacing is raised, and a propagation loss

can be reduced. Electrode coverage is more preferably made into 63% or more 5% or more.

[0168] (The 8th example) Drawing 20 is a schematic-drawing-top view for explaining the surface acoustic wave filter equipment concerning the 8th example of this invention. On the piezo-electric substrate which is not illustrated, the 1st and 2nd surface acoustic wave filter element 81 and 82 is constituted. The 1st and 2nd surface acoustic wave filter element 81 and 82 is constituted like the surface acoustic wave filter equipment of the 4th example. A different place between 1st IDT 81a and 82a of the center of the 1st and 2nd surface acoustic wave filter element 81 and 82, and an input terminal 4 In that the 1st surface acoustic wave resonator 83 is connected and a list, between 2nd and 3rd IDT 81b, 81c, 82b, and 82c of the outside of the 1st and 2nd surface acoustic wave filter element 81 and 82, and output terminals 5 and 6 Respectively, it is in the 1 terminal-pair surface acoustic wave resonators 84 and 85 being connected. In addition, 81d, 81e, 82d, and 82e show a reflector.

[0169] The surface acoustic wave resonator 83 of the above 1st has one IDT83a and the grating mold reflector (not shown) arranged at the both sides of one IDT. the electrode finger crossover width of face W of IDT83a of the 1st surface acoustic wave resonator 83 -- the logarithm of 20lambda and an electrode finger -- N is 80, wavelength lambdal of IDT is 4.20 micrometers, and the number of the electrode finger of the reflector which is not illustrated is 120.

[0170] Moreover, the 2nd and 3rd 1 terminal-pair surface acoustic wave resonator 84 and 85 connected to output terminals 5 and 6 is constituted like the 1st surface acoustic wave resonator 83. this example -- above-mentioned the 1-since the 3rd surface acoustic wave resonator 83-85 is connected, as shown in drawing 21, the magnitude of attenuation outside a passband can be enlarged compared with the 4th example. In addition, in drawing 21, a continuous line shows the filter shape of the surface acoustic wave filter equipment of the 8th example, and a broken line shows the filter shape of the surface acoustic wave filter equipment of the 4th example.

[0171] (The 9th example) Drawing 22 is the schematic-drawing-top view showing the electrode structure of the surface acoustic wave filter equipment concerning the 9th example, the surface acoustic wave filter equipment of the 9th example -the 6th input side and output side of surface acoustic wave filter equipment of an example -- the 8th example -- the same -- the 1- it is equivalent to the structure which connected the 3rd surface acoustic wave resonator 93-95 [0172] In addition, it is constituted by the surface acoustic wave filter element 91 almost like the surface acoustic wave filter element 61 of the 6th example. Moreover, the 2nd and 3rd surface acoustic wave resonator 94 and 95 connected between the 1st surface acoustic wave resonator 93, and 2nd and 3rd IDT 91b and 91c and the output terminals 5 and 6 which are connected between input terminals 4 is constituted completely like the surface acoustic wave resonators 83-85 used in the 8th example. [1st central IDT91a, and] [0173] this example -- also setting -- the 8th example -- the same -- the 1- since it connects between the input side of a surface acoustic wave filter element, and an input terminal, and between the output side of a surface acoustic wave resonator. and the output terminal, the 3rd surface acoustic wave resonator can increase the magnitude of attenuation [/ near the passband], especially the magnitude of attenuation by the side of a high region.

[0174] (The 10th example) Drawing 23 is the schematic-drawing-top view showing the electrode structure of the surface acoustic wave filter equipment of the 10th example. This example is equivalent to the structure which connected the 4th surface acoustic wave resonator 101 between the 2nd surface acoustic wave resonator 84 and an output terminal 6 in the surface acoustic wave filter equipment of the 8th example. In other words, the 4th surface acoustic wave resonator 101 is connected to juxtaposition at output terminals 5 and 6. This 4th surface acoustic wave resonator 101 has one IDT and the grating mold reflector which is not illustrated although arranged at those both sides. As for 50 and wavelength lambdal of IDT, the logarithm of 15lambda and an electrode finger is made [the 4th surface acoustic wave resonator 101] into 120 for the electrode

finger crossover width of face W of IDT, as for the number of 4.40 micrometers and the electrode finger of a reflector.

[0175] A ladder type filter circuit is constituted at balanced output terminal 5 and 6 side by connecting the 4th surface acoustic wave resonator 101 to the surface acoustic wave filter equipment of the 8th example according to this example. By locating the attenuation pole of this ladder type filter circuit in a low-pass [of the passband of a surface acoustic wave filter I, and high region side, the magnitude of attenuation can be enlarged further and selectivity can be raised. [0176] Moreover, since the above-mentioned surface acoustic wave resonator 101 is connected in the form of mediation between the balanced output terminal 5 and 6, the effect on the balanced terminals 5 and 6 is equal, and offsets the aggravation factor of unbalance. Therefore, increase of the magnitude of attenuation outside a passband can be aimed at, without worsening unbalance. [0177] Although only the electrode structure currently formed on the piezoelectric substrate was shown, the surface acoustic wave filter equipment concerning this invention can consist of explanation of the surface acoustic wave filter equipment concerning the 1st - the 10th example as chip mold surface acoustic wave filter equipment by adopting various package structures. [0178] The 11th example is related with the surface acoustic wave filter equipment as components built in such a package. As shown in drawing 24, the surface acoustic wave filter element according to this invention is constituted by forming a predetermined electrode on the piezo-electric substrate 102. This surface acoustic wave filter element is contained by the package 103 which has crevice 103a.

[0179] In this example, the piezo-electric substrate 102 which constitutes a surface acoustic wave filter element has a rectangle tabular configuration, and has the symmetry axis X passing through a core. On the other hand, a package 103 is also a rectangle and a flat-surface configuration has the symmetry axis Y passing through a core. In this example, the piezo-electric substrate 102 is fixed in a package 103 so that the axis of symmetry X of the piezo-electric substrate

102 and the axis of symmetry Y of a package 103 may be in agreement. Furthermore, although illustration is omitted in drawing 24, a surface acoustic wave filter element and the electrode pad prepared on the package 103 are connected by the bonding wire. Also about this electrode pad and bonding wire, it is arranged to the above-mentioned symmetry axes X and Y at axial symmetry. [0180] As mentioned above, by making in agreement the axis of symmetry X of the piezo-electric substrate 102, and the axis of symmetry Y of a package 103. the value of the electric merit of wiring on the surface acoustic wave filter connected to each terminal of a balanced output terminal or parasitic capacitance can be made equal, and aggravation of unbalance can be controlled. [0181] Moreover, by considering as the structure of axial symmetry to an axis of symmetry Y through the core of a package, the value of the electric merit and parasitic capacitance which wiring in the package connected to a balanced terminal has can be made equal, and aggravation of unbalance can be controlled also by it. Therefore, the factor which worsens unbalance can be made very small and the surface acoustic wave filter equipment which has balanced unbalance conversion function excellent in unbalance as a result can be offered. [0182] Furthermore, it is ** to arrangement of an electrode pad or wirebonding as mentioned above. Even if it is, unbalance can be further raised by considering as axial symmetry about symmetry axes X and Y. [0183] In addition, also when it replaces with wirebonding and bump bonding

[0183] In addition, also when it replaces with wirebonding and bump bonding performs electrical installation, the same effectiveness is acquired by arranging a bump bonding location to axial symmetry. As compared with wirebonding which especially changes wire length with the arrangement location of a chip by bump bonding, unbalance becomes good.

[0184] Drawing 25 is the typical top view showing the surface acoustic wave filter with which the unbalance-balanced type surface acoustic wave filter with which frequencies differ is formed on the same piezo-electricity substrate as the 12th example of this invention. This surface acoustic wave filter 111 has the structure which has arranged the same surface acoustic wave filter equipment 113,114 as

the surface acoustic wave filter equipment shown on the same piezo-electricity substrate 112 at drawing 20 . In this case, the unbalance-balanced type surface acoustic wave filter equipment 113,114 with which frequencies differ as mentioned above by forming surface acoustic wave filter equipment 114 as a band-pass filter of a 1900MHz band as a band-pass filter of a 900MHz band and whose number is two can be constituted for surface acoustic wave filter equipment 113 using the same piezo-electricity substrate 112, and the miniaturization of a band-pass filter can be attained.

[0185] In addition, although connection with the electrode pattern connected with the electrode pad on a piezo-electric substrate at the electrode pattern and ground potential of the shape of a package which is not illustrated is made by the bonding wire in drawing 25, you may connect electrically by approaches other than a bonding wire.

[0186] Drawing 26 is the outline block diagram in the transmitter using the surface acoustic wave filter equipment 111 shown in drawing 25 showing an antenna common machine. Here, common connection of the input edge of surface acoustic wave filter equipment 113,114 is made at Antenna ANT. And let the outgoing ends of surface acoustic wave filter equipment 113,114 be the transmitting-side outgoing end Tx and the receiving-side outgoing end Rx, respectively.

[0187] In addition, although the filter with which frequencies differ consisted of drawing 25 using the same piezo-electric substrate 112, as shown in drawing 27, the surface acoustic wave filter equipment 113,114 with which frequencies differ may be constituted using different piezo-electric substrates 112a and 112b, respectively. Here, the surface acoustic wave filter equipment 113,114 constituted using different piezo-electric substrates 112a and 112b is contained in a package 116, respectively.

[0188] Drawing 30 -32 are each bottom view for explaining the example of further others of the surface acoustic wave filter equipment concerning this invention, respectively. The surface acoustic wave filter equipment 301 shown in drawing

30 has the case material 302 currently illustrated. The case material 302 is a tabular case substrate in this example, and the surface acoustic wave filter equipment applied to this invention with a flip-chip-bonding method of construction is carried in the field of the side which is not illustrated. [0189] One external input terminal 303 for connecting with surface acoustic wave filter equipment electrically, and connecting with the exterior electrically and two external output terminals 304,305 are formed in inferior-surface-of-tongue 302a of the above-mentioned case material 302. In this case, the external input terminal 303 is connected to the unbalance signal terminal of surface acoustic wave filter equipment, and the external output terminal 304,305 is electrically connected to the balanced signal terminal of the pair of surface acoustic wave filter equipment. In this example, two external output terminals 304,305 are arranged to the external input terminal 303 at the approximate line symmetry through the symmetry axis shown with the broken line of illustration. Thus, unbalance is raised by arranging two external output terminals 304,305 to the approximate line symmetry to the external input terminal 303. [0190] In addition, between two external output terminals 304,305, preferably, the grounding terminal 306 is arranged and unbalance is further raised in the center by it. Moreover, the grounding terminal 307,308 is preferably arranged in the center between the external input terminal 303 and the external output terminal 305 between the external input terminal 303 and the external output terminal 304. respectively, and it is supposed that it is possible to control a part for the direct achievement between external I/O terminals by it. [0191] In the surface acoustic wave filter equipment 311 shown in drawing 31,

the external output terminal 314,315 is similarly arranged to the external input terminal 313 at the approximate line symmetry. Therefore, unbalance can be raised like the surface acoustic wave filter equipment 301 shown in drawing 30. Here, the grounding terminal 316,317 is arranged between the external input terminal 313 and the external output terminal 314,315, and control for direct achievement between input/output terminals is achieved by it.

[0192] In addition, although the tabular case material 302,312 is used, the configuration of case material may not be limited to this, but case material may be constituted from drawing 30 and 31 by the package which seals surface acoustic wave filter equipment.

[0193] Moreover, the inferior surface of tongue of the piezo-electric substrate 322 is shown by the surface acoustic wave filter equipment 321 shown in drawing 32. The surface acoustic wave filter element is constituted at the top-face side of this piezo-electric substrate 322. The external input terminal 323 which is electrically connected to a surface acoustic wave filter element, and is used as an unbalance signal terminal is formed in the inferior surface of tongue of the piezo-electric substrate 322 with the electric conduction film. Moreover, two external output terminals 324,325 used as a balanced signal terminal are formed so that it may be located in the approximate line symmetry to the external input terminal 323. Also in surface acoustic wave filter equipment 321, the grounding terminal 326 is arranged in the center between two external output terminals 324,325, and unbalance is further raised by it. Moreover, between the external input terminal 323 and the external output terminal 324 and between the external input terminal 323 and the external output terminal 325, the grounding terminal 327,328 is arranged and control for direct achievement is achieved, respectively. [0194] Drawing 33 is each outline block diagram for explaining the transmitter 160 using the surface acoustic wave equipment concerning this invention. The duplexer 162 is connected to the antenna 161 in drawing 33. The surface acoustic wave filter 164 and amplifier 165 which constitute RF stage between a duplexer 162 and the receiving-side mixer 163 are connected. Furthermore, the surface wave filter 169 of IF stage is connected to the mixer 163. Moreover, between the duplexer 162 and the mixer 166 of a transmitting side, the amplifier 167 and the surface acoustic wave filter 168 which constitute RF stage are connected.

[0195] The surface acoustic wave equipment constituted according to this invention as a surface wave filter 164,168 in the above-mentioned transmitter

160 can be used suitably.

[0196]

[Effect of the Invention] According to the surface acoustic wave filter equipment concerning the 1st invention, the transmission amplitude characteristic in the band of the 2nd and 3rd surface acoustic wave filter element is carrying out abbreviation coincidence. It is constituted so that transmission phase characteristics may differ 180 degrees of abbreviation. At least one IDT of the 2nd surface acoustic wave filter element. Since it connects with at least one IDT of the 1st surface acoustic wave filter element, at least one IDT of the 3rd surface acoustic wave filter element The surface acoustic wave filter equipment which has balanced - unbalance conversion function can be constituted by using as a balanced terminal the terminal by which the terminal connected to the 1st surface acoustic wave filter element is connected to the unbalance terminal, 2nd, and 3rd surface acoustic wave filter element. In this case, according to the 1st invention, balanced - unbalance conversion function is realized by using three surface acoustic wave filter elements to having needed four surface acoustic wave filter elements conventionally. Therefore, the miniaturization of surface acoustic wave filter equipment which has balanced - unbalance conversion function, and reduction of cost can be achieved.

[0197] Moreover, since the number of surface acoustic wave filter elements can be reduced, parasitic capacitance can be reduced and it is hard to produce degradation of unbalance by it. Therefore, broadband-izing is also easy. [0198] With the surface acoustic wave filter equipment concerning the 2nd invention The transmission amplitude characteristic in the band of the 2nd and 3rd surface acoustic wave filter element carries out abbreviation coincidence. It is constituted so that transmission phase characteristics may differ 180 degrees of abbreviation. The 2nd IDT of the 1st surface acoustic wave filter element Since it connects with the 2nd surface acoustic wave filter element and the 3rd IDT of the 1st surface acoustic wave filter element and the 3rd surface acoustic wave filter element The surface acoustic wave filter equipment which

has balanced - unbalance conversion function can be constituted by using as a balanced terminal the terminal by which the terminal connected to the 1st surface acoustic wave filter element is connected to the unbalance terminal, 2nd, and 3rd surface acoustic wave filter element. In this case, according to the 2nd invention, balanced - unbalance conversion function is realized by using three surface acoustic wave filter elements to having needed four surface acoustic wave filter elements conventionally. Therefore, the miniaturization of surface acoustic wave filter equipment which has balanced - unbalance conversion function, and reduction of cost can be achieved.

[0199] Moreover, since the number of surface acoustic wave filter elements can be reduced, parasitic capacitance can be reduced and it is hard to produce degradation of unbalance by it. Therefore, broadband-izing is also easy. [0200] In the surface acoustic wave filter equipment concerning the 2nd invention, when the 1st spacing and 2nd spacing are constituted 0.48lambda-0.525lambda So that it may differ, unbalance of 1.5dB or less and a phase can be made into 20 degrees or less for the unbalance of the amplitude, and degradation of unbalance can be prevented certainly.

[0201] When the 1st spacing and 2nd spacing fill a formula 1 and a formula 2, they can obtain sufficient bandwidth and can control degradation of unbalance, respectively. Furthermore, in the surface acoustic wave filter equipment concerning the 2nd invention, when the 1st and 2nd spacing is chosen so that a formula 3 and a formula 4 may be filled, even if it takes into consideration the frequency drift by the temperature change, sufficient bandwidth can be obtained and aggravation of unbalance can be controlled.

[0202] Furthermore, when 1.72lambda-1.83lambda, and the 2nd spacing are in the range of 2.22lambda-2.33lambda about the 1st spacing, aggravation of unbalance can be controlled more certainly and bandwidth can be made into sufficient size.

[0203] It sets to the surface acoustic wave filter equipment concerning the 2nd invention, and is LiTaO3. LiTaO3 which is rotating the single crystal from the Y-

axis in 36-44 degrees to Z shaft orientations focusing on the X-axis A substrate is used. When electrode coverage in spacing in which at least one electrode finger is inserted in at least one spacing among the 1st and 2nd spacing, and this electrode finger was inserted is made into 50% or more, the Leakey wave spreads around and can aim at reduction of an insertion loss by it. Especially, when electrode coverage is 63% or more, an insertion loss can be reduced further.

[0204] In the surface acoustic wave filter equipment concerning the 2nd invention, when [on which spacing between the 1st reflector and the 2nd reflector spreads spacing of the 3rd reflector and the 4th reflector, abbreviation, etc.] carried out, the filter shape of the 2nd surface acoustic wave filter element and the 3rd surface acoustic wave filter element becomes almost equal, and can control degradation of unbalance more certainly.

[0205] With the surface acoustic wave filter equipment concerning the 3rd invention It has the 3rd surface acoustic wave filter element, and the 2nd surface acoustic wave filter element is connected to the 2nd IDT of the 1st surface acoustic wave filter element, the 1- The 3rd surface acoustic wave filter element is connected to the 3rd IDT of the 1st surface acoustic wave filter element. The 2nd IDT of the 1st surface acoustic wave filter element. Since about 180 degrees of phase contrast over the 3rd input or output of IDT differ in a passband The surface acoustic wave filter equipment which has balanced - unbalance conversion function can be constituted by using as a balanced terminal the terminal by which the terminal connected to the 1st surface acoustic wave filter element is connected to the unbalance terminal, 2nd, and 3rd surface acoustic wave filter element. In this case, according to the 3rd invention, balanced unbalance conversion function is realized by using three surface acoustic wave filter elements to having needed four surface acoustic wave filter elements conventionally. Therefore, the miniaturization of surface acoustic wave filter equipment which has balanced - unbalance conversion function, and reduction of cost can be achieved

[0206] Moreover, since the number of surface acoustic wave filter elements can be reduced, parasitic capacitance can be reduced and it is hard to produce degradation of unbalance by it. Therefore, broadband-izing is also easy.

[0207] In the surface acoustic wave filter equipment concerning the 3rd invention, when only .048lambda-0.525 lambda differs, the 1st and 2nd spacing can make unbalance of 1.5dB or less and a phase 20 degrees or less for the unbalance of the amplitude, and can prevent degradation of unbalance certainly.

[0208] In the surface acoustic wave filter equipment concerning the 3rd invention, when the 1st and 2nd spacing fills formulas 1 and 2, sufficient bandwidth can be obtained and degradation of unbalance can be controlled.

[0209] In the 3rd invention, when the 1st and 2nd spacing fills formulas 3 and 4, even if it takes into consideration the frequency drift by the temperature change, sufficient bandwidth can be obtained and aggravation of unbalance can be controlled.

[0210] When the 1st spacing is in the range of 1.72lambda-1.88lambda and the 2nd spacing is in the range of 2.22lambda-2.33lambda, aggravation of unbalance can be controlled more certainly and bandwidth can be made into sufficient size. [0211] In the surface acoustic wave filter equipment concerning the 3rd invention, when distance from the core of the 1st IDT to the 1st reflector and distance from the core of the 1st IDT to the 2nd reflector are made equal, degradation of unbalance can be controlled more certainly.

[0212] every from which the electrode finger crossover width of face of IDT which constitutes the 1st surface acoustic wave filter element constitutes the 2nd surface acoustic wave filter element and the 3rd surface acoustic wave filter element in the surface acoustic wave filter equipment concerning the 1-3rd invention -- when it is in the 1.5 to 3.5 times as much range as the electrode finger crossover width of face of IDT, aggravation of the VSWR value in a passband can be controlled.

[0213] With the surface acoustic wave filter equipment concerning the 4th invention The transmission characteristic in the passband of the 2nd surface

acoustic wave filter element is carrying out abbreviation coincidence with the transmission amplitude characteristic of the 1st surface acoustic wave filter element. It is constituted so that transmission phase characteristics may differ the 1st surface acoustic wave filter element and 180 degrees of abbreviation. One terminal of the 1st and 2nd surface acoustic wave filter element is electrically connected to juxtaposition. Since the terminal by which the terminal which the other-end child is electrically connected to the serial, and is connected to juxtaposition is connected to the unbalance terminal and the serial constitutes the balanced terminal, balanced - unbalance conversion function is realized like the surface acoustic wave filter equipment concerning the 1st - the 3rd invention. And since it is constituted using two surface acoustic wave filter elements, a miniaturization and low cost-ization can be achieved further.

[0214] Moreover, in the surface acoustic wave filter element concerning the 4th invention, when the 1st and 2nd spacing 0.48lambda-0.525lambda Differs, unbalance of 1.5dB or less and a phase can be made into 20 degrees or less for the unbalance of the amplitude, and degradation of unbalance can be prevented certainly.

[0215] In the surface acoustic wave filter equipment concerning the 4th invention, when the 1st and 2nd spacing fills formulas 1 and 2, it can obtain sufficient bandwidth and can control degradation of unbalance.

[0216] Moreover, when the 1st and 2nd spacing fills formulas 3 and 4, even if it takes into consideration the frequency drift by the temperature change, sufficient bandwidth can be obtained and aggravation of unbalance can be controlled.

[0217] Moreover, in the 4th invention, when the 1st spacing is in the range of 1.72lambda-1.88lambda and the 2nd spacing is in the range of 2.22lambda-2.33lambda, aggravation of unbalance can be controlled more certainly and bandwidth can be made into sufficient size.

[0218] It also sets to the 4th invention and a piezo-electric substrate is LiTaO3. LiTaO3 which is rotating the single crystal from the Y-axis in 36-44 degrees to Z shaft orientations focusing on the X-axis A substrate is used. When electrode

coverage in spacing in which at least one electrode finger is inserted in at least one spacing among the 1st and 2nd spacing, and this electrode finger was inserted is made into 50% or more, the Leakey wave spreads around and can aim at reduction of an insertion loss by it. Especially, when electrode coverage is 63% or more, an insertion loss can be reduced further.

[0219] In the surface acoustic wave filter equipment concerning the 4th invention, when [on which spacing between the 1st reflector and the 2nd reflector spreads spacing of the 3rd reflector and the 4th reflector, abbreviation, etc.] carried out, the filter shape of the 2nd surface acoustic wave filter element and the 3rd surface acoustic wave filter element becomes almost equal, and can control degradation of unbalance more certainly.

[0220] In the surface acoustic wave filter equipment concerning the 4th invention, when the terminal connected to the unbalance side of the 1st surface acoustic wave filter element and the terminal connected to the unbalance side of the 2nd surface acoustic wave filter element are connected by the electrode pattern on the piezo-electric substrate, reduction of parasitic capacitance can be aimed at and much more reduction of an insertion loss can be aimed at by it. [0221] The surface acoustic wave filter equipment concerning the 5th invention It has one surface acoustic wave filter element which has the 1st - the 3rd IDT. The 1st spacing between 1st and 2nd IDT, Since the 2nd spacing between 1st and 3rd IDT fills formulas 1 and 2, the 1st IDT constitutes an unbalance terminal and the 2nd and 3rd IDT is connected to the balanced terminal, the surface acoustic wave filter equipment which has balanced - unbalance conversion function can be constituted. In this case, according to the 5th invention, balanced - unbalance conversion function is realized by using one surface acoustic wave filter element to having needed four surface acoustic wave filter elements conventionally. Therefore, the miniaturization of surface acoustic wave filter equipment which has balanced - unbalance conversion function, and reduction of cost can be achieved.

[0222] Moreover, since the number of surface acoustic wave filter elements can

be reduced, parasitic capacitance can be reduced and it is hard to produce degradation of unbalance by it. Therefore, broadband-izing is also easy.

[0223] Moreover, also in the 5th invention, since the 1st and 2nd spacing is made into the above-mentioned specific range, like the 1st invention, sufficient bandwidth can be realized and unbalance is also improved.

[0224] In the surface acoustic wave filter equipment concerning the 5th invention, at least one float electrode finger is inserted in the 1st and 2nd spacing, and when electrode coverage in this field is made into 50% or more, reduction of an insertion loss can be aimed at.

[0225] Especially, when the above-mentioned electrode coverage is 63% or more, an insertion loss can be reduced further. In this invention, when the surface acoustic wave resonator is connected to the serial at the unbalance terminal side, the magnitude of attenuation outside a passband can be improved.
[0226] Similarly, the magnitude of attenuation out of band is improvable by connecting a surface acoustic wave resonator to each terminal by the side of a balanced terminal at a serial, respectively. Moreover, when it has the surface acoustic wave filter of ladder mold circuitry concatenated at the balanced terminal side, the magnitude of attenuation and selectivity can be further raised by arranging the attenuation pole of this ladder mold surface acoustic wave filter to a low-pass [of a passband], and high region side. Furthermore, the magnitude of attenuation outside a passband can be expanded, without being able to make each effect of a balanced terminal equal, and worsening unbalance by the surface acoustic wave resonator connected to juxtaposition between balanced terminals.

[0227] In the surface acoustic wave equipment concerning this invention, in the structure which contained in the package the chip with which the surface acoustic wave filter element is constituted, when at least one of the electrode pattern formed on the piezo-electric substrate, a package, and the current carrying parts has the structure of the approximate line symmetry, aggravation of unbalance can be controlled by it.

[0228] When at least two of an electrode pattern, a package, and current carrying parts are especially made into the approximate line symmetry to the same symmetry axis, aggravation of unbalance can be controlled further.

[0229] furthermore, with the surface acoustic wave filter equipment concerning this invention It has the case material by which the chip with which the surface acoustic wave filter element is constituted is carried by flip chip bonding on a piezo-electric substrate. To this case material One external input terminal or an external output terminal, Two external output terminals or an external input terminal is prepared, and one external input terminal or an external output terminal is received. When two external output terminals or an external input terminal is arranged at the approximate line symmetry, or when being arranged electrically at the symmetry, unbalance can be raised further.

invention, when at least one grounding terminal is arranged between the abovementioned external input terminal and the external output terminal, control for direct achievement between input/output terminals can be aimed at. Furthermore, when at least one grounding terminal is arranged between the two abovementioned external output terminals or external input terminals, it can also raise

[0231] Furthermore, the surface wave filter equipment concerning this invention can be used for the communication device which has a common machine and this common machine as mentioned above, and it can attain the miniaturization of a common machine or a communication device.

[Translation done.]

* NOTICES *

JPO and NCIPI are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.**** shows the word which can not be translated.

3.In the drawings, any words are not translated.

DESCRIPTION OF DRAWINGS

[Brief Description of the Drawings]

[Drawing 1] The schematic-drawing-top view showing the electrode structure of the surface acoustic wave filter equipment of the 1st example.

[Drawing 2] Drawing showing the filter shape of the surface acoustic wave filter equipment of the 1st example, and the surface acoustic wave filter equipment of the conventional example.

[Drawing 3] Drawing showing the VSWR property by the side of the unbalance terminal in the 1st surface acoustic wave filter equipment and conventional surface acoustic wave filter equipment of an example.

[Drawing 4] Drawing showing the 1st example and the VSWR property by the side of the balanced terminal of conventional surface acoustic wave filter equipment.

[Drawing 5] Drawing showing the relation between spacing between adjacent IDT(s), and amplitude unbalance.

[Drawing 6] Drawing showing the relation between spacing between adjacent IDT(s), and phase unbalance.

[Drawing 7] Drawing showing the relation between spacing between adjacent IDT(s), and bandwidth.

[Drawing 8] Drawing showing the relation between spacing between adjacent IDT(s), and band interpolation close loss.

[Drawing 9] Drawing showing the relation between spacing between adjacent IDT(s), and amplitude unbalance.

[Drawing 10] Drawing showing the relation between spacing between adjacent

IDT(s), and phase unbalance.

[Drawing 11] Drawing showing the relation between an electrode finger crossover width-of-face ratio and the bandwidth which has the 4.0dB magnitude of attenuation.

[Drawing 12] Drawing showing relation with VSWR with an electrode finger crossover width-of-face ratio.

[Drawing 13] The schematic-drawing-top view showing the electrode structure of the surface acoustic wave filter equipment of the 2nd example of this invention. [Drawing 14] The schematic-drawing-top view showing the electrode structure of the surface acoustic wave filter equipment of the 3rd example of this invention. [Drawing 15] The schematic-drawing-top view showing the electrode structure of the surface acoustic wave filter equipment of the 4th example of this invention. [Drawing 16] Drawing showing the filter shape of the surface acoustic wave filter equipment of the 4th example.

[Drawing 17] The schematic-drawing-top view showing the electrode structure of the surface acoustic wave filter equipment of the 5th example of this invention. [Drawing 18] The schematic-drawing-top view showing the electrode structure of the surface acoustic wave filter equipment of the 6th example of this invention. [Drawing 19] The schematic-drawing-top view showing the electrode structure of the surface acoustic wave filter equipment of the 7th example of this invention. [Drawing 20] The schematic-drawing-top view showing the electrode structure of the surface acoustic wave filter equipment of the 8th example of this invention. [Drawing 21] Drawing showing the filter shape of each surface acoustic wave filter equipment of the 4th example and the 8th example.

[Drawing 22] The schematic-drawing-top view showing the electrode structure of the surface acoustic wave filter equipment of the 9th example of this invention. [Drawing 23] The schematic-drawing-top view showing the electrode structure of the surface acoustic wave filter equipment of the 10th example of this invention. [Drawing 24] The decomposition perspective view for explaining the surface acoustic wave filter equipment of the 11th example of this invention.

[Drawing 25] The typical top view for explaining the surface acoustic wave filter equipment concerning the 12th example of this invention.

[Drawing 26] The outline block diagram for explaining the antenna common machine constituted using the surface acoustic wave filter equipment concerning the 12th example.

[Drawing 27] The outline block diagram for explaining the surface acoustic wave filter equipment concerning the modification of the 12th example.

[Drawing 28] The schematic-drawing-top view for explaining an example of conventional surface acoustic wave filter equipment.

[Drawing 29] The schematic-drawing-top view showing other examples of conventional surface acoustic wave filter equipment.

[Drawing 30] It is drawing for explaining other examples of the surface acoustic wave filter equipment concerning this invention, and is the bottom view of case material.

[Drawing 31] It is drawing for explaining the example of further others of the surface acoustic wave filter equipment of this invention, and is the bottom view of case material.

[Drawing 32] It is drawing for explaining other examples of the surface acoustic wave filter equipment concerning this invention, and is the bottom view of a piezo-electric substrate.

[Drawing 33] The outline block diagram for explaining the transmitter with which the surface acoustic wave equipment concerning this invention is used.

[Description of Notations]

1 - 3 -- the 1- the 3rd surface acoustic wave filter element

1a, 2a, 3a -- The 1st IDT

1b, 2b, 3b -- The 2nd IDT

1c, 2c, 3c -- The 3rd IDT

1d, 1e-3d, 3e -- Reflector

[Translation done.]

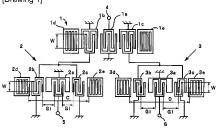
* NOTICES *

JPO and NCIPI are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

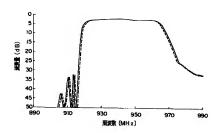
- 1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.**** shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

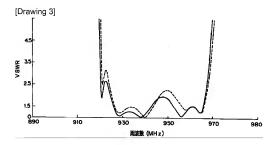
DRAWINGS

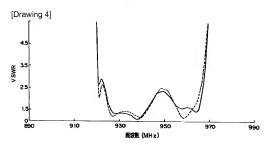
[Drawing 1]

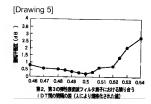


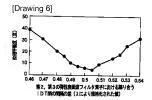
[Drawing 2]

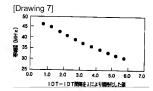


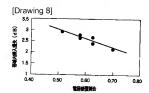


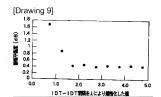


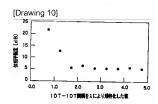


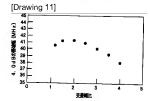


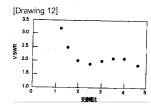


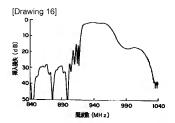


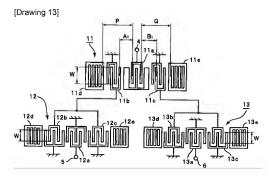




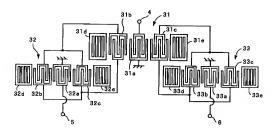


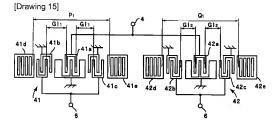


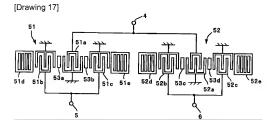




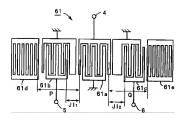
[Drawing 14]



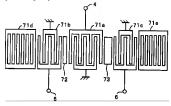




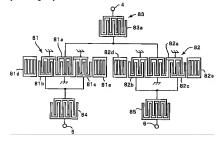
[Drawing 18]



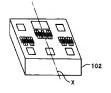
[Drawing 19]

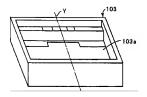


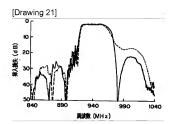
[Drawing 20]



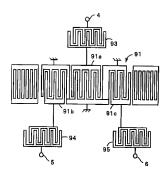
[Drawing 24]



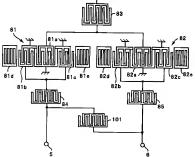




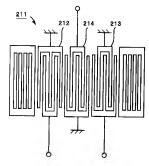
[Drawing 22]



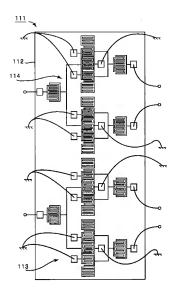




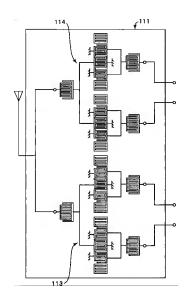
[Drawing 29]

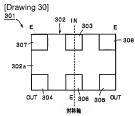


[Drawing 25]

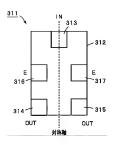


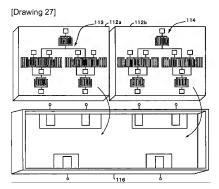
[Drawing 26]



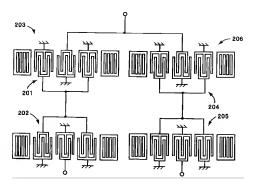


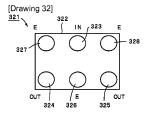
[Drawing 31]

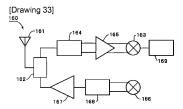




[Drawing 28]







[Translation done.]		

(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号 特開2001-308672

(P2001-308672A) (43)公開日 平成13年11月2日(2001.11.2)

(51) Int.Cl.7		織別部 号	FΙ		テーマコート*(参考)
H03H	9/145		H03H	9/145	Z 5J097
	9/64			9/64	Z

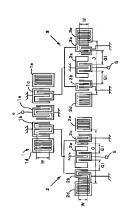
		審查請求	未請求 請求項の数44 OL (全 31 頁)
(21)出順番号	特膜2001-35620(P2001-35620)	(71)出願人	000006231
			株式会社村田製作所
(22) 出顧日 平成13年2月13日(2001.2.13)			京都府長阿京市天神二 「目26番10号
		(72)発明者	沢田 唯一
(31)優先権主張番号	特願2000-35299 (P2000-35299)		京都府長岡京市天神二丁目26番10号 株式
(32) 優先日	平成12年2月14日(2000.2.14)		会社村田製作所内
(33)優先權主張国	日本 (JP)	(72)発明者	高崎 洋
			京都府長岡京市天神二丁目26番10号 株式
			会社村田製作所内
		(74)代理人	100086597
			弁理士 宮▼崎▲ 主税
		Fターム(参考) 5J097 AA01 AA12 AA33 BB14 CC05	
			DD04 DD12 DD14 GC93 KK04

(54) 【発明の名称】 弾性表面波フィルタ装置

(57)【要約】

【課題】 広帯域であり、平衡度が良好であり、平衡-不平衡入出力変換機能を有する弾性表面波フィルタ装置 を提供する。

【解決手段】 圧電基板上に第1~第3の弾性表面波フ ィルタ素子1~3が構成されており、第2,第3の弾性 表面波フィルタ素子2,3は、帯域内における伝送振幅 特性が略一致しており、伝送位相特性が略180。異な るように構成されており、第2の弾性表面波フィルタ素 子の少なくとも1つのIDT2b, 2c及び第3の弾性 表面波フィルタ素子3の少なくとも1つのIDT3b. 3 cが、第1の弾性表面波フィルタ素子1の少なくとも 1つのIDT1b, 1 cに接続されている、弾性表面波 フィルタ装置.



【特許請求の範囲】

【請求項1】 圧電基板と、

前記圧電基板上に構成された第1~第3の弾性表面波フ ィルタ素子とを備え、各弾性表面波フィルタ素子が、弾 性表面波の伝搬方向に沿って形成された複数のIDTを 有し、

前記第2、第3の弾性表面波フィルタ素子は、帯域内に おける伝送振輻特性が略一致しており、伝送位相特性が 略180°異なるように構成されており、

前記第2の弾性表面波フィルタ素子の少なくとも1つの IDTと 第3の弾性表面波フィルタ素子の少なくとも 1つのIDTとが、それぞれ第1の弾性表面波フィルタ 素子の少なくとも1つのIDTに接続されていることを 特徴とする、弾性表面波フィルタ装置。

【請求項2】 圧雷基板と

前記圧電基板に形成された第1~第3の弾性表面波フィ ルタ素子とを備え、

第1の弾性表面波フィルタ素子が、弾性表面波の伝搬方 向に沿って形成された第1のIDTと、第1のIDTの 表面波伝搬方向両側に配置された第2,第3のIDTと を有し、

前記第2. 第3の弾性表面波フィルタ素子が、弾性表面 波の伝搬方向に沿って配置された複数のIDTを有し、

前記第2.第3の弾性表面波フィルタ素子の帯域内にお ける伝送振幅特性が略一致し、伝送位相特性が略180 異なるように構成されており、

第1の弾性表面波フィルタ素子の第2のIDTが第2の 弾性表面波フィルタ素子に接続されており、第1の弾性 表面波フィルタ素子の第3のIDTが第3の種件表面波 フィルタ素子のIDTに接続されていることを特徴とす 4. 弾件表面波フィルタ装置。

【請求項3】 前記第1~第3の弾性表面波フィルタ素 子が、それぞれ、1つのIDTと、該IDTの表面波伝 搬方向面側に配置された2つのIDTとを有し、

第2の弾性表面波フィルタ素子における第1の弾性表面 波フィルタ素子に接続されている I DTと、 該 I DTと 隣接する I D T との間の第1の間隔に比べ、

第3の弾性表面波フィルタ素子における第1の弾性表面 波フィルタ素子に接続されているIDTと、該IDTと 隣接する I D T との間の第2の間隔が、弾性表面波の波 長を λ としたときに、 0.48λ ~ 0.525λ 異なる ことを特徴とする、請求項2に記載の弾性表面波フィル タ装置.

【請求項4】 前記第1の間隔が、

【請求項5】 前記第1の間隔が、

【数1】

【数2】

【数3】

£ (1)

 $(n/2+1, 22) \times \lambda \sim (n/2+1, 33) \times \lambda$ $(n=0 \sim 4 の整数)$

であり.

前記第2の間隔が、

£ (2)

 $(n/2+1, 72) \times \lambda \sim (n/2+1, 83) \times \lambda$ $(n=0 \sim 4 の整数)$

であることを特徴とする、請求項3に記載の弾件表面波 フィルタ装置.

£ (8)

 $(n/2+1, 22) \times \lambda \sim (n/2+1, 33) \times \lambda$ (n=0~2の整数)

【数4】

前記第2の問題が、

であり、

A (4)

 $(n/2+1, 72) \times \lambda \sim (n/2+1, 83) \times \lambda$ (n=0~2の整数)

であることを特徴とする、請求項4に記載の弾性表面波 フィルタ装置。

【請求項6】 前記第1の間隔が、1.72λ~1.8 3人の範囲であり、前記第2の間隔が2、22人~2、 33人の範囲にある。請求項5に記載の強性表面波フィ ルタ装置。

【請求項7】 前記圧電基板が、LiTaO。単結晶が X軸を中心にY軸からZ軸方向に36~44°の範囲で 回転されているLiTaO。基板であり、

前記第1の間隔と第2の間隔のうち少なくとも1つの間 隔における電極被覆率が50%以上とされている。請求 項3~6に記載の弾性表面波フィルタ装置。

【請求項8】 前記電極被覆率が、63%以上である。

請求項7に記載の弾性表面波フィルタ装置。

【請求項9】 前記第2の確性表面波フィルタ素子にお いて複数のIDTが設けられている領域の表面波伝搬方 向両側に第1、第2の反射器がそれぞれ設けられてお

前記第3の弾性表面波フィルタ素子において複数のID 丁が設けられている領域の表面波伝搬方向面側に第3. 第4の反射器がそれぞれ設けられており、

第1の反射器と第2の反射器との間隔が、第3の反射器 と第4の反射器との間隔と略等しくされている、請求項 3~8のいずれかに記載の確性表面波フィルタ装置。 【請求項10】 圧雷基板と

前記圧電基板上に構成された第1~第3の弾性表面波フ

ィルタ素子とを備え、

前記第1の弾性表面波フィルタ素子が、第1のIDT と、第1のIDTの表面波伝搬方向両側に配置された第 第3のIDTとを有し、

第2の弾性表面波フィルタ素子が第1の弾性表面波フィ ルタ素子の第2のIDTに接続されており、

第3の弾性表面波フィルタ素子が、第1の弾性表面波フ ィルタ素子の第3のIDTに接続されており、

第1の弾性表面波フィルタ素子の第2のIDTと、第3 のIDTの入力または出力に対する位相差が、通過帯域 内において約180。異なる。 種性表面波フィルタ装 置。

£ (1)

 $(n/2+1, 22) \times \lambda \sim (n/2+1, 33) \times \lambda$ (n=0~4の整数)

であり、前記第2の間隔が、 【数6】

£(2)

 $(n/2+1, 72) \times \lambda \sim (n/2+1, 83) \times \lambda$ (n=0~4の整数)

である、請求項11に記載の弾性表面波フィルタ装置。 【数7】 【請求項13】 前記第1の間隔が、

 $(n/2+1, 22) \times \lambda \sim (n/2+1, 33) \times \lambda$ (n=0~2の整数)

であり、前記第2の間隔が、

(n/2+1. 72)×λ~ (n/2+1. 83)×λ (n=0~2の整数)

である、請求項12に記載の弾性表面波フィルタ装置。 【請求項14】 前記第1の間隔が、1.72λ~1. 88人の範囲にあり、前記第2の間隔が2.22人~

 33人の範囲にあることを特徴とする。請求項13 に記載の弾性表面波フィルタ装置。

【請求項15】 前記圧電基板が、LiTaO。単結晶 がX軸を中心にY軸からZ軸方向に36~44°の範囲 で回転されているLiTaO。基板であり、

前記第1の弾性表面波フィルタ素子における第1の間隔 と第2の間隔のうち少なくとも1つの間隔における電極 被覆率が50%以上とされている。請求項11~14に 記載の弾件表面波フィルタ装置。

【請求項16】 前記電極被覆率が、63%以上であ る、請求項15に記載の弾性表面波フィルタ装置。

【請求項17】 前記第1の強件表面波フィルタ素子 が、複数のIDTが設けられている領域の表面波伝搬方 向両側に配置された第1、第2の反射器をさらに備え、 第1のIDTから第1の反射器までの距離と、第1のI DTから第2の反射器までの距離が略等しくされてい る、請求項10~16のいずれかに記載の弾性表面波フ ィルタ装置。

【請求項18】 前記第1の弾性表面波フィルタ素子を 構成している I D T の電極指交差幅が、第2の弾性表面 波フィルタ素子及び第3の弾性表面波フィルタ素子を構 成している各IDTの電極指交差幅の1.5~3.5倍 の範囲にある、請求項1~17のいずれかに記載の弾性

【請求項11】 前記第1の弾性表面波フィルタ素子の 第1, 第2のIDTの間の第1の間隔と、

前記第1の弾性表面波フィルタ素子の第1のIDTと第 3の LDTとの間の第2の間隔とが、弾性表面波フィル タの波長を入としたときに、0.48~0.525~ だけ異なり、それによって第1の弾件表面波フィルタ素 子の入力端との通過帯域内における位相差が約180° 異ならされていることを特徴とする。請求項10に記載 の弾性表面波フィルタ装置。

【請求項12】 前記第1の間隔が、

【数5】

表面波フィルタ装置。

【数8】

【請求項19】 圧電基板と、

前記圧電基板上に構成された第1,第2の弾性表面波フ

ィルタ素子とを備え、 前記第1の弾性表面波フィルタ素子が、表面波伝搬方向

前記第2の弾性表面波フィルタ素子が、弾性表面波伝搬 方向に沿って配置された複数のIDTを有し、

に沿って配置された複数のIDTを有し、

第2の弾性表面波フィルタ素子の通過帯域内における伝 送振輻特性が、第1の弾性表面波フィルタ素子の伝送振 幅特性と略一致しており、伝送位相特性が第1の強性表 面波フィルタ素子とは略180°異なるように構成され ており.

第1、第2の弾性表面波フィルタ素子の一方の端子が電 気的に並列に接続されており、他方の端子が電気的に直 列に接続されており、並列に接続されている端子が不平 衡端子、直列に接続されている前記端子が平衡端子を構 成している、弾性表面波フィルタ装置。

【請求項20】 前記第1,第2の弾性表面波フィルタ 素子が、3個のIDTをそれぞれ有し、

第1の弾性表面波フィルタ素子における中央に配置され た I D T と、両側に配置された I D T との間の第1の間 隔に比べて、

第2の弾性表面波フィルタ素子における中央に配置され たIDTと、両側に配置されたIDTとの間の第2の間 隔が、弾性表面波の波長を λ としたときに、 0.48λ ~0.525入異なることを特徴とする。請求項19に 【請求項21】 前記第1の間隔が、 記載の弾性表面波フィルタ装置。 【数9】 £ (1) $(n/2+1, 22) \times \lambda \sim (n/2+1, 33) \times \lambda$ (n=0~4の整数) であり、前記第2の間隔が、 【数10】 £ (2) (n/2+1, 72)×λ~(n/2+1, 83)×λ (n=0~4の整数) である。請求項20に記載の弾件表面波フィルタ装置。 【数11】 【請求項22】 前記第1の間隔が A (3) $(n/2+1, 22) \times \lambda \sim (n/2+1, 33) \times \lambda$ (n=0~2の整数)であり、前記第2の間隔が、 【数12】 £ (4) $(n/2+1, 72) \times \lambda \sim (n/2+1, 83) \times \lambda$ (n=0~2の裝数)である。詰求項21に記載の弾性表面波フィルタ装置。 第1の反射器と第2の反射器との間隔が、第3の反射器 【請求項23】 前記第1の間隔が、1.72λ~1. と第4の反射器との間隔と略等しくされている、請求項 88人の範囲にあり、前記第2の問題が2、22人~ 19~25のいずれかに記載の弾件表面波フィルタ装 33人の範囲にあることを特徴とする、請求項22 署. 【請求項27】 前記第1の弾性表面波フィルタ素子の に記載の弾件表面波フィルタ装置。 【請求項24】 前記圧電基板が、LiTaO。単結晶 不平衡側に接続される端子と、第2の弾性表面波フィル がX軸を中心にY軸からZ軸方向に36~44°の範囲 タ素子の不平衡側に接続される端子とが、圧電基板上に で回転されている36~44。回転YカットLiTaO おいて電極パターンにより接続されていることを特徴と する、請求項19~26のいずれかに記載の弾件表面波 基板であり、 前記第1の間隔と第2の間隔のうち少なくとも1つの間 フィルタ装置。 隔における電極被覆率が50%以上とされている。請求 【請求項28】 圧電基板と、前記圧電基板上に構成さ れており、第1のIDTと、第1のIDTの両側に配置 項20~23に記載の弾性表面波フィルタ装置。 【請求項25】 前記電極被覆率が、63%以上であ された第2、第3のIDTとを有する弾性表面波フィル 請求項24に記載の弾性表面波フィルタ装置。 タ素子とを備え. 【請求項26】 前記第1の弾性表面波フィルタ素子の 第1のIDTと、第2のIDTとの間の第1の間隔に比 複数のIDTの表面波伝搬方向両側に配置された第1. べて、第1のIDTと、第3のIDTとの間の第2の間 第2の反射器がさらに備えられており、 隔が、弾性表面波の波長を入としたときに、0.48入 前記第2の弾件表面波フィルタ素子において複数のID ~0.525λだけ異なり、 Tが設けられている領域の表面波伝搬方向両側に第3. 第1の間隔が. 第4の反射器がそれぞれ設けられており、 【数13】 (n/2+1, 22)×λ~(n/2+1, 33)×λ (n=0~4の整数) であり、前記第2の間隔が、 【数14】 \$ (2) $(n/2+1, 72) \times \lambda \sim (n/2+1, 83) \times \lambda$ (n=0~4の整数)であり、第1のIDTが不平衡端子に接続され、第2, 【請求項29】 前記第1の間隔が、 第3のIDTが平衡端子に接続されている。弾性表面波 【数15】 フィルタ装置. £ (3) $(n/2+1, 22) \times \lambda \sim (n/2+1, 33) \times \lambda$ (n=0~2の整数)であり、前記第2の間隔が、 【数16】 £ (4)

83 入であり、前記第20間隔が、2.22 入~2.3 【請求項31】 前記第1,第20間隔の内少なくとも

置.

 $(n/2+1, 72) \times \lambda \sim (n/2+1, 83) \times \lambda$ (n=0~2の整数)

3人である。請求項28に記載の弾性表面波フィルタ装

である、請求項28に記載の弾性表面波フィルタ装置。

【請求項30】 前記第1の問題が、1、72λ~1、

1つの間隔における電極被覆率が50%以上とされていることを特徴とする、請求項28~30のいずれかに記載の弾件表面波フィルタ装置。

【請求項32】 前記電極被覆率が63%以上とされている、請求項31に記載の弾性表面波フィルタ装置。

【請求項33】 前記第2、第3のIDTの外側に、それぞれ、第1、第2の反射器が配置されており、第1のIDTから第1の反射器分で配置されており、第1のIDTから第2の反射器までの距離が略等しくされている、請求項28~32のいずれかに記載の弾性表面波フィルタ装

【請求項34】 不平衡端子側に接続された直列共振子をさらに備える、請求項19~33のいずれかに記載の弾性表面波フィルタ装置。

【請求項35】 平街落予酬の名端子に直列にそれぞれ 接続された列性表面波共振子をさらに備える、請求項1 9~34のいずれかに配致の弾性表面波フルク表置。 【請求項36】 平街端予側に線続接続された梯子型弾 性表面波フィルクをさらに備える、請求項1~35のい すれかに配致の弾性表面波フィルク装置。

【請求項37】 前記圧電基板上に形成されており外部 と電気的に接続される電極パターンをさらに備え、

前記圧電基板上に前記弾性表面波フィルタ素子及び前記 電極パターンが構成されているチップが搭載されるケー ス材と、チップ上の電極パターンと前記電極パターンと パッケージとを電気的に接続するための導電部とをさら に備き

前記圧電差板上に形成された電極パターン、パッケージ 及び専電部の少なくとも1つが暗線対称の構造を有す る、請求項1~36のいずれかに記載の弾性表面波フィ ルタ装置。

【請求項38】 前記電極パターン、パッケージ及び導 電部のうち少なくとも2つが同一の対称軸に対して暗線 対称の構造を有する、請求項37に記載の弾性表面波フィルタ装置。

【請求項39】 前記圧電表族上に前記弾性表面級フィルタ素子が構成されているチッアがフリッアチップボンドィングにより搭載されるケース材をさらに備え、前記ケース材に、1つの外部人力端子または外部出力端子と、2つの外部出力端子または外部とり場所という。 1、前記2つの外部出力端子または外部人力端子が略終対角に記されている。 請記2つの外部出力端子または外部入力端子が略線対角に超されている。 請記2つの外部出力端子または外部入力端子が略線対角に超されている。 請求項1~36のいずれかに記載の弾性を振びまり、

【請求項40】 前記圧電旅板上に前記野性表面成フィルタ素子が構成されているチップがフリップチップボンディングにより搭載されるケース材をさらに備え、前記ケース材に、1つの外部入力端子または外部出力端子と、2つの外部川海子をたは外部入力端子とが設けられており、1つの外部入力端子と水では大力端子と大け外部出力端子に対いている。

し、前記2つの外部出力端子または外部入力端子が電気 的に略対称に配置されている、請求項1~36のいずれ かに記載の弾性表面波フィルタ装置。

【請求項41】 前記外部入力端子と前記外部出力端子 との間に、少なくとも1つ以上のアース端子が配置され ている、請求項39または40に記載の弾性表面波フィ ルタ装置。

【請求項42】 前記2つの外部出力端子の間または外 部入力端子の間に配置された少なくとも1つのアース端 子をさらに備える、請求項39~41のいずれかに記載 の強性表面波フィルタ装置。

【請求項43】 請求項1~42のいずれかに記載の弾性表面被フィルタを用いたことを特徴とする、共用器。 【請求項44】 請求項1~42に記載の弾性表面被フィルタ装置または請求項43に記載の共用器を用いたこ

とを特徴とする、通信装置。 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、弾性表面波フィル タ装置に関し、より評細には、人力側及び出力側の特性 インピーダンスが繋なっており、かつ不平衡 - 平筒変換 機能を有する弾性表面波フィルタ装置に関する。

[0002]

【従来の技術】近年、携帯電話機の小型化及び軽量化が 進んでおり、各構成部品の削減や小型化だけでなく、複 数の機能を複合した部品の開発が進んできている。

【0003】上記のような状況に鑑み、携帯電話機のR F段に使用される弾性表面波フィルタに、平衡-不平衡 変換機能、いわゆるバラン機能を持たせたものが研究さ れており、GSMなどを中心に使用されるようになって きている。

【0004】携帯電話機のアンテナから帯域フィルタまでの部分は不平衡であり、50瓜の特性インビーダンスを有するのが一般的であり、フィルタの後段に使われる 物幅器などにおいては、平衛衛子で150~200瓜のインビーダンスを有することが多い。そこで、帯域フィルタとして弾性表面波フィルタを用い、該弾性表面波フィルタに、50瓜平衡から150~200m平筒に乗せる機能を併せ待たせたものが爆塞されている。

【0005】例えば、特開平10-117123号公報には、4個の弾性表面波フィルタ素子を用いることにより、不平衡九カー平衡出力が実現されている。この先行技術に記載の弾性表面波フィルタ素子201、202を2段緩能接続することにより構成された第1の弾性表面波フィルタ素子204と、該弾性表面波フィルタ素子204と、該弾性表面波フィルタ素子204とを経続接続している第2の弾性表面波フィルタスと25とを縦続接続してなる第2の弾性表面波フィルタネク部206が構成されている。各弾性表面波フィルタ部206が構成されている。各弾性表面波フィルタ部

203、206のそれぞれの入出力端子の一方が並列接 続され、他方が直列接続されており、並列接続端子が不 平衡端子、直列接続端子が平衡端子とされている。

【0006】また、特開平6-204781号公報に は、図29に示すように、3個のIDTを有する弾性表 面波フィルタ装置211が開示されている。この弾件表 面波フィルタ装置211では、両側の2個の出力側ID T212, 213の位相が反転するように配置されてお り、各IDT212、213の出力端子が平衡端子を構 成している。また、中央の入力側 I D T 2 1 4 の一端が 不平衡端子とされている。この構成においても、入力側 インピーダンスを50Ω、出力側インピーダンスを15 0~200Ωとすることができる。

[0007]

【発明が解決しようとする課題】上述した平衡-不平衡 入出力を有する弾性表面波フィルタにおいても、携帯電 話システムの帯域の拡大に伴い、広帯域化が要求されて いる。ところが、平衡-不平衡入出力を有する弾性表面 波フィルタにおいては、不平衡端子と平衡端子のそれぞ れの端子間の通過帯域内における伝送特性において、振 幅が等しくかつ位相が180。反転していること、いわ ゆる平衡度の向上が要求される.

【0008】しかしながら、特開平10-117123 号公報に開示されている弾性表面波フィルタ装置では、 広帯域化につれて、弾性表面波フィルタ素子の有するイ ンピーダンスが容量性となる性質を持つ。従って、該容 量性の性質に加えて、2段縦続接続されている段間の寄 生容量が加わり、弾性表面波フィルタ部間のインピーダ ンス不整合が生じがちであり、広帯域化が困難であっ

【0009】さらに、4個の弾性表面波フィルタ素子が 用いられているので、配線が複雑であり、該複雑な配線 によっても寄生容量が増加し、平衡度が劣化するという 問題があった。さらに、素子サイズが大型化し、デバイ ス自体の小型化が困難であり、かつ1枚のウエハーから 取得し得る弾性表面波フィルタ装置の数が少なくなるた め、コストが高くつくという問題があった。

【0010】他方、特開平6-204781号公報に記 載の弾性表面波フィルタ装置では、平衡端子を構成する ための2つのIDTの212,213の構造を異ならせ たり、IDT116、117の中央のIDT214に対 する位置関係が異ならされているので、平衡度が劣化し がちであった。また、平衡端子側のIDT212,21 3が電気的に直列に接続されているので、電極指が有す る抵抗値による損失分が増加し、通過帯域内の挿入損失 が大きくなるという問題もあった。

【0011】本発明の目的は、上述した従来技術の欠点

£ (1)

を解消し、広帯域であり、平衡度が良好であり、平衡-不平衡入出力を有する弾性表面波フィルタ装置を提供す ることにある。

[0012]

【課題を解決するための手段】本願の第1の発明に係る 弾件表面波フィルタ装置は、圧雷基板と、前記圧雷基板 上に構成された第1~第3の弾性表面波フィルタ素子と を備え、各弾性表面波フィルタ素子が、弾性表面波の伝 搬方向に沿って形成された複数の I D T を有し、前記第 2. 第3の弾性表面波フィルタ素子は、帯域内における 伝送振幅特性が略一致しており、伝送位相特性が略18 0°異なるように構成されており、前記第2の弾性表面 波フィルタ素子の少なくとも1つのIDTと、第3の弾 性表面波フィルタ素子の少なくとも1つのIDTとが、 第1の弾性表面波フィルタ素子の少なくとも1つのID Tに接続されていることを特徴とする。

【0013】本題の第2の発明に係る弾性表面波フィル タ装置は、圧電基板と、前記圧電基板に形成された第1 ~第3の弾性表面波フィルタ素子とを備え、第1の弾性 表面波フィルタ素子が、弾性表面波の伝搬方向に沿って 形成された第1のIDTと、第1のIDTの表面波伝搬 方向両側に配置された第2,第3のIDTとを有し、前 記第2、第3の弾件表面波フィルタ素子が、弾件表面波 の伝搬方向に沿って配置された複数のIDTを有し、前 記第2,第3の弾件表面波フィルタ素子の帯域内におけ る伝送振幅特性が略一致し、伝送位相特性が略180° 異なるように構成されており、第1の弾性表面波フィル タ素子の第2のIDTが第2の弾性表面波フィルタ素子 に接続されており、第1の弾性表面波フィルタ素子の第 3のIDTが第3の弾性表面波フィルタ素子のIDTに 接続されていることを特徴とする。

【0014】第2の発明に係る弾性表面波フィルタ装置 の特定の局面では、前記第1~第3の弾性表面波フィル タ素子が、それぞれ、1つの入力側 I D T と、入力側 I DTの表面波伝搬方向両側に配置された2つの出力側 I DTとを有し、第2の弾性表面波フィルタ素子における 第1の弾性表面波フィルタ素子に接続されている I D T と、出力端子とに接続されたIDTとの間の第1の間隔 に比べ、第3の弾性表面波フィルタ素子における第1の 弾性表面波フィルタ素子に接続されているIDTと出力 端子に接続されている I D T との間の第2の間隔が、弾 性表面波の波長を入としたときに、0.48入~0.5 25 入異なるように構成されている。

【0015】第2の発明に係る種性表面波フィルタ装置 のより特定の局面では、前記第1の間隔が、

[0016] 【数17】

(n/2+1, 22)×λ~ (n/2+1, 33)×λ (n=0~4の整数)

【0017】であり、前記第2の間隔が、

[0018]

1~第3の弾性表面波フィルタ素子とを備え、前記第1

の弾性表面波フィルタ素子が、第1のIDTと、第1の

IDTの表面波伝搬方向両側に配置された第2,第3の

IDTとを有し、第2の弾性表面波フィルタ素子が第1

の弾性表面波フィルタ素子の第2のIDTに接続されて

おり、第3の弾性表面波フィルタ素子が、第1の弾性表

面波フィルタ素子の第3のIDTに接続されており、第

1の弾性表面波フィルタ素子の第2のIDTと、第3の

IDTの入力または出力に対する位相差が、通過帯域内

【0027】第3の発明に係る弾性表面波フィルタ装置

の特定の局面では、前記第1の弾性表面波フィルタ素子

の第1,第2のIDTの間の第1の間隔と、前記第1の

弾性表面波フィルタ素子の第1の I D T と第3の I D T

との間の第2の間隔とが、弾性表面波フィルタの波長を

 λ としたときに、 0.48λ \sim 0.525λ だけ異な り、それによって第1の確性表面波フィルタ素子の入力

端との通過帯域内における位相差が約180°異ならさ

【0028】好ましくは、前記第1の間隔が、

において約180° 異なることを特徴とする。

【数18】

£ (2)

(n/2+1, 72)×λ~ (n/2+1, 83)×λ (n=0~4の整数)

【0019】である。より好ましくは、前記第1の間隔 [0020] 【数19】

が、

£ (3)

 $(n/2+1, 22) \times \lambda \sim (n/2+1, 33) \times \lambda$ (n=0~2の整数)

【0021】であり、前記第2の間隔が、 【数20】

[0022]

太(4)

 $(n/2+1, 72) \times \lambda \sim (n/2+1, 83) \times \lambda$ (n=0~2の整数)

【0023】である。さらに好ましくは、前記第1の間 隔が、1.72 入~1.83 入の範囲であり、前記第2 の間隔が2,22 A~2,33 Aの範囲にある。

【0024】第2の発明に係る弾性表面波フィルタ装置 の他の特定の局面では、前記圧電基板が、LiTaO。 単結晶がX軸を中心にY軸からZ軸方向に36~44° の範囲で回転されているLiTaO。基板であり、前記 第1の弾性表面波フィルタ素子における第1の間隔と第 2の間隔のうち少なくとも1つの間隔における電極被覆 率が50%以上とされている。

【0025】より好ましくは、上記電極被覆率が63% 以上とされる。第2の発明に係る弾性表面波フィルタ装 置のさらに他の特定の局面では、前記第2の弾性表面波 フィルタ素子の複数のIDTの表面波伝搬方向両側に配 置された第1,第2の反射器がさらに備えられており、 前記第3の弾性表面波フィルタ素子において複数のID Tが設けられている領域の表面波伝機方向両側に第3. 第4の反射器がそれぞれ設けられており、第1の反射器 と第2の反射器との間隔が、第3の反射器と第4の反射 器との間隔と略等しくされている。

【0026】本願の第3の発明に係る弾性表面波フィル 夕装置は、圧電基板と、前記圧電基板上に構成された第

(n/2+1, 22)× l~ (n/2+1, 33)× l (n=0~4の整数)

れている。

[0029]

【数21】

【数22】

【0030】であり、前記第2の間隔が、 [0031]

\$ (2)

 $(n/2+1, 72) \times \lambda \sim (n/2+1, 83) \times \lambda$ $(n=0 \sim 4 \phi 整数)$

【0032】であり、さらに好ましくは、前記第1の間 [0033] 隔が、 【数23】

£ (3)

(n/2+1, 22)×λ~ (n/2+1, 33)×λ (n=0~2の整数)

【0034】であり、前記第2の問題が、 【数24】 [0035]

£ (4)

(n/2+1, 72) × λ~ (n/2+1, 83) × λ (n=0~2の整数)

【0036】であり、より好ましくは、前記第1の間隔 が 1.722~1.882の範囲にあり、前記第2の 間隔が2、221~2、331の範囲にある。第3の発

明の弾性表面波フィルタ装置のさらに他の特定の局面で は、前記圧電基板が、LiTaO。単結晶がX軸を中心 にY軸からZ軸方向に36~44°の範囲で回転されて いるLiTaO。基板であり、前記第1の弾性表面波フ ィルタ素子における第1の間隔と第2の間隔のうち少な くとも1つの間隔における電極被覆率が50%以上とさ れている。

【0037】好ましくは、電極被覆率が63%以上とさ れる。第3の発明に係る弾性表面波フィルタ装置の他の 特定の局面では、前記第1の弾性表面波フィルタ素子 が、複数のIDTが設けられている領域の表面波伝搬方 向両側に配置された第1,第2の反射器をさらに備え、 第1のIDTの中心から第1の反射器までの距離と、第 1のIDTの中心から第2の反射器までの距離が略等し くされている。

【0038】第1~第3の発明に係る弾性表面波フィル タ装置の特定の局面では、前記第1の弾件表面波フィル タ素子を構成している IDTの電極指交差幅が、第2の 弾性表面波フィルタ素子及び第3の弾性表面波フィルタ 素子を構成している各IDTの電極指交差幅の1.5~ 3.5倍の範囲にある。

【0039】本願の第4の発明に係る弾件表面波フィル タ装置は、圧電基板と、前記圧電基板上に構成された第 1、第2の弾件表面波フィルタ素子とを備え、前記第1 の弾性表面波フィルタ素子が、表面波伝搬方向に沿って 配置された複数のIDTを有し、前記第2の弾件表面波 フィルタ素子が、弾性表面波伝搬方向に沿って配置され

\$ (1)

 $(n/2+1, 22) \times \lambda \sim (n/2+1, 33) \times \lambda$ (n=0~4の整数)

【0043】であり、前記第2の間隔が、 【数26】

[0044]

 $(n/2+1, 72) \times \lambda \sim (n/2+1, 83) \times \lambda$ $(n=0 \sim 4 \text{ Ø 整数})$

【0045】であり、より好ましくは、前記第1の間隔 [0046] が、 【数27】

式(3)

 $(n/2+1, 22) \times \lambda \sim (n/2+1, 33) \times \lambda$ (n=0~2の整数)

【0047】であり、前記第2の間隔が、 [0048]

£ (4)

 $(n/2+1, 72) \times \lambda \sim (n/2+1, 83) \times \lambda$ (n=0~2の整数)

【0049】であり、さらに好ましくは、前記第1の間 隔が、1.72 λ~1.88 λの範囲にあり、前記第2 の間隔が2,22A~2,33Aの範囲にある。第4の 発明に係る弾性表面波フィルタ装置の他の特定の局面で は、前記圧電基板が、LiTaO。単結晶がX軸を中心 にY動からZ動方向に36~44°の範囲で回転されて いる36~44°回転YカットLiTaO。基板であ り、前記第1の弾性表面波フィルタ素子における第1の 間隔と第2の間隔のうち少なくとも1つの間隔における 電極被覆率が50%以上とされている。この電極被覆率 は、より好ましくは63%以上とされる。

【0050】第4の発明に係る弾性表面波フィルタ装置

の他の特定の局面では、前記第2の強性表面波フィルタ 素子の複数のIDTの表面波伝搬方向両側に配置された 第1、第2の反射器がさらに備えられており、前記第3 の弾性表面波フィルタ素子において複数のIDTが設け られている領域の表面波伝搬方向両側に第3,第4の反 射器がそれぞれ設けられており。第1の反射器と第2の 反射器との間隔が、第3の反射器と第4の反射器との間 隔と略等しくされている。

【0051】第4の発明に係る弾性表面波フィルタ装置 のさらに他の特定の局面では、前記第1の弾件表面波フ ィルタ素子の不平衡側に接続される端子と 第2の弾性 表面波フィルタ素子の不平衡側に接続される端子とが、

た複数のIDTを有し、第2の弾性表面波フィルタ素子 の通過帯域内における伝送振幅特性が、第1の弾性表面 波フィルタ素子の伝送振幅特性と略一致しており、伝送 位相特性が第1の弾性表面波フィルタ素子とは略180 異なるように構成されており、第1,第2の弾性表面 波フィルタ素子の一方の端子が電気的に並列に接続され ており、他方の端子が電気的に直列に接続されており、 並列に接続されている端子が不平衡端子。 直列に接続さ れている前記端子が平衡端子を構成していることを特徴 とする。

【0040】第4の発明に係る種性表面波フィルタ装置 の特定の局面では、前記第1,第2の弾性表面波フィル タ素子が、3個のIDTをそれぞれ有し、第1の強性表 面波フィルタ素子における中央に配置されたIDTと、 両側に配置された I D T との間の第1の間隔に比べて、 第2の弾性表面波フィルタ素子における不平衡端子に接 続される I D T と平衡端子に接続される I D T との間の 第2の間隔が、弾性表面波の波長を入としたときに、 48~0.525入異なるように構成されている。 【0041】第4の発明に係る弾性表面波フィルタ装置 では、好ましくは、前記第1の間隔が、

[0042]

【数25】

【数28】

圧電基板上において電極パターンにより接続されてい 3.

【0052】本願の第5の発明に係る弾性表面波フィル タ装置は、圧電基板と、前記圧電基板上に構成されてお り、第1のIDTと、第1のIDTの両側に配置された 第2、第3のIDTとを有する僅件表面波フィルタ素子

£ (1)

 $(n/2+1, 22) \times \lambda \sim (n/2+1, 33) \times \lambda$ (n=0~4の整数)

【0054】であり、前記第2の間隔が、 [0055]

式(2)

(n/2+1, 72)×λ~ (n/2+1, 83)×λ (n=0~4の整数)

【0056】であり、第1の確性表面波フィルタ素子の IDTが不平衡端子を構成し、第2の弾性表面波フィル タ素子の第2,第3のIDTが平衡端子とされているこ とを特徴とする。

£ (3)

 $(n/2+1, 22) \times \lambda \sim (n/2+1, 33) \times \lambda$ (n=0~2の整数)

【0059】であり、前記第2の間隔が、

[0060]

£ (4) $(n/2+1, 72) \times \lambda \sim (n/2+1, 83) \times \lambda$

【0061】とされる。より好ましくは、第1の間隔 が、1.72 入~1.83 入であり、前記第2の間隔

が、2、22λ~2、33λである。 【0062】第5の発明の他の特定の局面では、第1,

第2の間隔の少なくとも1つの間隔における電極被覆率 が50%以上とされている。好ましくは、上記電極被覆 率は63%以上とされる。

【0063】第5の発明に係る弾性表面波フィルタ装置 の他の特定の局面では、前記第2,第3のIDTの外側 に、それぞれ、第1、第2の反射器が配置されており、 第1のIDTから第1の反射器までの距離と、第1のI DTから第2の反射器までの距離が略等しくされてい 3.

【0064】第4~第5の発明に係る弾性表面波フィル タ装置の特定の局面では、不平衡端子側に接続された直 列共振子がさらに備えられる。第4の~第5の発明に係 る弾性表面波フィルタ装置の他の特定の局面では、平衡 端子側の各端子に直列にそれぞれ接続された弾性表面波 共振子がさらに備えられる。

【0065】第1~第5の発明に係る弾性表面波フィル タ装置の特定の局面では、平衡端子側に縦続接続された 梯子型弾性表面波フィルタがさらに備えられる。第1~ 第5の発明に係る弾性表面波フィルタ装置は、適宜のパ ッケージ構造を有する弾性表面波フィルタ装置として構 成することができ、例えば、前記圧電基板上に弾性表面 波フィルタ素子が構成されているチップを収納するため のケース材と、チップ上の電極パターンとパッケージと を電極的に接続するための導電器とをさらに備え、前記

とを備え、第1のIDTと、第2のIDTとの間の第1 の間隔に比べて、第1のIDTと、第3のIDTとの間 の第2の間隔が、弾性表面波の波長を入としたときに、 0.481~0.5251異なり、第1の問題が、 [0053]

【数30】

【数29】

【0057】第5の発明では、好ましくは、第1の問題

[0058] 【数31】

【数32】

(n=0~2の整数) 圧電基板上に形成された電極パターン、パッケージ及び 導電部の少なくとも1つが略線対称の構造を有するよう に構成される。

【0066】この場合、好ましくは、前記電極パター ン、パッケージ及び導電部のうち少なくとも2つが同一 の対称軸に対して略線対称の構造を有するように構成さ れる。第1~第5の発明に係る弾性表面波フィルタ装置 の他の特定の局面では、前記圧電基板上に前記弾件表面 波フィルタ素子が構成されているチップがフリップチッ プボンディング法により搭載されるケース材がさらに備 えられ、該ケース材には不平衡信号端子として用いられ る1つの外部入力端子または外部出力端子と、平衡信号 端子として用いられる2つの外部出力端子または外部入 力端子とが設けられており、この2つの外部出力端子ま たは外部入力端子が、1つの外部入力端子または外部出 力端子に対して略線対称に配置される。

【0067】第1~第5の発明に係る弾性表面波フィル タ装置のさらに他の特定の局面では、前記圧電基板上に 前記弾性表面波フィルタ素子が構成されているチップが フリップチップボンディングにより搭載されるケース材 がさらに備えられ、該ケース材には、不平衡信号端子と して用いられる1つの外部入力端子または外部出力端子 と、平衡信号端子として用いられる2つの外部出力端子 または外部入力端子とが設けられており、この2つの外 部出力端子または外部入力端子が、1つの外部入力端子 または外部出力端子に対し、電気的に略対称に構成され ている。 なお、電気的に対称とは、物理的に多少非対称 であっても、配線などにより電気長がほぼ対称とされて いる構造をいうものとする。

【0068】第1~第5の発明に係る弾性表面波フィル 夕装置のさらに他の特定の局面では、上記外部入力端子 と外部出力端子との間に、少なくとも1つのアース端子 が軽置される。

【0069】第1~第5の発明に係る弾性表面波フィル タ装置の別の特定の局面では、上記平衡信号端子として 用いられる2つの外部出力端子間または外部入力端子間 に、少なくとも1つのアース端子が配置される。

【0070】また、本発明に係る弾性表面波フィルタ装置をを用いて、アンテナ共用器のような共用器を構成することができ、さらに木発明に係る共用器を用いて様々な通信装置を構成することができる。

[0071]

【発明の実施の形態】以下、図面を参照しつつ、本発明 に係る弾性表面波フィルタ装置の具体的な実施例を説明 することにより、本発明を明らかにする。

[0072]図1を参照して、本発明の第1の実施例に 係る弾性表面波フィルク装置を説明する。第1の実施例 の弾性表面波フィルク装置は、本願の第1,第2の発明 に係る弾性表面波フィルタ装置の実施例に相当する。

【0073】図1は、第1の実施例の別性表面波フィル タ装置の電板構造を示す平面図である。本実施例の別性 表面波フィルタ装置では、圧定基板上に3個の弾性表面 波フィルタ素子1~3が形成されている。なお、圧電基 板としては、LiTaの、や水晶などの適宜の圧電基板 を用いることができるが、本実施例では36°Y~XL 1Taの、表版が用いられている。

【0074】第1の弾性表面波フィルタ素子1は、表面 波伝搬方向に沿って配置された3個のIDT1a~1c を有する。IDT1a~1cの設けられている領域の表 面波伝搬方向両側には、グレーティング型反射器1d, 1eが配置されている。

【00 7 5] 同様に、第2、第3の弾性表面波フィルタ 業子2、3も、3個の1DT2a~2c、3a~3cが 表面液伝験方向に沿って配置された構造をする。ま た、第2、第3の弾性表面波フィルタ素子2、3におい でも、1DT2a~2c、3a~3cが設けられている 領域の表面波伝般方向外間にアルーティング取好器 d、2c、3d、3eが配置されている各 IDT1a~ 1c、2a~2c、3a~3cは、それぞれ一対のくし 需求極を有さる。

【0076】第1の弾性表面波フィルタ素子1の中央の IDT1aの一方のくし歯電極が入力端子4に接続され あ、また、中央の第1のIDT1aの外側に配置された 第2、第3のIDT1bの一方のくし歯電極が、第2の 弾性表面波フィルタ素子の外側に配置された第2、第3 の1DT2b、2cの一方のくし歯電極に電気的に接続 されている。同様に、第1の弾性表面波フィルタ素子の 外側IDT1cの一方のくし歯電極に、第3の弾性表面 外側IDT1cの一方のくし歯電極に、第3の弾性表面 波フィルタ素子3の外側 IDT3b,3cの一方のくし 歯電極が電気的に接続されている。第2,第3の弾性表 面波フィルタ素子の中央の IDT2a,3aの一方のく し歯電極が出力端子5,6にそれぞれ電気的に接続され ている。IDT1a~1c,2a~2c,3a~3cの くし歯電極のうち、上述したくし歯電極以外のくし歯電 極は、接地電位に接続されている。

【0077】入力端子4は不平衡端子であり、出力端子 5.6は平衡端子である。なお、第3の弾性表面波フィルタ素子103の伝送位相特性は、第2の弾性表面波フィルタ素子102の伝送位相特性と略180°異なっている。

【0078】次に、第1~第3の弾性表面波フィルタ素 子1~3の具体的な構造解を説明する。本実施例では、 第1の弾性表面波フィルタ素子1では、IDT1a~1 cにおける電極格交差層が52入とされている。な お、入は弾性表面波の波長を示す。中央に配置された第 1のIDT1aの電極格の対数は16、外側IDT、対 なわち第2、第3のIDT1b、1cにおける電極格の 対数はいずれも11である。IDT1a~1cにおける 表面波の波長入Iは4、2μmである。また、反射器1 d、1eにおける電極格の本数は120本であり、数 ARは4、3μmである。また、隙り合うIDT1a~ 1c間の間隔GIは1、77入Rである。なお、隙り合 うIDT間の間隔とは、例えばIDT1a、1b間を例 にとると、IDT1a、1bの最も近接し合っているホ ヶ利側の電を指揮のビッチをいうものとする。

【0079】第2の弾性表面波フィルタ素子2では、IDT2a-2cにおける電路抗交差隔がが31人とされている。中央に配置された第1のIDT2aの電路指の対数は16、外側IDT、すなわち第2、第3のIDT2b、2cにおける電路指の対数はいずれも11である。IDT2a-2cにおける電路指の対数はいずれも11である。IDT2a-2cにおける電路指の本数は120本であり、波長入は4.3μmである。また、反射第2は、3μmである。また、関り合うIDT2a-2c同の間隔GIは1.7入及である。

【0080】第3の弾性表面波フィルタ素子103では、降り合う1DT間の間隔G1が2.27 ARとされていることを除いては、第2の弾性表面波フィルタ素子2と同様に構成されている。

【0081】第2の弾性表面波フィルタ素子2と第3の 弾性表面波フィルタ素子3とは、伝送位相特性が約18 0。異なるように、隣り合う1DT間の間隔G1が異な らされている。なお、第2,第3の弾性表面波フィルタ 素子2,3の伝送位相特性を180。異ならせる構成 は、上記1DT間の間隔を異ならせる構造に限定される ものではない。

【0082】なお、本実施例及び以下の実施例において は、弾性表面波フィルタ素子の電極指及び反射器の電極 指の数は非常に多いため、図面においては略図的に示さ れている。

【0083】本実施例の弾性表面波フィルタ装置の入力 第子4を不平衡入力端子とし、出力端子5.6を平衡出 力端子として旧いる場合の動作について説明する。入力 第子4に電気信号が入力された場合、第1の弾性表面波 フィルタ素子1によりフィルクリングされた電気信号 が、第2,第3の弾性表面波フィルク素子2.3に与え られる。このとき、弾性表面波フィルタ素子7.01 DT 1b,1cが同一の構造とされており、かつ1DT1a から1DT1b,1cまでの距離を等しくしておけば、 第2,第3の弾性表面波フィルク素子2,3に与えられ る需気信号社団ととかる。

【0084】弾性表面波フィルタ素子2と弾性表面波フィルタ素子3とに入力された電気信号は、再びフィルタ リングされ、平衡出力増子5、6に澤出される、ここで、弾性表面波フィルタ素子3とでは、障り合う1DT間の間隔9日のみが上記のように異ならされている。従って、フィルタリングされた振福特性は同じであり、伝送位相特性は対180° 異なることになる。よって、出力増子5、6に連出される電気信号は、振福特性が同じてあり、伝送位相特性が対180°異な系完全水平循骨となる。

【0086】前述した特開平10−117123号公報 に開示されている平筒不平筒変換機能を有する弾性表面 波フィルタ装置では、入力側(不平筒側)に2個の弾性 表面波フィルタ素子が必要であった。

【0087】これに対して、本実施例では、上記のよう に入力側(不平筒側)を1つの弾性表面波フィルタ素子 で構成することができる。徒・で、上記允行技術と比較 した場合。本実施例によれば、瞬り合う1DTのバスパー 間で形成される寄生容量、入力側の弾性表面波フィル タ素子と出力側の弾性表面波フィルタ素子とを接続する 配縁、パッケージの端子と弾性表面波フィルタ装置とを 接続するチップ状の引き回し電極、あるいはボンディン グ川バッドなどが持つ湾土室量を大幅に低波することが 可能となる。このような寄生容量は、弾性表面波フィル タ装置の広帯域化を実現しようとする場合、大きな阻害 要因となっていた。 【0088】本実施例の弾性表面波フィルク装置では、 上記のようにこれらの寄生容量を低減することができ、 通路帯域内の平担性やVSWRを劣化させることなく、 広帯域のフィルタ特性を実現することができる。

【0089】図2に、本実施例のフィルタ特性を実線で示す。また、比較のために、実施例の弾性表面放フィルタ装置と同様の帯域を有するように構成された特開平10-117123号公保の記載に基づいて作製された弾性表面放フィルタ装置のフィルタ特性を破線で示す。

【0090】図2から明らかなように、本実施例の弾性 表面波フィルタ装置を用いることにより、広帯域のフィ ルタ特性が移んることがあかる。図3及び図4は、同 様に、本実施例の弾性表面波フィルタ装置と、上記先行 技術の記載と基づいて用意された弾性表面波フィルタ装 置の不平高端一側及び平衡端子側における各VSWR特 性を示す、実線は実施例の弾性表面波フィルク装置の特 性を、破線は従来例の特性を示す。図3及び図4から明 らかなように、本実施例におけば、VSWRの悪化を抑 制し得ることがわかる。

【0091】また、本実施例の弾性表面波フィルタ装置では、3個の弾性表面波フィルタ素子を用いるだけでよいため、チップサイズを小さくすることができる。さら、弾性表面波フィルタ装置を作め小型化や、弾性表面波フィルタ装置を作製するにあたり用意される1枚のウエハーあたりの弾性表面波フィルタ装置取得個数を増大させることができ、それによってコストダウンを図ることができる。

【0093】また、振幅の平衡度及び位相の平衡度とは、本実施例の弾性疾面波フィルタ装置を3ボートのデバイスと考え、不平衡入力端子をボート1、平衡出力端子5.6をそれぞれボート2、ボート3とした場合の、振幅の平衡 | A | は、A= | S21 | − | S31 | であり、位相の平衡度 | B−180 | は、B= | ∠S21 − | S31 | であり、位相の平衡度 | B−180 | は、B= | ∠S21 − | S31 | である。

【0094】理想的には、振幅の平衡度は0dB、位相の平衡度は0°であるが、現実に使用可能な範囲としては、振幅の平衡度が1.5dB以下、位相の平衡度が2

0°以下とされている。

【0095】図5によれば、振幅の平筒度がこのような値を満足するのは、弾性表面波フィルク素子2.3の1 D 下間の間隔の差が0.525人以下の範囲であり、図 6によれば、位相の平筒度が上記値を満足するには、弾 性表面波フィルタ素子2.3の1D T間の間隔の差が 0.48入の0.525入の範囲に設定すべきことがわ かる。従って、振幅の平筒度及び位相の平筒度のいずれ をがしまれば、位相のいでは、弾性表面波フィルタ素子 3における耳り口間の間隔。差が、0.48入 ~0.525入の範囲と変がはなのとが、0.48入 ~0.525入の範囲となればよいことがおかる。

【0097】しかしながら、上記式におけるnの値を大きくすると、以下のような問題が生じる。すなわち、囚ては、本失施例の弾性表面波フィルク装置の弾性表面波フィルク等等子2において、関り合う1DT間の間隔を、(n/2+0.77)×入、ただしnは0.1.2、6とした場合の隣り合う1DT間の間隔と、弾性表面波フィルク装置つ帯域隔との関係を示す。因7から明らかなように、携帯電話機用弾性表面波フィルク装置として最低跳必要な35MHzの帯域隔を確保するには、nは6以下としなければならないととがわかる。

【0098】他方、nを小さくすることにより生じる問題もある。図りは、本東施例の弾性表面波フィルク奏語における第2の弾性表面波フィルク素子2における隣り合うIDT間の間隔GIを、 $(0.77+m/2) \times \lambda$ 、ただしmは0及び自然数とし、弾性表面波フィルタ素子3の降り合うIDT間の間隔GIを(1.27+m/2)× 入としたときの第2の弾性表面波フィルタ素子2における時の合うIDT間の間隔GIと、振幅平衡度との関係を示す。

【0099】また、図10は、本実施例の弾性表面波フィルタ装置における第2の弾性表面波フィルタ素フの弾性表面との107円。 (77 + m/2) × 入とし、第3の弾性表面波フィルタ素子3における陽り合う10 T間の間隔G1を(1.27+m/2) × 入としたときの10 T間の間隔G1と位相平街度との関係を示す。

【0100】図9及び図10から、振幅平衡度が1.5 dB以下を満足し、位相平衡度が20°以下を満足する には、IDT間の間隔が1.77入以上、すなわちmの 値を1以上に設定する必要のあることがわかる。隣り合 うIDT間の間隔が小さくなると、平衡度が悪化する現 象は、以下のように考えることができる。

【0101】総結合共展子型弾性表面波フィルタの場合には、隣接するIDT同土が言葉結合するだけでなく、電磁界的にも結合することがある。音響結合はる伝送特性は、隣り合うIDT間の間隔を0.5Aだけ変えることにより、弾性表面波フィルタ素子2.3で位相が反数されるに対し、電磁界的な合による伝送特性は隣り合うIDT間の間隔に佐存せず、従って同位相同振幅となる。この同位相同振幅の方法成分は、平衡度を悪化せな要担てあり、従って、IDT間の間隔や小さくし電磁界的結合が大きくなる構造では、平衡度が悪化す

(0.102]以上の結果から、弾性表面波フィルタ素子2の隣り合う1DT間の間隔GIを、(0.77+n/2)×λ、n=1、2、3、4、5とし、弾性表面波フィルタ素子3の隣り合う1DT間の間隔GIを(1.27+n/2)×λ、ただしれは、1~5の範囲の自然数とすることにより、平衡度と帯域隔とがとした実用上間数ないレベルとなるフィルク神栓を得ることができる。【0103】また、温度変化による周波数変動を考慮する場合には、39MH2の神域偏が必要となる。この場合には、強性表面波フィルク素子2の隣り合う1DT間の間隔GIを(0.77+n/2)×λ、ただしれは1~3の自然数とし、弾性表面波フィルタ素子3の隣り合う1DT間の間隔GIを(1.27+n/2)×λ、ただしれは1~3の自然数とすればよい。

 $\{0.10.4\}$ さらに、平衡販が悪化することもなく、最も広い帯域幅を得るには、弾性表面波フィルタ素子2の 解り合う 1.0 DT間の間隔G1 を、 $\{0.77+n/2\}$ × λ 、ただしn=2とし、弾性表面波フィルタ素子3の 隙り合う 1.0 T間の間隔G1 を $\{1.27+n/2\}$ × λ 、ただしn=2とすればよいことがわかる。

【0105】LiTaO。単結晶をX触から中心にY軸からZ触方向に36°~44°の範囲で回転させてなる 圧電基板上においては、2種類の弾性表面液が研究さ れ、伝搬される。1つの弾性表面液はリーキー波すなわ ち疑似弾性表面液であり、もう1つはSSBWと呼ばれ るがい少波である。このうち、共振子やフィルタを形成 するために利用されるのはリーキー液が主であり、SSBWが主にて搬されると、伝搬很失が大きくなり、共振 子のQの劣化やフィルタとしての挿入損失の増大が生じる。上記と種類の弾性表面波は混在して協康され、伝統 される。もっとも、表面の状態がより電気的短線に近いすなわち電路被震響が大きい場合には、リーギー波が主に伝搬され、表面の状態がより電気的開線に近いすなわち電路被震率が大きい場合には、リーギー波が主に伝搬され、表面の状態がより電気的開象に近い場合、すなわち電路被震率が大きい場合には、リーギー波が主に伝搬され、表面の状態がより電気的開象に近い場合、

【0106】従って、第2の弾性表面波フィルタ素子に

おける中央のIDTと、外側の第2,第3のIDTとの間の第1の間隔及び第3の弾性表面波フィルク素子における中央の第1のIDTと外側の第2,第3のIDTとの間の第2の間隔に、少なくとも一本の電極指を挿入し、電極被覆率を高かれば、リーキー波を主に伝搬させ

し、電極被覆率を高めれば、リーキー波を主に伝搬させ ることができ、SSBWの励振及び伝搬を抑制でき、挿 入損失を低減することができる。

[0107] 図8は、上記第10間隔における電極被覆率と、帯域内挿入損失との関係を示す。実用的な帯域内挿入損失である3.0 d B B B F を実現するには、電極被覆率が0.5以上・すなわち50%以上必要であることがおかる。また、より一層損失を低減することが求められる用途において、挿入損失を2.5 d B B B B F とするには、電極被覆率が0.63以上、すなわち63%以上とされればよいことがわかる。第2の間隔についても同様のことが言える。

【0108】第2の弾性表面波フィルタ素子2に入力された信号は、IDT2b、2cにより弾性表面波を励聚する。この弾性表面波は、所定の伝盤方向に伝盤し、反射器2d、2e間で定在波が生じる。この定在波により、非常にひが高い共振となり、また助振された定在波がIDT2aに受信されることにより、IDT2aにおいて電気的空信号に変換されてフィルタとしての機能が果たされる。第3の弾性表面波フィルタ素子3においても同様の動作が行われる。ただし助振される定在波と、出力側IDT3aの位置関係により出力信号が決定されるが、弾性表面波のストラ管だけIDT3bの位置をすらまったとし助振される定在波と、出力側IDT3aの位置関係により出力信号が決定されるが、弾性表面波の成長入の0.5倍だけIDT3bの位置をずらすことにより、位相関係が第2の弾性表面波フィルタ素子の場合に比べて反応されている。

【0109】ここで、弾性表面波フィルタ素子2の2つの反射器2d、2e間の間隔でと、弾性表面波フィルタ素子3における2つの反射器3d、3e間の間隔Dとが異なれば、それぞれの素子における定在波の強度分布も異なることになる。能って、共振特性も変化し、フィルタとしての特性も変化する。よって、弾性表面波フィルタ素子2の2つの反射器3d、3e間の間隔Dを等しい値にすることにより、弾性表面波フィルタ素子2、3のフィルタ特性の違いが生じずに、平衡度の劣化を抑制することができる。

【0110】また、本実絶例では、反射器1d,1c,2d,2e,3d,3eとしてグレーティング型反射器が用いられているが、これに限定されるものではなく、例えば圧電差板端面における反射を利用したものであってもよい。

【0111】本実施例では、入力端子(不平衡端子)4 の特性インピーダンスが50Ωであり、出力端子5,6 (平衡端子)の特性インピーダンスは150Ωとされて いる。このような人出力インピーダンスに整合させるために、木実施例では、弾性表面波フィルク素子1は、入力側に接続される不平衡回路の特性インピーグンスである500に整合するように、上記のように交差機が51人に設定されている。また、弾性表面波フィルク素子2、3は、出力側に接続される平衡回路の特性インピーグンスである1500の1/2に整合するように、電極指交差幅は31人にそれぞれ設定されている。これは、平衡四路のそれぞれの端子子、6を独立した平衡端子として見なした場合、特性インピーグンスは、平衡回路の特性インピーダンスの1/2と等しくなるためである。

【0112】このように、弾性表面波フィルタ素子1に より人力欄に接続される不平衡回路とのインピーダンス 整合を図り、弾性表面成フィルケ素子2、3により出力 側に接続される平衡回路とのインピーダンス整合を図る ことにより、人出力インピーゲンスの比率を自由に設定 することがごきる。

【0113】図11は、不平衡端子4に接続された弾性 表面波フィルク素子1の交差欄と、平衡端子に接続され た弾性表面波フィルク素子2、3の電極指交差幅との比 車と、帯板艇2の関係を示す。図11から、交差欄比が 2.0のときに最も広い帯板欄の得られることがわか る。また、上記交差側比が3.5を超えると、帯域幅の 減少が5%を超え、良品帯が低下する。

【0114】図12は、不平衡端子4に接続された弾性表面波フィルタ素子10電極指交差幅と、平衡端子5. 6に接続された弾性表面波フィルタ素子2.3におけるVSWRの 値の関係を示す。上記交差幅比が2.5のときにVSW Rが最もよい値となり、1.5以下の場合にはVSWR が著しく悪化し、実用上問題となる。従って、上記電極 指交差幅比は1.5~3.5の範囲に設定することが望ましい。

ばり115] (第2の実施例) 図13は、本発明の第2 の実施例に係る弾性表面波フィルタ装置の電極構造を示 す平面置である。本実施例では、図示しない圧電基板上 に、3個の弾性表面波フィルタ業子11~13が形成さ れている。なお、圧電基板としては、LiTaO。や水 晶などの適宜の圧電基板を用いることができるが、本実 施例では、36°Y~X LiTaO。が用いられてい る。第1~第3の弾性表面波フィルタ業子1~13の基 本的な構造及び接続構造については、第1の実施例と同様であるため、同様の部分については、粗当の参照番号 を付することにより、第1の実施例の説明を提用するこ とにより。第1の実施例の説明を提用することにより。第1の実施の意明を接用することにより。第1の実施例の説明を提用することにより。第1の実施例の説明を提用することにより。第1の実施例の説明を提用することにより。第1の実施例の説明を提用することにより。第1の実施例の説明を提用することにより。第1の実施例の説明を提用することにより。第1の実施例の説明を提用することにより。第1の実施例の説明を提用することにより。第100年

【0116】第2の実施例の弾性表面波フィルタ装置が 第1の実施例の弾性表面波フィルタ装置と異なるところ は、第1~第3の弾性表面波フィルタ素子11~13に おける電路機構造にある。 【0117】なお、後述の動作の説明から明らかなように、木実施門では、第10弾性長面波フィルタ素子11 の外側1DT、すなわち第2,第3の1DT111b,1 1たから出力される電気信号は、伝送位相特性が略18 0°異なっており、第2,第3の弾性表面波フィルタ素子12,13に、振幅が等しく、位相が略180°異なる電気信号が与えられるように、各弾性表面波フィルタ素子11,12が構成されている。

【0118】本実施例では、第10列性表面波フィルタ 素子11において、IDT11a~11cにおける電極 指交差解Wは52Aとされている。なお、入は弾性表面 波の波長を示す。

【0119】第1の弾性表面波フィルタ素子11において、中央に配置された第1の1DT11 aの電極指の対数は、16、外側1DT、すなわち第2、第3の1DT 11b、11cにおける電板指の対数はいずれも11である。また、IDT11a~11cにおける液長入1は、4・2μmである。また、反射器11d、11eにおける電極指の本数は120本であり、液長入Rは4・3μmである。また、第1の1DT11aと、第2の1DT11bとの間の第1の間隔上が1・77ARであり、第1の1DT11aと第3の1DT11cとの間の第2の間隔日が2・27ARとされている。

【0120】第2の弾性先面波フィルタ素予12では、 電腦指交差隔は31次であり、中央に配置された第1の IDT12aの電極指の対数は、16、外側1DT、す なわち第2、第3のIDT12b、12cにおける電極 指の対数はいずれも11である。また、IDT12aへ 12cにおける波長入1は、42μmである。また、 反射器12d、12cにおける電極指の本数は120本 であり、波長入Rは4、3μmである。また、第1のI DT12aと、第2のIDT12bとの間の間隔A。が 1.77ARであり、第1のIDT12aと第3のID T12cとの間の間隔B。が1.77ARとされている。

【0121】また、第3の弾性表面波フィルタ素子13 は、第2の弾性表面波フィルタ素子12と同様に構成されている。第2の実施阿の弾性表面波フィルク装置の入力端子4を不平衡入力端子4を不平衡入力場子を101221入力端子4をで致信号が入力された場合、第1の弾性表面波は崩張される。この弾性表面波は前張される。この弾性表面波は、電極指の延びありた。直交する方向に伝援し、反射器11d、11eにより反射され、反射された原料器11d、11e間に定流が生生る。この定在波が生生なこととより、非常にQの高い共振となり、励振された定在波が出力側の1DT11b、11c受波される。後ゃて、電の向に会様を複数され、第10年間に定流波が生ちる。この定在波が生とれる。そので表が生り、最近の高い共振となり、励振された定在波が出力側の1DT11b、11c受波される。後ゃて、電の向に会様を検索され、第12日に一定変速される。後ゃて、電の向に会様を受験され、第12日に対象が出力側の1DT11b、11cに受波される。後ゃて、電の向に会様を受験され、第12日に対象が出力側の1DT11b、11cに受波される。後ゃて、電 11がフィルタとして動作する。

【0123】この場合、形成される定在波と、出力側の 1DT11b、11cとの位置関係にか出力に得号が決 定されるが、弾性表面波の波長入の約0.5億だけ1D T11b、11cのいずれかをずらすことにより位相関 係を反転させることができる。第2の実施例では、1D T11bから出力される電気信号と、IDT11cから 出力される電致信号とが位相評性が略180°異なるよ うに、第1、第2の間隔A₁, B₁が上記のように定め られている。従って、第2、第3の弾性表面波フィルタ 素子12、13には、振幅が等しく、かつ位相が180 "異なる電気信号が与えられる。さらに、出力された信 号が第2。第3の弾性表面波フィルタ果子12、13に より、フィルタリングされた信号 が平衡信号として出力端子5、6に出力される。

【0124】前述した図5及び図6の結果から、第2の 実施例においても、IDT11aと、IDT11bとの 間の第1の間隔A₁と、IDT11aと、IDT11 との間の第2の間隔B₁と必差を0.48A~0.52 5入の範囲に設定すればよいことが推測される。

【0125】また、上記IDT-IDT間の開闢を、(n/2+1.22)×A~(n/2+1.33)×A、(ただじnは0~4の整数)と、(n/2+1.72)×A~(n/2+1.83)×A、(ただしnは0~4の整数)との組み合かせとすることにより、平衡度の多化を防止、広帯域を特別得られる。

【0126】さらに、第10実験例の場合と同様に、第 2の弾性表面波フィルタ素子12における中央のIDT 12aと、外側の第2、第3のIDT12b、12cと の間の第1の間隔及び第3の弾性表面波フィルタ素子に おける中央の第1のIDT13aと、外側の第2。第3 のIDT13b、13cとの間の第2の間隔に、少なく とも一本の電極指を挿入し、上記間隔の領域における電 極被選挙を高めれば、リーキー波を主に伝接させること ができ、挿入様失を低減することができる。未実験例で は、従って、上記第1、第2の間隔に対ける電極被覆率 が63%とされ、それによって挿入損失の低減が図られ

【0127】また、未実施例では、第1、第2の間隔が 繋なっており、それによって接極平衡度の悪化が防止さ れている。また、第10列性法面波フィルク素子11に おける第1のIDT11 aから反射器11 eまでの距離 Pと、第1のIDT11 aから反射器11 eまでの距離 Q。とが等しくされており、それによって第1の弾性条 面波フィルタ素子において形成される定在波の助振強度 分布の非対称性が解消されている。従って、IDT11 b、11 cが受放し得る弾性表面波の強度が等しくさ れ、それによって平衡度の悪化が抑制される。なる。距 離P、Qは、それぞれ、IDT11 aの信号線に接続さ れる電極指のうち、最外側の電監指の中心と、反射器1 1 d , 11 e の最内側の電極指の中心との間の距離をい

【0128】(第3の実施例)図14は、第3の実施例の弾性表面波フィルタ装置の電格構造を示す때図的平面である。第3の実施例においても、第1~第3の弾性表面波フィルタ素テ31~33は、第2の実施例と同様に構成されている。各弾性表面波フィルタ素テ31~33は、第2の実施例と同様の部分については、第2の実施例の説明を援用することにより、省略することにより、省略することにより、省略等な

【0129】もっとも、第3の実施例では、弾性表面波フィルタ素子312、弾性表面波フィルタ素子32、3 シの接続構造が、第2の実施例と異なる。すなわち、第3の実施例では、第1~第3の弾性表面波フィルタ素子31~33の外側IDTずなわち31b、31c、32b、32c、33b、33cが接地されず、フロート接続されている。

【0130】より具体的には、第1の弾性表面波フィルタ素子31の第2の1DT31bの一方のくし情電極が 第2の弾性表面波フィルタ素子32の第2、第3の1DT32b、32cの一方端に接続されている。他方、IDT31bの他方端に接続されている。他方、IDT31bの他方端に第2の2DT32b、32cの他方端に接続されている。同様に、第1の弾性表面波フィルタ素子31の第3のIDT31cの第1の端部に接続されている。可以第2を発きれており、IDT31cの第2の端部に接続されてい、IDT31cの第2の端部が、第3の弾性表面波フィルタ素子33の第2、第3のIDT33b、33cの第2の端部に接続されてい、IDT33cの第2の端部に接続されてい、IDT31cの第2の端部が、IDT33b、33cの第2の端部に接続されてい

3 (0131) なお、31d、31c、32d、32c、33d、33cは反射器を示す、その他の点については、第2の実施例と同様である。従って、第3の弾性表面波フィルタ装置においても、第2の実施例の神性表面波フィルタ装置と同様に動作させることができ、同様の効果が得られる。加えて、上記接続精造を有するため、後地用ボンディングバットの数を著しく少なくすることができ、弾性表面波フィルタ装置の小型化を進めることができ、等にはボンディングバッド及びボンディングバッドとの接続配線に起因する寄生容量を低減することができる。

【0132】(第4の実施例)図15は、本発明の第4 の実施例に係る弾性表面波フィルタ装置の電極構造を示す略図的平面図である。

【0133】本実施例の弾柱表面成フィルク装置では、 図示しない圧電基板上に、第1,第2の弾性表面波フィルク素子11,42が開成されている。上電な板としては、圧電セラミックスや圧電単結晶などからなる圧電 基板を用いることができ、本実施例では36°Y-X しiTaの3基板が用いるれている。

【0134】第1,第2の弾性表面波フィルタ素子4

1,42は、いずれも3個のIDT41a~41c,4 2a~42cを有する共振子型弾性表面波フィルタ素子である。

【0135】弾性表面波フィルタ素子41の中央の第1 の1DT41aの第1の端部と、第2の弾性表面波フィ ルタ素子42の中央の第1のIDT42aの第1の端部 とが共通接続されて入力端子4に接続されている。

【0136】また、第1の1DT41a, 42aの第2の端部は採地されている。他方、外側1DT、すぶわち 1DT41b、41cが出力端子5に、外側1DT、す なわち第2,第3の1DT42b、42cの一方の端部 が出力端子6に接続されている。なお、第2、第3の1 DT41b、41c、42b、42cの他方端部は接地 されている。

【0137】また、IDT41a~41c、42a~4 2cが設けられている領域の両側には、それぞれ、反射 器41d、41e、42d、42eが配置されている。 未実施例では、第1の弾性表面波フィルタ素子41の伝 送位相特性が、第2の弾性表面波フィルタ素子42の伝 送位相特性に対して略180。異ならされている。

【0139】第2の弾性表面波フィルタ素子42では、 1DT42aと、1DT42b、42cとの間の第2の 間隔G1。が2.25ARとされていることを除いて は、第10弾性表面波フィルタ素子41と同様に構成されている。上記のように、第1の間隔2第2の間隔が算 なられており、それによって第1の弾性表面波フィルク素子42とは伝 送振網計性がは紅等しく、かつ伝送位相特性は暗180 果なっている。

【0140】本実施例の弾性表面波フィルタ装置の入力 端子4が不平衡端子であり、該入力端子4を入力とし、 平衡出力端子5,6を出力端子として用いた場合の動作 を説明さる。

【0141】入力端子4に電気信号が入力されると 第 1,第2の弾性表面波フィルタ素子41,42に、同位 相及び同風幅の信号が印加される。この信号が、IDT 41a,42aに印加され、表面波が励振される。この 表面波が、電極指の延びる方向と直交する方向に伝搬 し、反射器41d,41e,42d,42eに反射され る。従って、反射された弾性表面波は、助振される弾性 表面波と緩衝し、2つの反射器41d,41eまたは4 2d、42e間で定在波が形成される。従って、非常に Qの高い共振となり、励振された定在波が出り端子5。 6に接続された1DT41b、41c、42b、42c に受波され、電気的な信号に変複される。このとき励振 される定金波と、出力側1DT41b、41c、42 し、42cの位置関係とにより出力信号が決定される。 【0142】本実施例では、弾性表面成フィルク素子4 1における1DT41aと、1DT41b、41cとの 間の第1の間隔と、第20弾性表面成フィルク素子4 の間の第1の間隔が、弾性表面成フィルク素子4な がよびたがよりでする。 の間隔が、弾性表面波の波長の0、50倍だり異ならされている。従って、第10弾性表面成フィルク素子4力 から出力される信号と、第2の弾性表面波フィルク素子44 から出力される信号とは、位相が反応している。

【0143】よって、弾性表面波フィルタ素子41,4 2は、伝送位相特性が180。異なる特性を持ち、平衡 出力端子である出力端子5,6には、振幅が等しく、か つ位相が180。異なる電気信号が輸出される。

【0144】なお、本実施例では、2個の弾性表面波フィルタ素子41,42を用いた1段構成のフィルタであるため、帯域力挿入損失支半常に小さくすることができる。第40実施例の弾性表面波装置のフィルタ特性を図16に示す。図16から明らかなように、通過帯域内にはける損失を流域し得ることがわかる。

【0145】第4の実施例においても、図5及び図6の 結果から、第1の間隔と第2の間隔との差は、0.48 なから、525人の範囲に設定すればよいということが できる。

【0146】また、第1の間隔と第2の間隔とは、(n/2+1,22)×A~(n/2+1,33)×A、(ただしれは0~4の整数)と、(n/2+1,72)×A~(n/2+1,83)×A、(ただしれは0~4の整数)との組み合わせとすることで、平衡度の劣化を防止し、広部域な特性を得ることかできる。

【0147】また、第4の実施例においても、第1の実施例と同様に、第1,第2の間隔に、本以上の電極計を排入し、電極被覆率を高めることにより、リーキー波を主に伝報させることができ、SSBWの励禄・伝鞭を抑制することができる。従って、第1,第2の間隔における電極被率率を、好ましくは50%以上、より好ましくは63%以上とすることにより、低損失の弾性表面波フィルタ装置を提供することができる。

【0148】本実練例では、第2の弾性表面波フィルタ 素子42において、出力側1DT42b、42cの位置 関係が第1の弾性表面波フィルタ素子における出力側1 DT41b、41cの位置に比べて、弾性表面波の波長 の0.5倍だけずらされているので、上記のように位相 関係が反散されている。

【0149】ここで、第1の弾性表面波フィルタ素子4 1の2つの反射器41d,41e間の間隔と、第2の弾 性表面波フィルタ素子42の2つの反射器42d.42 e間の間隔とが現なれば、各素子における定在波の強度 か布が変わる。従って、共振特性も変化し、フィルタと しての特性も変わることが干型される。よって、好まし くは、反射器41d.41e間の間隔P₁と、反射器4 2d.42e間の間隔段。を暗等しくし、それによって 平衡度の余化を抑制することができる。

【0150】なお、第4の実施例ににおいても、反射器 41d~42eについては、グレーティング型反射器が 図示されているが、例えばチップ端面における反射を用 いた反射器のような他の適宜の構造の反射器を用いるこ とができる。

【0151】また、弾性表面波フィルタ素子41の中央の1DT41aと、弾性表面波フィルタ素子42の中央の1DT42aとを比電基板上の電板パターンにより共運接続し、かつ不平衡入力端子41接続することにより、弾性表面波フィルタ素子41の有する深生容量と

り、弾性表面波フィルタ素子41の有する寄生容量と、 弾性表面波フィルタ素子42の有する寄生容量とが共有 さることになる。従って、平衡度がそれによっても改 善される。

【0152】(第5の実施例)第5の実施例の弾性表面 波フィルタ装置の電極構造を第17図に略図的平面図で 示す。

【0153】本実施例においても、第4の実施例と同様 に、2個の共振子型弾性表面波フィルタ素子が用いられ ている。すなわち、第1,第2の弾性表面波フィルタ素 子51,52が、圧電基板上に構成されている。また、 第1. 第2の弾性表面波フィルタ素子51. 52におい て、それぞれ、中央のIDT51a,52aと、外側の 第2, 第3のIDT51b, 51c, 52b, 52cと の間の浮き電極指53a~53dがそれぞれ挿入されて いる。IDT51a~51c及び反射器51d、51e は、第4の実施例の弾性表面波フィルタ素子41のID T41a~41c及び反射器45d, 45eとほぼ同様 に構成されている。また、第2の弾性表面波フィルタ素 子52のIDT52a~52c及び反射器52d,52 eは、第4の実施例の第2の弾性表面波フィルタ素子4 2のIDT42a~42c及び反射器42d, 42eと ほぼ同様に構成されている。

【0154】本実施例のように、浮き電極指53a~5 3dを、IDTとは独立に形成してもよく、それによって1DT間の間隔の電極被覆率を50%以上とすること ができる。

【0155】(第6の実施例)図18は、第6の実施例 に係る弾性表面波フィルク装置を説明するための略図的 平面図である。図示しない比電量板上に、1つの弾性表 面波フィルタ素子61が構成されている。圧電基板としては、本実施例では36°Y-X LiTaO。基板が 用いられているが、他のカット各のLiTaO。基板 や、他の圧電材料からなる圧電差板を適宜用いることが できる。

【0156】弾性表面波フィルク素子61では、3個の 1DT61a~61cが表面波伝撒力向に沿って形成さ れている。1DT61a~61cが設けられている領域 の両側に、反射器61d,61cが形成されている。

【0157】未延齢では、中央の第1の1DT61a の一端が不平衡入力端子である入力端子4に接続されている。1DT61aの地端上接地されている。外側の第 2、第3の1DT61b。61cの一端が、平倍出力端子である出力端子5。6に接続されており、各他端は接 地されている。反射器61d、61eは、グレーティング型反射器で構成されているが、他の反射器で構成されていてもよい。

【0158】IDT61a~61cの電極指交差欄Wは 31 Aとされており、IDT61aの電極指の対数は1 6、IDT61b、61cの電極指の対数はいずれも1 とされている。また、IDT61a~61cにおける 表面波の破長入1は、4、2μmである。

【0159】 反射器61d, 61eにおける電極指の本数は各120本であり、波長ARは4、3μmである。 IDT61aと、IDT61bとの間の第1の間隔JI、は1.75ARであり、IDT61aと、IDT61cとの間の第2の間隔JI、は2.25ARである。 【0160】 本実施例の弾性表面波フィルク装置では、入力端子4から1DT61aに電気信号が入力される、第1~第5の実施例の場合と同様に、反射器61の表面がある。この定在波により、非常に高い共振が得られ、励振された定在波がID761b、61cで受波され、出力端子5、6から取り出される。

【0161】本実施例においても、励振される定在波と、出力側1DT61b, 61cの位置関係により、出力信号が決定される。本実施例では、1DT61a, 61b間の第1の間隔と、1DT61a, 1DT61aと1DT61cとの間の第2の間隔が、弾性表面波の波長の0.50倍だけ異なるため、1DT61b, 61cの出力信号のが相が反転されている。

【0162】従って、IDT61bから出力される電気 信号と、IDT61cから出力される電気信号とは伝送 位相特性が180°異なる特性を持つので、出力端子 5,6から、振幅が等しく、位相が180°異なる電気 信号が端黒される。

 が得られる。

【0164】さらに、木実施例においては、IDT61 b, 61 cの最内側の電極指が幅などされており、それ によってIDT間の間隔了1, J J 。における電極被整 率が0.63とされている。従って、IDT間の間隔了 I, J J 2。における伝盤損失が小さくされている。よっ て、第1、第2の間隔が異なることによる振信平衡度の 悪化が明止される。

【0165】また、中央のIDT61aから反射器61 d,61eまでの酢離P,Qを管しくすることにより、 定在波の扇頻強度分布の非対称性が解消され、平衡度の 悪化を防止することができる。

【0166】(第7の実施例)図19は、本発明の第7の実施例に係る弾性表面波フィルク装置の略図的や面図である。第7の実施例では、中央の第1の1DT71a と、外側の第2,第3の1DT71a と、外側の第2,第3の1DT71b、71c間の間隔に、それぞれ、浮き電極指72,73が電置されている。その他の点については、第6の実施例の弾性表面波フィルク装置と同様に構成されている。本来建輸化さいても、第6の実施例の弾性表面波フィルタ投置と同様に各1DT71a~71c及び反射第71d 、71cが構成されているので、第6の実施例の弾性表面波フィルク装置と同様の効果を得ることができる。

【0167】また、浮き電極指72,73が設けられているので、第1,第20間隔における電極被覆率が高められ、伝機損失を低減することができる。好ましくは、電極被覆率は5%以上、より好ましくは63%以上とされる。

【0169】上記第1の興性表面波共振子83は、1個の1DT83aと、1個の1DTの両側に配置されたグレーティング型反射器(図元せず)とを有する。第1の 弾性表面波共振子83の1DT83aの電極指交差幅W は20人、電極指の対数Nは80であり、1DTの波長入1は4、204mであり、図示されていない反射器の電極指の本数は120本である。

- 【0170】また、出力端子5、6に接続されている第 2、第3の一端子対弾性表面波共振子84、85は、第 1の弾性表面波共振子83と同様に構成されている。本 実能例では、上記第1~第3の弾性表面波共振子83~ 85が接続されているので、図21に示すように、第4 85が容さる、なお、図21において、実線は第8の実施 例の弾性表面波フィルタ特性を示し、破 線は第4の実施例の弾性表面波フィルタ特性を示し、破 線は第4の実施例の弾性表面波フィルタ 特性を示す。
- 【0171】(第9の実施例)図22は、第9の実施例 に係る弾性表面波フィルク装置の電極構造を示す略図的 平面図である。第9の実施例の弾性表面波フィルク装置 は、第6の実施例の弾性表面波フィルク装置の入力側及 び出力側に、第8の実施例と同様に、第1~第3の弾性 表面波共展子93~95を検続した構造に担当する。
- 【0172】なお、別性表面波フィルク素子91については、第6の実施例の弾性表面波フィルク素子61とほぼ同様に構成されている。また、中央の第1のIDT91aと、入力端子4との間に接続されている第1の弾性表面波共振子93、第2,第3のIDT91b,91cと出力端子5,6との間に接続されている第2,第3の弾性表面波共振子94,95は、第8の実施例で用いた弾性表面波共振子94,95は、第8の実施例で用いた弾性表面波共振子83~85と全く同様に構成されている。
- 【0173】本実施所においても、第8の実施例と同様 に、第1~第3の弾性表面波共振子が、弾性表面波フィ ルタ素子の入力側と入力端子との間及び弾性表面波表 子の出力側と出力端子との間に接続されているので、通 適帯域近傍における減衰量、特に高域側における減衰量 を増大することができる。
- 【0174】(第10の実施例)図23は、第10の実施例の弾性表面波フィルタ装置の電板構造を示す略図的 平面図である。本実施例は、第8の実施例の弾性表面波 フィルタ装置において、第20弾件表面波共帰そ84
- と、出力端子らとの間に第4の弾性表面被共振子101 を接続した構造に相当する。言い娘えれば、第44の弾性 表面波共振子101は、出力帽子5.6に途列に接続さ れている。この第4の弾性表面波共振子101は、1つ の1DTと、その両側に配置されているが、図示されて いないグレーティング型反射影とを有する、第4の弾性 表面波共振子101は、1DTの電極指交差編Wが15 入、電極指の対数は50、1DTの波及1は34.40 加、反射器の変極指の本数は120本とされている。
- 【0175】第8の実施例の弾性表面波フィルタ装置 に、本実施例に従って第4の弾性表面波共振子101を 接続することにより、平倍出力端子5.6側において、 梯子型フィルタ回路が構成される。この梯子型フィルタ 回路の波衰極を、弾性表面波フィルタの通過帯域の低域 側と高域側とに位置することにより、減衰量をより一個

- 大きくすることができ、選択度を高めることができる。 【0176】また、上記弾性表面波共振子101は、平 衛出力端子5.6間に精波しのかたちで接続されている ので、平衡端子5.6への影響が等しく、平衡度の悪化 嬰因を相殺する。従って、平衡度を悪化させることな ・ 浦洛群域外域衰量の増大を図ることができる。
- 【0177】第1~第100実施的に係る弾性表面波フィルタ装置の説明では、圧電基板上に形成されている電 機構造のみを示したが、木売明に係る弾性表面波フィルク 契護は、様々なパッケージ構造を採用することにより チッア型弾性表面波フィルク装置として構成することが できる。
- 【0178】第11の実施例は、このようなバッケージ に内蔵された部品としての弾性表面波フィルタ装置に関 する。図24に示すように、圧電基板102上に、所定 の電極を形成することにより、本発明に従った弾性表面 波フィルタ業子が構成される。この弾性表面波フィルタ 業子が、四部103aを有するバッケージ103に収納 される
- 【0179】本実施例では、弾性表面波フィルタ楽子を構成する圧電基板102が矩形状か形状を有し、中心を通る対称軸Xを有する。他方、パッケージ103も甲面形状が矩形であり、中心を通る対称軸Xと、バッケージ103の対称軸Xとがあるように、圧電基板102がパッケージ103内体軸Yとが有がるように、圧電基板102がパッケージ103内に間定される。さらに、図24では国示を省略されているが、弾性表面波フィルタ楽子とバッケージ103上に設けられて電影・パドとをボンディングワイヤーにより接続する。この電極バッドやボンディングワイヤーにより接続する。この電極バッドやボンディングワイヤーにいても、上記対称軸X、Yに対して維料体に関密される。
- 【0180】上配のように、圧電基板102の対称軸X とパッケージ103の対称軸Xとを一致させることによ り、平衡出力端子の各端子に接続される弾性表面波フェ ルタ上の配線の電気長や寄生容量の値を等しくすること ができ、平衡度の悪化を抑削することができる。
- 【0181】また、パッケージの中心を通り対称軸Yに対して複対体の構造とすることにより、平衡領手に接続されるパッケージ内の配線の有する電気長や落生容量の値を等しくすることができ、それによっても平衡度の悪化を抑制することができる。従って、平衡度を悪化させる要因を極かて小さくすることができ、結果として、平衡度に優れた平衡一不平衡変換機能を有する弾性表面波フィルタ基節を構構することができる。
- 【0182】さらに、上記のように、電極パッドやワイヤボンディングの配置についても、対称軸X、Yに関して線対称とすることにより、平衡度をより一層高めることができる。
- 【0183】なお、ワイヤボンディングに代えて、バン アボンディングにより電気的接続を行う場合にも、バン

アボンディング位置を線対称に配置することにより、同 接の効果が得られる。特にバンブボンディングでは、チ ップの配置位置によってワイヤ長が変わってしまうワイ ヤボンディングと比較して、平衡度は良好となる。

【0184】図25は、木港明の第12の実験例として、開波設が異なる不平衡一半倍型弾性表面波フィルタを示す模式的一工電影板上に形成されている弾性表面波フィルクを示す模式的平面図である。この弾性表面波フィルク目11は、同一圧電基板112上に、図20に示した弾性表面波フィルク装置と目の13年、例えば900MHz帯の帯波フィルク実置113を、例えば900MHz帯の帯波フィルクとして、弾性表面波フィルクとして、発性表面波フィルクとして、発性表面波フィルクとして、発生表面変フィルクとして、発生表面変フィルクとして、影性表面波フィルクとして、形成することにより、上記のように周波数が異なる2つの不平衡一平衡型発性表面波フィルク装置113、114を同一圧電基板112を用いて構成することができ、帯域フィルクの小型化を図ることができる。

【0185】なお、図25では、圧電基板上の電極パッドと図示しないパッケージ状の電板パターンやアース電位に接続される電極パターンとの接続はボンディングワイヤーにより行われているが、ボンディングワイヤー以外の方法により電気的に接続されていてもよい。

【0186】図26は、図25に示した舞性表面被フィルタ装置111を用いた通信機における、アンテナ共用 器を示す販路構成図である。ここでは、弾性表面被フィルタ装置113、114の入力場がアンテナANTに共 通接続されている。そして、弾性表面波フィルタ装置1 13、114の出力端が、それぞれ、送信側出力端Tx 及び受信離出力端Rxとされている。

【0187】なお、図25では、周波数が異なるフィル タが同一の圧電基板112を用いて構成されていたが、 図27に示すように、周波数の異なる弾性表面波フィル 夕装置113,114は、それぞれ、異なる圧電基板1 12a,112bを用いて構成してもよい。ここでは、 異なる圧電上板112a,112bを用いて構成された 弾性表面波フィルタ装置113,114が、それぞれ、 バッケージ116内に収納される。

【0188】図30~32は、それぞれ、本郷界に係る 弾性表面波フィルタ装置のさらに他の実施例を説明する ための各版面団である。図30に示す弾性表面波ワィル 夕装置301は、図示されているケース材302を有す る。ケース材302は、本実施例では板状のケース基板 であり、図示されていない側の面にフリップチップポン ディング工法により本発明に係る弾性表面波フィルタ装 置が将載される。

【0189】上記ケース材302の下面302aには、 弾性表面波フィルタ装置と電気的に接続され、かつ外部 と電気的に接続するための1つの外部入力端子303 と、2つの外部出力端子304、305が設けられてい る。この場合、弾性表面波フィルタ装置の不平衡信号等 存に、外部入力端子303が接続され、弾性表面波フィ ルタ装置の一州の平衡信号場子に、外部出力端子30 4、305が電気的に接続されている。木実絶所では、 外部入力端子303に対し、2つの外部出力端子30 4、305が、図示の接線で示す対称軸を介して略線対 称に配置されている。このように、2つの外部出力端子 304、305を外部入力端子303に対して略線対称 に配置するととにより、平原度が高められる。

【0190】加えて、2つの外部出力端子304、305間に、好ましくは中央に、アース端子306が配置されており、それによって平衡度がより一層高められている。また、外部入力端子303と外部出力端子304との間、外部入力端子303と外部出力端子305との間に、好ましくは中央に、それぞれ、アース端子307、308が配置されており、それによって外部入出力端子間における直達成分を抑制することが可能とされている。

【0191】図31に示す弾性表面波フィルタ装置31 1においても、同様に、外部入力端子313に対し、外部 部出力端子314、315が暗線対称に配置されている。従って、図30に示した弾性表面波フィルタ装置3 01を同財核に平衡度を高めることができる。ここでは、 分割力端子313と外部出力端子314、315との 間に、アース端子316、317が配置されており、それによって入出力端子間の直達成分の抑制が図られている。

【0192】なお、図30及び31では、板状のケース 材302、312が用いられているが、ケース材の形状 はこれに限定されず、弾性表面波フィルタ装置を密封す るパッケージによりケース材が構成されていてもよい。 【0193】また、図32に示す弾性表面波フィルタ装 置321では、圧電基板322の下面が示されている。 この圧電基板322の上面側に、弾性表面波フィルタ素 子が構成されている。圧雷基板322の下面には、弾性 表面波フィルタ素子に電気的に接続され、かつ不平衡信 号端子として用いられる外部入力端子323が繕電膜に より形成されている。また、平衡信号端子として用いら れる2つの外部出力端子324,325が、外部入力端 子323に対して略線対称に位置するように設けられて いる。弾性表面波フィルタ装置321においても、2つ の外部出力端子324,325間の中央にアース端子3 26が配置されており、それによって平衡度がさらに高 められている。また、外部入力端子323と外部出力端 子324との間及び外部入力端子323と外部出力端子 325との間に、それぞれ、アース端子327、328 が配置されており、直達成分の抑制が図られている。

【0194】図33は、本発明に係る弾性表面波装置を 用いた通信機160を説明するための各概略ブロック図 である。図33において、アンテナ161に、デュプレ クサ162が接続されている。デュアレクサ162と受信側ミキサ163との間に、RF段を構成する弾性表面 波フィルタ164及び抑幅器165が接続されている。 さらにミキサ163に1F段の表面波フィルタ169が 接続されている。また、デュアレクサ162と送信側の ミキサ166との間には、RF段を構成する増幅器76 7及び弾性表面波フィルタ168が接続されている。

【0195】上記通信機160における表面波フィルタ 164,168として本発明に従って構成された弾性表面波装置を好適に用いることができる。

[0196]

【発明の効果】第1の発明に係る弾性表面波フィルタ装 置によれば、第2,第3の弾性表面波フィルタ素子の帯 域内における伝送振幅特性が略一致しており、伝送位相 特性が略180°異なるように構成されており、第2の 弾性表面波フィルタ素子の少なくとも1つのIDTと、 第3の弾性表面波フィルタ素子の少なくとも1つのID Tとが、第1の弾性表面波フィルタ素子の少なくとも1 つのIDTに接続されているので、第1の弾件表面波フ ィルタ素子に接続される端子を不平衡端子、第2,第3 の弾性表面波フィルタ素子に接続される端子を平衡端子 とすることにより、平衡-不平衡変換機能を有する弾性 表面波フィルタ装置を構成することができる。この場 合、従来、4つの弾性表面波フィルタ素子を必要として いたのに対し、第1の発明によれば、3個の弾性表面波 フィルタ素子を用いることにより、平衡-不平衡変換機 能が実現される。従って、平衡-不平衡変換機能を有す る弾性表面波フィルタ装置の小型化及びコストの低減を 果たし得る。

【0197】また、弾性表面波フィルタ素子の数を低減 し得るので、寄生容量を減らすことができ、それによっ て平衡度の劣化も生じ難い。従って、広帯域化も容易で ある。

【0198】第2の発明に係る弾性表面波フィルタ装置 では、第2、第3の弾性表面波フィルタ素子の帯域内に おける伝送振幅特性が略一致し、伝送位相特性が略18 ○ 異なるように構成されており、第1の弾性表面波フ ィルタ素子の第2のIDTが、第2の弾性表面波フィル **タ素子に接続されており、第1の弾性表面波フィルタ素** 子の第3のIDTが第3の弾性表面波フィルタ素子のI DTに接続されているので、第1の**弾性**表面波フィルタ 素子に接続される端子を不平衡端子、第2,第3の弾性 表面波フィルタ素子に接続される端子を平衡端子とする ことにより、平衡-不平衡変換機能を有する弾性表面波 フィルタ装置を構成することができる。この場合、従 来、4つの弾性表面波フィルタ素子を必要としていたの に対し、第2の発明によれば、3個の弾性表面波フィル タ素子を用いることにより、平衡-不平衡変換機能が実 現される。従って 平衡-不平衡変換機能を有する弾件 表面波フィルタ装置の小型化及びコストの低減を果たし

得る。

【0199】また、弾性表面波フィルタ素子の数を低減 し得るので、寄生容量を減らすことができ、それによっ て平衡度の劣化も生じ難い。従って、広帯域化も容易で

【0200】第2の参則に係る弾性表面被フィルタ装置 において、第1の間隔と第2の間隔とが、0.48入 0.525入異なるように構成されている場合には、影 幅の平衡度を1.5dB以下、位相の平衡度を20°以 下とすることができ、平衡度の今化を確実に防止するこ とができる。

【0201】第1の間隔及び第2の間隔が、それぞれ、 式1及び式2を溝たす場合には、十分な帯域能を得ることができ、かつ平筒度の赤化を抑制することができる。 ららに、第2の発明に係る弾性表面波フィルタ装置において、式3及び式4を満たすように第1。第2の間隔が 選ばれている場合には、温度変化による周波度変動を考 慮したとしても、十分な帯域隔を得ることができ、かつ 平衡度の悪化を抑制することができる。

【0202】さらに、第1の問隔を1.72ネー1.8 3人、第2の間隔が2.22ネー2、33人の範囲にある場合には、平衡度の悪化をより確実に抑制することができる。 【0203】第2の発明に係る弾性表面放フィルク装置 において、LiTaO。単結晶をX軸を中心にY軸から 乙軸方向に36〜44°の地間で回転されているLiTaO。基板を用い、第1.第2の間隔のうち少なくとも 1つの間隔に、少なくとも一本の電極指が挿ったれておし、 1の数としたがある。 1の数によりな電極を関すがある場合には、リーキー波が周囲に伝 撤され、それによって挿入損失の低減を図ることができる。 特に、電極被関率が63%以上である場合には、より一層挿入損失を低減することができる。

【0204】第2の発則に係る弾性表面波フィルタ装置 において、第1の反射器と第2の反射器との間の間が、第3の反射器と第2の原外器と明常の間が、第3の反射器と第4の反射器との間の間と暗等しくされている場合には、第2の弾性表面波フィルク素子及び第3の弾性表面波フィルク素子のフィルク特性がほぼ等しくなり、半衡度の劣化をより確実に抑制することができる。

【0205】第3の発明に係る弾性表面波フィルタ装置では、第1~第3の弾性表面波フィルタ素子を備え、2の弾性表面はフィルタ素子を備え、40単位表面波フィルタ素子の第2の1DTに接続されており、第3の弾性表面波フィルタ素子が、第1の弾性表面波フィルタ素子の第2の1DTに上、第3の1DTの入力または出力における位相差が、通過帯域内において約180。 異なるので、第1の弾性表面波フィルタ素子に接続される40単位を発表である。20単位表面波フィルタ素子が表の1DTと、第3の1DTの入力または出力に対する位相差が、通過帯域内において約180。 素子に接続される端子を平衛衛子とすることにより、平 億一不平商変換機能を有する弾性表面波フィルタ装置を 構成することができる。この場合、従来、4つの弾性表 面波フィルタ素子を必要としていたのに対し、第3の発 明によれば、3個の弾性表面波フィルタ素子を用いるこ とにより、平衡一不平衡変換機能が実現される。従っ て、平衡一不平衡変換機能を有する弾性表面波フィルタ 装置の小型化及びコストの低減を果たし得る。

【0206】また、弾性表面波フィルタ素子の数を低減 し得るので、寄生容量を減らすことができ、それによっ て平筒度の劣化も生じ難い。従って、広帯域化も容易で ある。

【0207】第3の発明に係る弾性表面波フィルタ装置 において、第1,第2の間隔が、048入~0.525 んだけ異なる場合には、振幅の平衡度を1.5dB以 下、位相の平衡度を20°以下とすることができ、平衡 度の劣化を確実に防止することができる。

【0208】第3の発明に係る弾性表面波フィルタ装置 において、第1,第2の間隔が式1,2を満たす場合に は、十分な帯域幅を得ることができ、かつ平衡度の劣化 を抑制することができる。

【0209】第3の発明において、第1,第2の間隔が 式3,4を消たす場合には、温度変化による周波数変動 参考慮したとしても、十分な帯域隔を得ることができ、 かつ平衡度の無化を抑動することができる。

【0210】第1の間隔が1.72入~1.88入の範囲にあり、第2の間隔が2.22入~2.33入の範囲にある場合には、平衡度の悪化をより確実に抑制することができ、かつ帯域幅を十分な広さとすることができ、

【0211】第3の発明に係る弾性表面波フィルタ装置 において、第1のIDTの中心から第1の反射器までの 距離と、第1のIDTの中心から第2の反射器までの距 能が等しくされている場合には、平筒度の劣化をより確 実に抑制することができる。

[0212] 第1~3の発明に係る弾性表面波フィルタ 装置において、第1の弾性水面波フィルタ素子を構成 ている 1D Tの電極指交差幅は、第2の弾性表面波フィ ルタ素子及び第3の弾性表面波フィルタ素子を構成して いる各1D Tの電極指交差幅の1.5~3.5倍の範囲 にある場合には、通過帯波内におけるVSWR値の悪化 を抑制することができる。

【0213】第4の発別に係る弾性表面波フィルタ装置 では、第2の弾性表面波フィルタ素子の通過帯域内にお ける伝送特性が、第1の弾性表面波フィルタ素子の伝送 振幅特性と略一致しており、伝送位相特性が第1の弾性 表面波フィルタ素子と略180° 異なるように構成され ており、第1.第2の弾性表面波フィルタ素子の一方の 端子が電気的に並列に接続されており、他方の端子が電 気的に直列に接続されており、並列に接続されている端 子が不平衡端子、直列に接続されている端子が平衛端子 を構成しているので、第1〜第3の発明に係る弾性表面 被フィルク装置と同様に、平衡一不平衡変換網能が実現 される。しかも2個の弾性表面波フィルタ素子を用いて 構成されているので、より一層小型化及び低コスト化を 果た1得る。

【0214】また、第4の発明に係る弹性表面波フィル タ素子において、第1,第2の間隔が、0.48入 0.525入異なる場合には、振幅の平筒度を1.5d B以下、位相の平筒度を20。以下とすることができ、 平筒度の変化を確実に貼いする。ことができる。

【0215】第4の発明に係る弾性表面波フィルタ装置 において、第1, 第2の間隔が、式1, 2を満たす場合 には、十分な帯域編を得ることができ、かつ平衡度の劣 化を抑制することができる。

【0216】また、第1, 第2の間隔が式3, 4を満た す場合には、温度変化による周波数変動を考慮したとし て、十分な帯域幅を得ることができ、かつ平衡度の悪 化を抑制することができる。

【0217】また、第4の発明において、第1の間隔が 1.72入-1.88入の範囲にあり、第2の間隔が 2.22入-2.33入の範囲にある場合には、平衡度 の悪化をより確実に抑制することができ、かつ帯域福を 十分な広さとすることができる。

【0218】第4の発明においても、圧電基板がLiT α0。単結晶をX軽を中心にY触からZ触方向に36~ 44°の範囲で回転されているLiTa0。基板を用 い、第1。第2の間隔のうち少なくとも1つの間隔に、 少なくとも一本の電極治が挿えされており、設電総計が 挿入された間隔における電極被覆率が50%以上とされ ている場合には、リーキー波が周囲に伝搬され、それに よって挿入根失の低波を図ることができる。特に、電極 核覆率が63%以上である場合には、より一層挿入損失 を低減することができる。

【0219】第4の発明に係る弾性表面波フィルタ装置 において、第1の反射器と第2の反射器との間の間隔 が、第3の反射器と第4の反射器との間隔と略等しくさ れている場合には、第2の弾性表面波フィルタ素子及び 第3の弾性表面波フィルタ素子のフィルタ特性がほび等 しくなり、平衡度の劣化をより確実に抑制することがで きる。

【0220】第4の発明に係る弾性表面波フィルタ装置 において、第1の弾性表面波フィルタ素子の不平筒側に 接続される第子と、第2の弾性表面波フィルタ素子の不 平筒側に接続される端子とが、圧電基板上において電極 パターンにより接続されている場合には、客生容量の低 減を図ることができ、それによって挿入損失のより一層 の低減を図ることができ、それによって挿入損失のより一層 の低減を図ることができ、それによって挿入損失のより一層

【0221】第5の発明に係る弾性表面波フィルタ装置は、第1~第3のIDTを有する1つの弾性表面波フィ

ルタ素子を備え、第1,第2の1DT間の第1の間隔 と、第1,第3の1DT間の第2の間隔が式1及び2を 議たし、第1の1DTが平衡端子を構成し、第2,第 3の1DTが平衡端子に接続されているので、平衡一不 平衡変換機能を有する弾性を面波フィルタ装置を構成す ることができる。この場合、従来、4つの弾性大流の イルタ素子を必要としていたのに対し、第5の発明によ れば、1個の弾性表面波フィルタ素子を用いることによ り、平衡一不平衡変換機能が実現される。従って、平衡 一不平衡変換機能を有する弾性表面波フィルタ装置の小 型化及びコストの低減を果た1得る。

【0222】また、弾性表面波フィルタ素子の数を低減 し得るので、寄生容量を減らすことができ、それによっ て平衡度の劣化も生じ難い。従って、広帯域化も容易で ある。

【0223】また、第5の発明においても、第1,第2 の間隔が上記特定の範囲とされているので、第1の発明 と同様に、十分を帯域幅を実現することができ、かつ平 衛度も改善される。

【0224】第5の発明に係る弾性表面波フィルタ装置 において、第1、第2の間隔に、少なくとも一本の浮き 電極指が挿入されており、該領域における電極被覆率が 50%以上とされている場合には、挿入損失の低減を図 ることができる。

【0225】特に、上記電極被覆率が63%以上である場合には、挿入損失をより一層低減することができる。本発明において、不平衛端子側に直列に弾性表面波共振子が接続されている場合には、通過帯域外減衰量を改善することができる。

【0226】同様に、平衛端子側の各端子に直列にそれ ぞれ弾性表面波共振子を接続することによって、帯域外 譲衰量を改善することができる。また、平衛端子側に縦 続きれた梯子型回路精成の弾性表面波フィルタを備える 場合には、該棒子型弾性表面波フィルタの減衰極を通過 帯域の低級側及び高域側に配置することにより、減衰量 をび露根度をより一層高めることができる。さらに、平 筒端子間に並列に接続された弾性表面波共振子により、 平衛端子のそれぞれの影響を等しくすることができ、平 筒度を悪化させることなく、通過帯域外減衰量を拡大す ることができる。

【0227】本発明に係る弾性表面波装置において、弾性表面波フィルタ素子が構成されているチップをバッケージに収納した構造において、圧電基板上に形成された電能バターン、バッケージ及び導電部の少なくとも1つが電線対称の構造を有する場合には、それによって平衡度の順化を加削することができる。

【0228】特に、電極パターン、パッケージ及び導電 部のうち少なくとも2つが同一の対称軸に対して略線対 称とされている場合、より一層平衡度の悪化を抑制する とができる。 【0229】さらに、本売明に「高る弾性表面波フィルタ 装置では、圧電基板上に弾性表面波フィルタ素子が構成 されているチャアがフリップチップボンディングにより 指載されるケース材を備え、該ケース材に、1つの外部 入力増子または外部出力増子と、2つの外部出力増子ま には外部入力増子とが設けられており、1つの外部入力 増子または外部出力増子は入り、2つの外部出力増子ま たは外部入力増子が将総対はこ配置されている場合、あ るいは電気的に対称に配置されている場合には、平衡度 をより一層流のることができる。

【0230】また、本発明にかかる弾性表面波フィルタ 装置において、上記外部入力端子と外部出力端子との間 に少なくとも1つのアース端子が配置されている場合に は、入出力端子間の直達成分の抑制を図ることができ

る。さらに、上記2つの外部出力増予または外部入力端 子間に少なくとも1つのアース端子が配置されている場 合には、それによっても平衡度を高めることができる。 (0231)さらに、本売明に係る表面波フィルタ装置 は、前述したように共用器や該共用器を有する通信装置

に用いることができ、共用器や通信装置の小型化を図る

ことができる。 【図面の簡単な説明】

【図1】第1の実施例の弾性表面波フィルタ装置の電極 構造を示す略図的平面図。

【図2】第1の実施例の弾性表面波フィルタ装置及び従来例の弾性表面波フィルタ装置のフィルタ特性を示す

【図3】第1の実施例の弾性表面波フィルタ装置及び従来の弾性表面波フィルタ装置における不平衡端子側のV SWR特性を示す図。

【図4】第1の実施例及び従来の弾性表面波フィルタ装置の平衡端子側のVSWR特性を示す図。

【図5】隣り合うIDT間の間隔と振幅平衡度との関係を示す図。

【図6】隣り合うIDT間の間隔と位相平衡度との関係 を示す図。

【図7】隣り合うIDT間の間隔と帯域幅との関係を示

【図8】隣り合う I D T間の間隔と帯域内挿入損失との 関係を示す図。

【図9】隣り合うIDT間の間隔と振幅平衡度との関係 を示す図

【図10】隣り合うIDT間の間隔と位相平衡度との関係を示す図。

【図11】電極指交差幅比と、4.0dBの減衰量を有する帯域幅との関係を示す図。

【図12】電極指交差輻比と、VSWRとの関係を示す 図。

【図13】本発明の第2の実施例の弾性表面波フィルタ 装置の電極構造を示す略図的平面図。

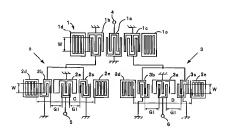
- 【図14】本発明の第3の実施例の弾性表面波フィルタ 装置の電極構造を示す略図的平面図。
- 【図15】本発明の第4の実施例の弾性表面波フィルタ 装置の電極構造を示す略図的平面図。
- 【図16】第4の実施例の弾性表面波フィルタ装置のフィルタ特性を示す図。
- 【図17】本発明の第5の実施例の**弾性表面波**フィルタ 装置の電極構造を示す略図的平面図。
- 【図18】本発明の第6の実施例の弾性表面波フィルタ 装置の電極構造を示す略図的平面図。
- 【図19】本発明の第7の実施例の弾性表面波フィルタ 装置の電極構造を示す略図的平面図。
- 【図20】本発明の第8の実施例の弾性表面波フィルタ 装置の電極構造を示す略図的平面図。
- 【図21】第4の実施例及び第8の実施例の各弾性表面 波フィルタ装置のフィルタ特性を示す図。
- 【図22】本発明の第9の実施例の弾性表面波フィルタ 装置の電極構造を示す略図的平面図。
- 【図23】本発明の第10の実施例の弾性表面波フィル タ装置の電極構造を示す略図的平面図。
- 【図24】本発明の第11の実施例の弾性表面波フィル タ装置を説明するための分解斜視図。
- 【図25】本発明の第12の実施例に係る弾性表面波フィルタ装置を贈出するための様式的平面図
- ィルタ装置を説明するための模式的平面図。 【図26】第12の実施例に係る弾性表面波フィルタ装

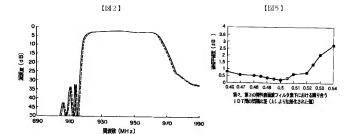
- 置を用いて構成されたアンテナ共用器を説明するための 柳略構成図.
- 【図27】第12の実施例の変形例に係る弾性表面波フィルタ装置を説明するための概略構成図。
- 【図28】従来の弾性表面波フィルタ装置の一例を説明 するための略図的平面図。
- 【図29】従来の弾性表面波フィルタ装置の他の例を示す略図的平面図。
- 【図30】本発明にかかる弾性表面波フィルタ装置の他の実施例を説明するための図であり、ケース材の底面
- 【図31】本発明の弾性表面波フィルタ装置のさらに他の実施例を説明するための図であり、ケース材の底面
- 【図32】 本発明に係る弾性表面波フィルタ装置の他の 実施傾き説明するための図であり、圧電基板の底面図。 【図33】 本発明に係る弾性表面波装置が用いられてい る道信機を説明するための頻略ブロック図。

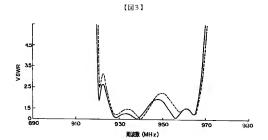
【符号の説明】

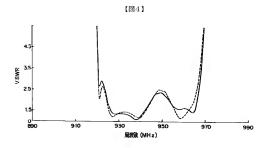
- 1~3…第1~第3の弾性表面波フィルタ素子
- 1a, 2a, 3a…第1のIDT
- 1b, 2b, 3b…第2のIDT
- 1c, 2c, 3c…第3のIDT
- 1d, 1e~3d, 3e…反射器

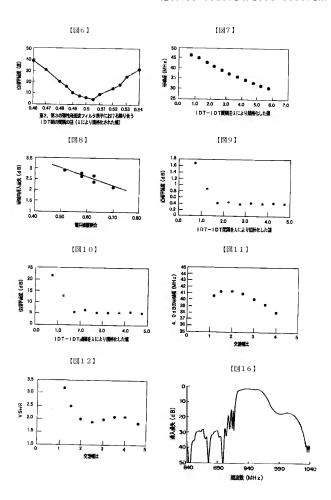




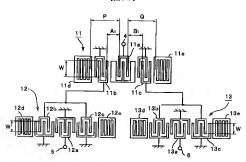




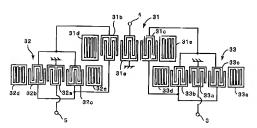




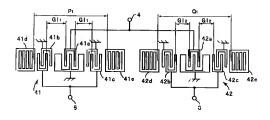


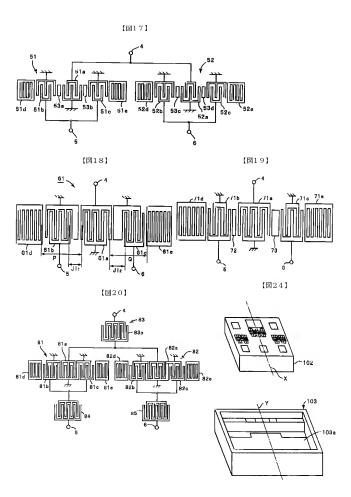


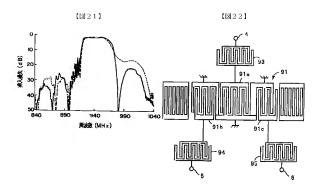
[図14]

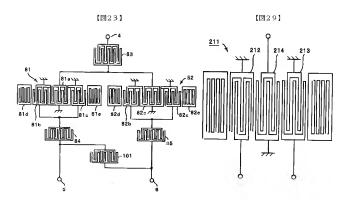


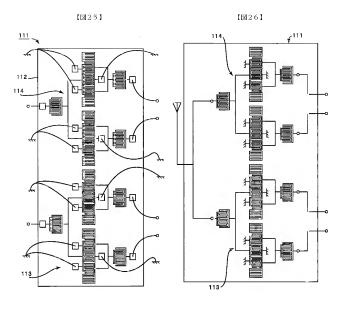
【図15】

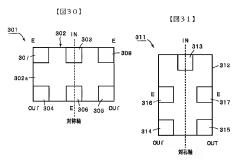


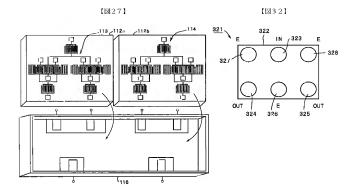


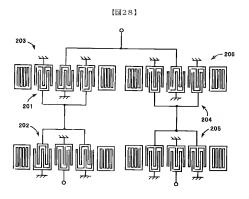












【図33】

